

股票简称：伟测科技

股票代码：688372



上海伟测半导体科技股份有限公司

(Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd.)

(住所：上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F)

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

(修订稿)



保荐机构（主承销商）



(深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层)

二〇二六年九月

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书正文内容。

一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。

二、本次发行的可转换公司债券的信用评级

针对本次可转债发行，本公司聘请了中证鹏元进行资信评级。根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司的主体信用等级为 AA+_{st}i，评级展望稳定，本次可转债信用等级为 AA+。

在本次可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由

于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、本次发行不提供担保

本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在的兑付风险。

四、关于公司发行可转换公司债券规模

根据公司公告的《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元（含 200,000.00 万元），具体发行规模由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

在本次可转债发行之前，公司将根据公司最近一期归属于上市公司股东的净资产最终确定本次可转债发行的募集资金总额规模，确保募集资金总额不超过最近一期归属于上市公司股东的净资产的 50%。

五、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险

（一）客户集中度较高的风险

2023 年至 2026 年 1-6 月各期，公司前五大客户的营业收入占公司营业收入的比例分别为 39.51%、41.87%、39.59%及 **34.39%**，报告期内客户集中度较高。若未来公司与下游主要客户合作出现不利变化，或原有客户因市场竞争加剧、宏观经济波动以及自身产品等原因导致市场份额下降，且公司未能及时拓展新客户，则公司将会存在收入增速放缓甚至下降的风险。

（二）进口设备依赖的风险

报告期内，公司产能持续扩张，固定资产投资规模持续增长。公司现有机器设备以进口设备为主，主要供应商包括 Advantest（爱德万）、Teradyne（泰瑞达）、Semics 等国际知名测试设备厂商。公司进口设备主要是测试机、探针台、分选机及相关配件，是公司测试业务的关键设备。截至目前，公司现有进

口设备及募集资金投资项目所需进口设备未受到管制。若未来国际贸易摩擦特别是中美贸易冲突加剧，美国进一步加大对半导体生产设备的出口管制力度和范围，从而使公司所需的测试设备出现进口受限的情形，将对公司生产经营产生不利影响。

（三）技术更新不及时与研发失败风险

随着集成电路行业自身的发展以及下游产品更新迭代的速度加快，高性能、多功能的复杂 SoC 以及各类先进架构和先进封装芯片（Chiplet、Sip 等）渐成主流，公司研发的测试方案需要不断满足高端芯片对测试的有效性、可靠性、稳定性以及经济性的需求，研发难度大大增加。此外，客户的测试需求也在不断变化，各类定制化要求层出不穷，公司要随之更新测试技术以适应市场的变化。如果公司未能在技术研发上持续投入，未能吸引和培养更加优秀的技术人才，可能存在研发的测试方案或开发的测试技术不能达到新型芯片产品的测试指标，导致研发失败的风险，进而对公司的经营造成不利影响。

（四）主营业务毛利率波动风险

公司主营业务毛利率与产能利用率、测试设备折旧、人力成本、市场供需关系等经营层面变化直接相关。同时，由于公司测试平台及配置种类较多，不同平台和配置的单价及成本差异较大，因此平台和配置的结构变化也会对公司主营业务毛利率产生较大影响。若未来上述因素发生不利变化，例如产能利用率下降、设备折旧增加、人力成本上升或市场需求萎缩导致服务价格下降、成本上升，则公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。

（五）本次募投项目产能消化风险

本次募投项目之“伟测科技上海总部基地项目”及“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”，在上海、成都购买土地、新建厂房并配置相关测试设备，主要用于扩大公司集成电路测试产能，尤其是 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能。项目建设完成后，公司产能规模将得到进一步提升。虽然本次投资项目的下游市场容量大、增速高，为项目的实施提供了市场保障，同时公司已经结合市场前景、公司技术、客户等方面储备情况对本募投项目产品的具体规划产能进行了充分的可行性论证，但若未来出现下游行业景气程度

降低、公司市场开拓不利、公司本次募投项目产品的研发、技术迭代或市场需求不及预期、市场竞争加剧等重大不利因素，且公司未能采取有效措施应对，则公司本募投项目的新增产能可能存在不能被及时消化的风险。

（六）本次募投项目实施后效益不及预期的风险

本次募投项目之“伟测科技上海总部基地项目”及“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”，在上海、成都购买土地、新建厂房并配置相关测试设备，主要用于扩大公司集成电路测试产能，尤其是 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能。公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金投资项目亦符合行业发展趋势及公司战略发展方向。根据项目可行性研究报告，“伟测科技上海总部基地项目”完全达产后年平均销售收入 28,551.53 万元，项目财务内部收益率 16.03%；“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”完全达产后年平均销售收入 31,543.34 万元，项目财务内部收益率 16.17%，项目预期效益良好。但在项目实施过程中，仍存在宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替、产能消化不及预期等原因造成募投项目延期或者无法产生预期收益的风险。同时，在募投项目实施过程中，可能存在经营风险或其他不可抗力因素而导致募投项目投资周期延长、投产延迟等情况，从而产生募投项目未能实现预期效益的风险。

（七）部分募投项目尚未取得土地使用权的风险

本次募集资金投资项目“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”建设地点为四川省成都市高新区。公司已与成都高新技术产业开发区管理委员会签署投资合作协议及相关补充协议，目前尚未完成土地出让合同的签署，尚未获得土地使用权证。公司后续将按程序签署相关合同并办理相应土地使用权的产权证书。伟测科技西南总部及研发测试基地项目的用地尚未最终取得，若公司后续未能按计划取得相关项目的土地使用权，将对本次募投项目实施带来一定不利影响。

六、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施

详细内容参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、报告期内相关主体承诺事项及履行情况”之“（二）本次发行所作出的重要承诺”之“1、

关于对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行的承诺”。

七、公司股利分配政策、现金分红情况、未分配利润使用安排情况

详细内容参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、报告期内的分红情况”。

八、公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员关于认购本次可转债及遵守短线交易相关规定的承诺

详细内容参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、报告期内相关主体承诺事项及履行情况”之“（二）本次发行所作出的重要承诺”之“2、关于是否参与本次可转债认购的承诺”。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示	2
一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风险.....	2
二、本次发行的可转换公司债券的信用评级.....	2
三、本次发行不提供担保.....	3
四、关于公司发行可转换公司债券规模.....	3
五、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险.....	3
六、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施.....	5
七、公司股利分配政策、现金分红情况、未分配利润使用安排情况.....	6
八、公司持股 5%以上的股东及董事、高级管理人员关于认购本次可转债及遵守短线交易相关规定的承诺.....	6
目 录.....	7
第一节 释 义	11
一、常用词语.....	11
二、专用词语.....	13
第二节 本次发行概况	16
一、发行人基本信息.....	16
二、本次发行基本情况.....	17
三、本次发行可转债的基本条款.....	23
四、本次发行的有关机构.....	32
五、发行人与本次发行有关中介机构的关系.....	34
第三节 风险因素	35
一、与发行人相关的风险.....	35
二、与行业相关的风险.....	38
三、其他风险.....	39
第四节 发行人基本情况	42

一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况.....	42
二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施.....	42
三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况.....	44
四、控股股东和实际控制人的基本情况和上市以来的变化情况.....	49
五、报告期内相关主体承诺事项及履行情况.....	51
六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员.....	53
七、发行人所处行业基本情况.....	64
八、公司主要业务情况.....	84
九、与产品有关的技术情况.....	96
十、主要固定资产、无形资产.....	129
十一、重大资产重组.....	151
十二、发行人境外经营情况.....	151
十三、报告期内的分红情况.....	151
十四、最近三年公开发行人公司债券以及债券本息偿付情况.....	156
十五、最近一期末债券持有情况及本次发行完成后累计债券余额情况....	156
第五节 财务会计信息与管理层分析	157
一、最近三年及一期财务报表审计情况.....	157
二、财务报表.....	157
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.....	161
四、会计政策、会计估计及重大会计差错更正.....	163
五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.....	164
六、财务状况分析.....	157
七、经营成果分析.....	188
八、现金流量状况分析.....	201
九、资本性支出分析.....	188
十、技术创新分析.....	204
十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.....	206
十二、本次发行对公司的影响.....	208
第六节 合规经营与独立性	209
一、发行人报告期内重大违法行为及行政处罚的情况.....	209

二、发行人及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况、被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况.....	210
三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况以及公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况.....	210
四、同业竞争情况.....	210
五、关联交易情况.....	212
第七节 本次募集资金运用	220
一、本次募集资金投资项目的的基本情况.....	220
二、本次募集资金投资项目的经营前景.....	220
三、与现有业务或发展战略的关系.....	221
四、本次募集资金投资项目的具体情况.....	224
五、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式.....	228
六、募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程.....	230
七、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式.....	234
八、本次募集资金投资项目涉及的立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进程、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性.....	235
第八节 历次募集资金运用	237
一、历次募集资金使用情况.....	237
二、最近五年内募集资金实际使用情况.....	239
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用.....	254
四、注册会计师鉴证意见.....	255
五、结论.....	255
第九节 声 明	256
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明.....	256
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	257
三、保荐机构（主承销商）声明.....	259
四、保荐机构董事长、总经理声明.....	260

五、审计机构声明.....	261
六、发行人律师声明.....	263
七、资信评级机构声明.....	264
八、发行人董事会声明.....	265
第十节 备查文件	266

第一节 释 义

本募集说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用词语

发行人、公司、伟测科技	指	上海伟测半导体科技股份有限公司
本次发行	指	公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为
可转债	指	可转换公司债券，是指公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成本公司股票的公司债券，属于《证券法》规定的具有股权性质的证券
无锡伟测	指	无锡伟测半导体科技有限公司，公司的全资子公司
南京伟测	指	南京伟测半导体科技有限公司，公司的全资子公司
深圳伟测	指	深圳伟测半导体科技有限公司，公司的全资子公司
上海威矽	指	上海威矽半导体科技有限公司，公司的全资子公司
天津伟测	指	天津伟测半导体科技有限公司，公司的全资子公司
成都伟测	指	成都伟测半导体科技有限公司，公司的全资子公司
蕊测半导体	指	上海蕊测半导体科技有限公司，公司的控股股东
宁波芯伟	指	宁波芯伟投资合伙企业（有限合伙），公司股东
江苏泰治	指	江苏泰治科技股份有限公司
芯知微	指	蚌埠芯知微电子科技有限公司
上海信邀	指	上海信邀创业投资中心（有限合伙）
紫光展锐	指	紫光展锐（上海）科技有限公司
中兴微电子	指	深圳市中兴微电子技术有限公司
晶晨股份	指	晶晨半导体（上海）股份有限公司
中微半导	指	中微半导体（深圳）股份有限公司
中颖电子	指	中颖电子股份有限公司
比特大陆	指	Bitmain Technologies Limited，比特大陆科技控股公司
卓胜微	指	江苏卓胜微电子股份有限公司
兆易创新	指	兆易创新科技集团股份有限公司
普冉股份	指	普冉半导体（上海）股份有限公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
安路科技	指	上海安路信息科技股份有限公司
鸿劲精密	指	Hon. Precision, Inc.，鸿劲精密股份有限公司

甬矽电子	指	甬矽电子（宁波）股份有限公司
瑞芯微	指	瑞芯微电子股份有限公司
纳芯微	指	苏州纳芯微电子股份有限公司
集创北方	指	北京集创北方科技股份有限公司
翱捷科技	指	翱捷科技股份有限公司
复旦微电	指	上海复旦微电子集团股份有限公司
季丰电子	指	上海季丰电子股份有限公司
Advantest、 爱德万	指	Advantest Corporation
Teradyne、泰瑞达	指	Teradyne（ASIA）PTE.LTD.
Semics	指	Semics Inc.
利扬芯片	指	广东利扬芯片测试股份有限公司
华岭股份	指	上海华岭集成电路技术股份有限公司
朗迅科技	指	杭州朗迅科技股份有限公司
合肥智芯	指	合肥智芯半导体有限公司
富瀚微	指	上海富瀚微电子股份有限公司
恒玄科技	指	恒玄科技（上海）股份有限公司
唯捷创芯	指	唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
国芯科技	指	苏州国芯科技股份有限公司
北京君正	指	北京君正集成电路股份有限公司
联芸科技	指	联芸科技（杭州）股份有限公司
裕太微电子	指	裕太微电子股份有限公司
华天科技	指	天水华天科技股份有限公司
通富微电	指	通富微电子股份有限公司
武汉新芯	指	武汉新芯集成电路制造有限公司
京元电子	指	京元电子股份有限公司
矽格	指	矽格股份有限公司
欣铨	指	欣铨科技股份有限公司
华为	指	华为技术有限公司
中兴	指	中兴通讯股份有限公司
股东会	指	上海伟测半导体科技股份有限公司股东会
董事会	指	上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海伟测半导体科技股份有限公司监事会（已取消）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》
《关联交易管理办法》	指	《上海伟测半导体科技股份有限公司关联交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
保荐人、保荐机构、主承销商、受托管理人、平安证券	指	平安证券股份有限公司
发行人会计师、审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
《募集说明书》、募集说明书	指	《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
《债券持有人会议规则》	指	《上海伟测半导体科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
《受托管理协议》	指	《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
报告期	指	2023 年度、2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月
报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日和 2026 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

二、专用词语

集成电路、IC	指	Integrated Circuit，集成电路，将一定数量的电子元件（如电阻、电容、晶体管等），以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路
芯片	指	集成电路的载体，也是集成电路经过设计、制造、封装、测试后的结果
硅片	指	又称裸晶圆，用以制作芯片的圆形硅晶体半导体材料
晶圆	指	又称 Wafer、圆片，在裸晶圆上加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品
晶片	指	Die，又称裸芯片、晶粒或裸片，是以半导体材料制作而成、未经封装的一小块集成电路本体，该集成电路的既定功能就是在这—

		小片半导体上实现
封装	指	指集成电路的封装，是半导体器件制造的最后阶段，之后将进行集成电路性能测试
封测	指	集成电路的封装与测试业务的简称
摩尔定律	指	由英特尔创始人之一戈登·摩尔于 1965 年提出的集成电路行业的一种现象，其内容为：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍
Foundry	指	在集成电路行业是指专门从事晶圆制造，接受 IC 设计公司委托制造晶圆而不自行从事芯片设计
Fabless	指	无晶圆厂芯片设计公司模式，该模式下企业只从事集成电路的设计和营销，而将晶圆制造、封装、测试等环节通过委外方式进行
Chipless	指	一种新的商业模式，是指一些体量巨大的电子装备公司自行设计研发芯片，芯片自用为主，以提高差异化和竞争力，芯片制造、封装、测试全部委外加工
IDM	指	Integrated Design and Manufacture，即垂直整合模式，该模式下企业能够独立完成芯片设计、晶圆制造、封装测试的所有环节
晶圆测试、CP	指	Chip Probing 的缩写，也称为中测，是对晶圆级集成电路的各种性能指标和功能指标的测试
芯片成品测试、FT	指	Final Test 的缩写，也称为终测，主要是完成封装后的芯片进行各种性能指标和功能指标的测试
良率	指	被测试电路经过全部测试流程后，测试结果为良品的电路数量占据全部被测试电路数量的比例。完成所有工艺步骤后测试合格的芯片的数量与整片晶圆上的有效芯片的比值。晶圆良率越高，同一片晶圆上产出的好芯片数量就越多
Mapping	指	晶圆结果映射图，每一个方块对应一个晶片结果
Site	指	指测试工位，每个工位每次测试一颗芯片
测试机、ATE	指	即自动测试设备 Automatic Test Equipment 的缩写
探针台、Prober	指	指将晶圆逐片自动传送至测试位置，芯片的管脚通过探针、专用连接线与测试机的功能模块进行连接的测试设备
测试板、Load Board	指	负载板或承载板，一种用于封装后成品芯片进行测试的治具
分选机、Handler	指	根据集成电路芯片不同的性质，对其进行分级筛选的设备，将芯片逐片自动传送至测试位置的自动化设备
探针卡、Prober Card	指	一种应用于集成电路晶圆测试中的，能实现与晶圆级芯片连接的电路板，用于晶圆测试
治具、Conversion Kit	指	一种用于集成电路测试的配件
引脚	指	又称管脚，从集成电路内部电路引出与外围电路的接线
Pin	指	指探针，连接晶圆管脚和探针卡的金属针
Pad	指	指晶圆管脚，IC 引脚在晶圆上以铝垫形式引出
SoC	指	System-on-Chip 的缩写，逻辑与混合信号芯片，也称系统级芯片，是在单个芯片上集成多个具有特定功能的集成电路所形成的电子系统
Chiplet	指	一种新兴的芯片设计方法，它将一个完整的芯片分成多个较小的芯片块或芯片片，然后将这些部分组合成一个完整的芯片系统
CPU	指	Central Processing Unit，中央处理器，是一台计算机的运算核心

		和控制核心，它的功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据
GPU	指	Graphic Processing Unit，即图像处理器，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上图像运算工作的微处理器
微 控 制 单 元 、 MCU	指	Micro Controller Unit，微控制单元，一种集成电路芯片
闪存	指	FLASH，快闪存储器，存储器芯片的一种
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit 的简称，是一种为专门目的而设计的集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路，分为全定制和半定制两种
FPGA	指	Field Programmable Gate Array，现场可编程门阵列，一种半客户定制的集成电路，在 PAL、GAL 等可编程器件的基础上进一步发展的产物，作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的
MEMS	指	Micro Electro Mechanical System，微型机电系统，指外形轮廓尺寸在毫米量级以下，构成元件是微米量级的可控制、可运动的微型机电装置
5G	指	5th-Generation，即第五代移动电话行动通信标准
物联网	指	The Internet of Things，是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络
区块链	指	Blockchain，信息技术领域的术语，指一种综合了分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式

注：本募集说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本信息

类别	基本情况
中文名称	上海伟测半导体科技股份有限公司
英文名称	Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd.
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	伟测科技
股票代码	688372
注册资本	16,808.8361 万元人民币
成立日期	2016 年 5 月 6 日
上市日期	2022 年 10 月 26 日
法定代表人	骈文胜
董事会秘书	王沛
注册地址	上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F
统一社会信用代码	91310115MA1H7PY66D
办公地址	上海市浦东新区东胜路 38 号 D 区 1 栋
邮政编码	201201
互联网网址	http://www.v-test.com.cn/
电子信箱	ir@v-test.com.cn
联系电话	021-58958216
经营范围	一般项目：半导体芯片的研发、测试、销售，电子器件制造（除显示器件、集成电路，有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的），电子产品、计算机软硬件的开发及销售，仪器仪表、机电设备的销售，自有设备租赁，从事半导体芯片测试领域内的技术服务、技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注：根据发行人 2026 年 7 月 22 日《关于 2023 年限制性股票激励计划第三个归属期、2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，发行人限制性股票归属后，公司股本总数由 168,088,361 股增加至 168,996,530 股。截至本募集说明书出具日，公司暂未办理工商变更登记。

二、本次发行基本情况

（一）本次发行的背景和目的

1、本次发行的背景

（1）人工智能成为集成电路产业发展的核心引擎，算力与存储等关键芯片供不应求，配套的先进晶圆代工、先进封装、高端测试的产能亦进入紧缺状态

当前，人工智能已成为驱动集成电路行业高质量发展的核心引擎，大模型训练与推理需求的爆发式增长，直接带动算力芯片、高带宽存储芯片等关键产品供不应求。在此背景下，与之深度配套的先进晶圆代工、2.5D/3D 先进封装及高端测试环节产能同步进入紧缺状态，产业链上下游协同扩产迫在眉睫。尤其随着芯片制程微缩与异构集成技术演进，测试环节对高端测试设备、复杂工艺适配能力及交付效率提出更高要求，成为制约整体产能释放的关键瓶颈之一。

（2）国产算力迈入爆发期，有望重塑全球高端测试供需格局，为内资测试厂商追赶国际先进水平、实现弯道超车提供难得机遇

CPU、GPU 及 AI 芯片等算力芯片的测试业务具备高壁垒、高单价、高附加值等特征，被誉为测试行业“皇冠上的明珠”。长期以来，算力芯片市场由国外厂商主导，其测试业务也主要配套于外资封测巨头。随着国产算力芯片从技术验证阶段全面跨入规模化商用爆发期，华为昇腾、寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份等本土企业在 AI 训练与推理芯片领域持续取得重大突破。基于自主可控的战略需求，加之算力芯片测试方案需深度定制开发，部分内资龙头测试厂商得以切入国产算力芯片产业链。这一趋势有望深刻改变全球高端测试的供需配套格局，为内资测试厂商对标全球一流水平并实现弯道超车创造历史性契机。

（3）公司是国内较早前瞻性高强度布局 AI 算力芯片测试业务的少数厂商之一，在新一轮 AI 业务竞争中已抢占部分先机

公司较早预判到 AI 算力芯片测试业务将成为重塑行业竞争格局的关键机遇。自 2024 年以来，公司在洁净厂房建设、AI 专用高端测试机采购、测试技术突破及客户开发等方面，果断进行了前瞻性的高强度投入。

在洁净厂房建设方面，鉴于洁净车间建设周期较长，部分国际巨头在本轮 AI 算力芯片测试扩产中面临产能空间不足的制约。而公司自 2023 年起，便无锡、南京持续大力投资高标准、大面积的洁净车间，为后续大规模扩产提供了坚实的厂房保障。

在 AI 专用高端测试机采购方面，该类设备长期由爱德万、泰瑞达两家巨头垄断，存在价格高、交期长等问题；AI 业务爆发后，其供应更趋紧张。2024 年以来，公司积极采购 AI 专用高端测试机，并通过提前下单锁定了大量未来扩产所需设备。目前，公司已采购及锁定订单的 AI 专用高端测试机数量处于国内领先地位。

在 AI 算力芯片测试技术突破方面，公司持续加大研发投入并引进高端测试人才，先后攻克了 CPU、GPU、AI 芯片及智驾芯片等各类 AI 算力芯片的测试难点，已充分具备大规模开展 AI 算力芯片测试业务的技术基础。

在 AI 算力芯片客户开发方面，公司紧跟客户产品研发与量产节奏，历时 2-3 年通过了国内主流 AI 算力芯片客户的供应商认证。2025 年，与公司持续开展业务合作的 AI 算力芯片客户达 10 余家，已覆盖国产算力领域最知名的一批核心客户。

通过上述举措，公司在新一轮 AI 业务竞争中成功抢占先机。AI 算力芯片测试业务已成为公司当前重要的收入来源，亦是驱动业绩高速增长的核心引擎。

2、本次发行的目的

(1) 继续加大 AI 算力芯片测试产能的建设，将其打造成为公司业绩增长的重要引擎，并为我国人工智能行业高端测试能力的自主可控提供有力保障

过去两年，面对人工智能产业爆发式增长带来的 AI ASIC 芯片、GPU、CPU 等 AI 算力芯片测试需求，公司坚持前瞻性扩产策略，通过引进国际先进测试设备、组建专业测试团队、建设高标准测试产线等举措，全面加码产能布局。截至 2025 年末，AI 算力芯片测试收入在公司营业收入中的占比已经初具规模。公司预计未来几年，AI 算力芯片测试需求仍将保持爆发式增长的态势。本次募投项目将继续加大 AI 算力芯片测试产能的建设，一方面能够将其打造成为公司业绩增长的重要引擎，另一方面能够填补我国在该领域的产能缺口，有

助于构建自主可控的测试技术体系，为我国人工智能产业筑牢质量根基，助力国产 AI 算力芯片在全球竞争中掌握核心话语权。

（2）响应现有客户的需求，扩大存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能，增强客户粘性，并增强公司的差异化竞争优势，打造新的业绩增长点

本次募投项目在重点强化 AI 算力芯片测试业务的同时，亦将部分资源倾斜至存储芯片、高端 CIS 芯片测试产能的建设。虽然这两类业务当前并非公司收入的主要来源，但凭借其卓越的成长潜力与有利的竞争态势，加之现有客户旺盛的测试需求，公司已将其视为关键的业务延伸方向。通过本次产能扩充，公司不仅能高效满足现有客户的增量需求，进一步巩固客户基础，更能借此优化业务组合，构建独特的差异化优势，为公司业绩的可持续增长打造新的业绩增长点。

（3）为公司业绩的持续增长提供产能保障，进一步巩固公司在行业中的领先地位

自 2016 年成立以来，公司的业绩保持了高速增长的态势，截至目前，公司已经发展成为中国大陆第三方集成电路测试领域中的领军企业。随着业务量不断上升，公司需要继续扩充测试产能才能保障业绩的持续增长。此外，集成电路行业具有“大者恒大”的规律，本次募投项目达产之后，预计能够大幅度增加公司的测试服务能力、营业收入和净利润规模，进一步巩固公司在行业中的领先地位。

（二）本次发行的证券类型

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（三）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 200,000 万元（含 200,000 万元）。具体募集资金数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（五）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额

本次可转换公司债券预计募集资金量为不超过人民币 200,000 万元（含 200,000 万元），扣除发行费用后预计募集资金净额为【】万元。

（六）募集资金专项存储的账户

公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

（七）募集资金投向

公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 200,000 万元（含本数）。扣除发行费用后的募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	名称	投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	伟测科技上海总部基地项目	98,740.00	70,000.00
2	伟测科技西南总部及研发测试基地项目	100,000.00	80,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		248,740.00	200,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经公司股东会授权，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

（八）发行方式与发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、

证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（九）向现有股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原 A 股股东优先配售，原有 A 股股东有权放弃优先配售权。向原有 A 股股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

公司原有 A 股股东优先配售之外的余额及原有 A 股股东放弃优先配售后部分的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十）承销方式及承销期

本次发行由保荐机构（主承销商）平安证券以余额包销方式承销。承销期的起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

（十一）发行费用

本次发行费用总额预计为【】万元，具体包括：

单位：万元

项目	金额
承销及保荐费用	【】
律师费用	【】
审计及验资费用	【】
资信评级费用	【】
信息披露及发行手续等费用	【】
合计	【】

（十二）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的主要日程安排如下表所示：

日期	发行安排
【】年【】月【】日（T-2）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
【】年【】月【】日（T-1）	网上路演、原 A 股股东优先配售股权登记日

【】年【】月【】日（T）	刊登发行提示性公告；原 A 股股东优先配售认购日；网下、网上申购日
【】年【】月【】日（T+1）	刊登网上中签率及网下发行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签
【】年【】月【】日（T+2）	刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果缴款；网下投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分别验资
【】年【】月【】日（T+3）	根据网上网下资金到账情况确认最终配售结果
【】年【】月【】日（T+4）	刊登发行结果公告

以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。

（十三）本次发行证券的上市流通安排

本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。

（十四）投资者持有期的限制或承诺

本次发行的证券不设持有期限限制。

（十五）融资间隔

发行人本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券，不适用“上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月”的融资时间间隔相关规定。

2024 年度及 2025 年度，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为 10,781.12 万元和 22,659.71 万元。公司不存在最近两个会计年度归属于母公司净利润（扣除非经常性损益前后孰低）连续亏损的情况。

综上所述，公司本次发行可转债符合融资时间间隔的要求。

三、本次发行可转债的基本条款

（一）债券期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

（二）面值

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（三）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

（四）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（五）评级情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的评级报告，公司的主体信用等级为 AA+_{st}i，评级展望稳定，本次可转债信用等级为 AA+。

本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

（六）保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

- (3) 根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- (4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- (5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- (6) 按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- (7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- (8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

- (1) 遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更《募集说明书》的约定；
- (2) 公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
- (3) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
- (4) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(5) 公司拟变更、解聘债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容；

(6) 在法律法规和规范性文件规定许可的范围内，对债券持有人会议规则的修改作出决议；

(7) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

(8) 公司提出债务重组方案的；

(9) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(10) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《上海伟测半导体科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 债券受托管理人；

(3) 单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券持有人；

(4) 法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

(七) 转股价格调整的原则及方式

1、初始转股价格的确定

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与

保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则

以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

（八）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（九）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债

券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：

$$I_A = B \times i \times t / 365$$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十一）回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见本小节“（十）赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见本小节“（十）赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十二）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿

还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

3、到期还本付息方式

公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（十三）构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

1、以下任一事件均构成发行人在受托管理协议下的违约事件：

（1）公司已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息；

（2）公司已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5,000 万元，且可能导致本次债券发生违约的；

（3）公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5,000 万元，且可能导致本次债券发生违约的；

（4）公司发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证且导致公司偿债能力面临严重不确定性的，或其被托管/接管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

（5）公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

（6）公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

（7）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化的；

（8）本次债券存续期内，公司违反受托管理协议项下的陈述与保证、未能按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务等义务与职责以致对公司对本次债券的还本付息能力产生重大不利影响，且一直持续 20 个连续工作日仍未得到纠正；

（9）公司发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

2、违约责任及其承担方式

如果本协议下的公司违约事件发生，根据债券持有人会议规则的约定，有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知

公司，宣布本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

在宣布加速清偿后，如果公司在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知公司，宣布取消加速清偿的决定：

（1）向受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：1）受托管理人的合理赔偿、费用和开支；2）所有迟付的利息；3）所有到期应付的本金；4）适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或

（2）相关的公司违约事件已得到救济；或

（3）债券持有人会议同意的其他救济措施。

公司保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金，若不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮 20%。

3、可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，争议各方之间应协商解决。如果协商不成，应提交深圳国际仲裁院仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（十四）本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。

四、本次发行的有关机构

（一）发行人

名称	上海伟测半导体科技股份有限公司
法定代表人	骈文胜
住所	上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F
办公地址	上海市浦东新区东胜路 38 号 D 区 1 栋
董事会秘书	王沛

联系电话	021-58958216
传真	无

（二）保荐机构、主承销商

名称	平安证券股份有限公司
法定代表人	何之江
住所	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
保荐代表人	吉丽娜、牟军
项目协办人	赵苡彤
其他项目组成员	王裕明、邓海、张复旦、谢炎宏
联系电话	95511-8
传真	0755-82400862

（三）律师事务所

名称	上海市锦天城律师事务所
负责人	沈国权
住所	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
经办律师	乔文湘、夏瑜杰、吴迪
联系电话	021-20511000
传真	021-20511999

（四）审计机构

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	翁伟
住所	杭州市钱江新城钱江路 1366 号华润大厦 B 座
经办注册会计师	周立新、张建
联系电话	0571-88216888
传真	0571-88216999

（五）资信评级机构

名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
负责人	张剑文
住所	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7008 阳光高尔夫大厦 1509
经办评级师	蒋晗、刘惠琼
联系电话	0755-82872897

传真	0755-82872897
----	---------------

（六）申请上市的证券交易所

名称	上海证券交易所
地址	上海市浦东新区浦东南路 528 号
联系电话	021-68808888
传真	021-68804868

（七）登记结算公司

名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号
电话	021-58708888
传真	021-58899400

（八）保荐人、主承销商收款银行

开户行	【】
户名	【】
账户号码	【】

五、发行人与本次发行有关中介机构的关系

截至 2026 年 7 月 9 日，保荐人平安证券通过自营账户持有发行人 0.02% 股权。除上述情形外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

第三节 风险因素

一、与发行人相关的风险

（一）经营风险

1、公司发展需要投入大量资金的风险

集成电路测试行业属于资本密集型的重资产行业，测试产能规模是测试企业核心竞争力的重要体现之一。在对行业发展趋势保持清晰认知的基础上，公司为了维持自身核心竞争力需持续扩大测试设备规模，从而保证测试产能的充足，满足客户的不同测试需求。因此，公司需不断购置测试机、探针台和分选机等测试设备。与此同时，公司购置的测试机中，绝大部分是采购价格相对昂贵、交付周期相对较长的高端测试机，高端测试机对公司持续满足客户需求、公司自身测试相关的研发等方面都有着较大的影响，因此，如果公司未来融资渠道、融资规模受限，导致发展资金短缺，可能对公司的持续发展和市场地位造成不利影响。

2、客户集中度较高的风险

2023 年至 2026 年 1-6 月各期，公司前五大客户的营业收入占公司营业收入的比例分别为 39.51%、41.87%、39.59%及 34.39%，报告期内客户集中度较高。若未来公司与下游主要客户合作出现不利变化，或原有客户因市场竞争加剧、宏观经济波动以及自身产品等原因导致市场份额下降，且公司未能及时拓展新客户，则公司将会存在收入增速放缓甚至下降的风险。

3、进口设备依赖的风险

报告期内，公司产能持续扩张，固定资产投资规模持续增长。公司现有机器设备以进口设备为主，主要供应商包括 Advantest（爱德万）、Teradyne（泰瑞达）、Semics 等国际知名测试设备厂商。公司进口设备主要是测试机、探针台、分选机及相关配件，是公司测试业务的关键设备。截至目前，公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备未受到管制。若未来国际贸易摩擦特别是中美贸易冲突加剧，美国进一步加大对半导体生产设备的出口管制力度和范围，从而使本公司所需的测试设备出现进口受限的情形，将对本公司生产经

营产生不利影响。

（二）技术风险

1、技术更新不及时与研发失败风险

随着集成电路行业自身的发展以及下游产品更新迭代的速度加快，高性能、多功能的复杂 SoC 以及各类先进架构和先进封装芯片（Chiplet、Sip 等）渐成主流，公司研发的测试方案需要不断满足高端芯片对测试的有效性、可靠性、稳定性以及经济性的需求，研发难度大大增加。此外，客户的测试需求也在不断变化，各类定制化要求层出不穷，公司要随之更新测试技术以适应市场的变化。如果公司未能在技术研发上持续投入，未能吸引和培养更加优秀的技术人才，可能存在研发的测试方案或开发的测试技术不能达到新型芯片产品的测试指标，导致研发失败的风险，进而对公司的经营造成不利影响。

2、研发技术人员短缺或流失的风险

集成电路测试行业属于技术密集型产业，测试方案开发、测试量产都依赖于理论知识和工程经验丰富的技术人员。目前，与广阔的市场空间相比，专业测试研发技术人员相对匮乏。此外，同行业竞争对手可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，同时，公司可能会受其他因素影响导致技术人才流失。上述情况将对公司测试方案的研发以及测试技术能力、测试技术人才的储备造成不利影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

3、核心技术泄密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司的测试方案开发能力与测试技术水平跻身国内先进行列。与此同时，公司十分重视对核心技术的保护工作，制定了包括信息安全保护制度在内的一系列严格完善的保密制度，并和核心技术人员签署了保密协议，对其离职后做出了严格的竞业限制规定，以确保核心技术的保密性。但由于技术秘密保护措施的限制性、技术人员的流动性及其他不可控因素，公司仍存在核心技术泄密的风险。如上述情况发生，可能在一定程度上削弱公司的技术优势并产生不利影响。

（三）财务风险

1、主营业务毛利率波动风险

公司主营业务毛利率与产能利用率、测试设备折旧、人力成本、市场供需关系等经营层面变化直接相关。同时，由于公司测试平台及配置种类较多，不同平台和配置的单价及成本差异较大，因此平台和配置的结构变化也会对公司主营业务毛利率产生较大影响。若未来上述因素发生不利变化，例如产能利用率下降、设备折旧增加、人力成本上升或市场需求萎缩导致服务价格下降、成本上升，则公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。

2、新增固定资产折旧风险

根据发行人本次募集资金投资项目规划，本次募投项目投产后，公司固定资产规模将出现较大幅度增加，对应的折旧费用将相应增加。由于影响募集资金投资项目效益实现的因素较多，若募投项目实施后因市场环境等发生重大不利变化，导致募集资金投资项目产生效益的时间晚于预期或实际效益低于预期水平，则新增固定资产折旧将对发行人未来的盈利情况产生不利影响。

（四）募投项目实施风险

1、本次募投项目产能消化风险

本次募投项目之“伟测科技上海总部基地项目”及“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”，在上海、成都购买土地、新建厂房并配置相关测试设备，主要用于扩大公司集成电路测试产能，尤其是 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能。项目建设完成后，公司产能规模将得到进一步提升。虽然本次投资项目的下游市场容量大、增速高，为项目的实施提供了市场保障，同时公司已经结合市场前景、公司技术、客户等方面储备情况对本募投项目产品的具体规划产能进行了充分的可行性论证，但若未来出现下游行业景气程度降低、公司市场开拓不利、公司本次募投项目产品的研发、技术迭代或市场需求不及预期、市场竞争加剧等重大不利因素，且公司未能采取有效措施应对，则公司本募投项目的新增产能可能存在不能被及时消化的风险。

2、本次募投项目实施后效益不及预期的风险

本次募投项目之“伟测科技上海总部基地项目”及“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”，在上海、成都购买土地、新建厂房并配置相关测试设备，主要用于扩大公司集成电路测试产能，尤其是 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能。公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金投资项目亦符合行业发展趋势及公司战略发展方向。根据项目可行性研究报告，“伟测科技上海总部基地项目”完全达产后年平均销售收入 28,551.53 万元，项目财务内部收益率 16.03%；“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”完全达产后年平均销售收入 31,543.34 万元，项目财务内部收益率 16.17%，项目预期效益良好。但在项目实施过程中，仍存在宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替、产能消化不及预期等原因造成募投项目延期或者无法产生预期收益的风险。同时，在募投项目实施过程中，可能存在经营风险或其他不可抗力因素而导致募投项目投资周期延长、投产延迟等情况，从而产生募投项目未能实现预期效益的风险。

3、部分募投项目尚未取得土地使用权的风险

本次募集资金投资项目“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”建设地点为四川省成都市高新区。公司已与成都高新技术产业开发区管理委员会签署投资合作协议及相关补充协议，目前尚未完成土地出让合同的签署，尚未获得土地使用权证。公司后续将按程序签署相关合同并办理相应土地使用权的产权证书。伟测科技西南总部及研发测试基地项目的用地尚未最终取得，若公司后续未能按计划取得相关项目的土地使用权，将对本次募投项目实施带来一定不利影响。

二、与行业相关的风险

随着人工智能、5G 通信、高性能计算和汽车电子等领域的爆发式增长，集成电路测试作为保障芯片性能与可靠性的关键环节，其市场需求呈现出持续、强劲的扩张态势。面对这一趋势，各类测试服务商加大资金投入，积极扩充产能，以期抢占更大的市场份额。其中，封测一体化企业凭借其在封装与测试环节的天然协同优势和规模效应，持续优化生产线并引入高端测试设备；而独立

第三方测试头部企业则依托其专业聚焦、服务灵活性和广泛的客户覆盖，也在加速产能建设和新技术研发。这种全行业的积极扩张态势，直接导致了集成电路测试服务市场的竞争格局变得非常激烈，已从单纯的价格竞争，逐步演变为涵盖技术先进性、成本控制力、服务质量、响应速度和综合解决方案能力的全方位角逐。若公司未来无法在上述几个方面不断缩小与封测一体化企业之间的差距，将有可能在竞争中处于不利地位。

三、其他风险

（一）不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。

（二）发行可转债到期不能转股的风险

股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形

势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的资金负担和生产经营压力。

（三）转股后公司每股收益和净资产收益率摊薄的风险

本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司股本和净资产将一定程度的增加，但本次募集资金从投入到产生收益需要一定的时间，故可能存在公司利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度的情况。本次发行募集资金到位后，公司存在每股收益及净资产收益率下降的风险。

（四）本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，如公司经营活动未能实现预期的回报，将影响公司对可转债本息兑付，以及对投资者回售要求的兑付能力。

（五）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施或修正幅度不确定的风险

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者。

可转债存续期内，由于修正后的转股价格不能低于审议转股价格向下修正方案的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者，本次可转债的转股价格向下修正条款可能无法实施。同时，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不

能实施的风险。

此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，即使董事会提出转股价格向下调整方案且方案经股东会审议通过，但仍存在转股价格修正幅度不确定的风险。

（六）资信风险

公司本次发行的可转换公司债券已经中证鹏元评级，其中公司的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，本次可转债信用等级为 AA+。在本次债券存续期内，如果公司所处经营环境或自身的经营状况发生重大不利变化，有可能会对发行人的资信评级与本次债券评级状况出现不利变化，进而使本次债券投资者的利益受到不利影响。

（七）可转债未担保风险

本次向不特定对象发行的可转换公司债券无任何担保。如果本次可转债存续期间发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件，本次可转债可能因未提供担保而增大风险。

（八）股票及可转债价格波动风险

可转债作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率水平、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者心理预期等诸多因素的影响，价格波动情况较为复杂。其中因可转债附有转股权利，通常可转债的发行利率比相似评级和期限的可比公司债券的利率更低；另外，由于可转债的转股价格为事先约定的价格，随着市场股价的波动，可能会出现转股价格高于股票市场价格的情形，导致可转债的交易价格降低。因此，公司可转债在上市交易及转股过程中，可转债交易价格均可能出现异常波动或价值背离，甚至低于面值的情况，从而可能使投资者面临一定的投资风险。公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以及可转债特殊的产品特性，以便作出正确的投资决策。

第四节 发行人基本情况

一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况

截至报告期末，公司股本总数为 168,088,361.00 股，其中公司前十名股东情况如下表所示：

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持有有限售条件的股份数量 (股)	持有无限售条件的股份数量 (股)	质押股份数 (股)
上海蕊测半导体科技有限公司	境内非国有法人	27.18	45,685,496	0	45,685,496	0
香港中央结算有限公司	其他	3.36	5,639,616	0	5,639,616	0
中国银行股份有限公司一易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.39	4,022,078	0	4,022,078	0
高盛国际一自有资金	其他	2.08	3,500,311	0	3,500,311	0
宁波芯伟投资合伙企业 (有限合伙)	其他	0.92	1,548,525	0	1,548,525	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.79	1,328,524	0	1,328,524	0
中国工商银行股份有限公司一汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76	1,274,633	0	1,274,633	0
UBS AG	其他	0.75	1,265,017	0	1,265,017	0
张林恩	境内自然人	0.72	1,214,350	0	1,214,350	0
交通银行股份有限公司一诺安研究优选混合型证券投资基金	其他	0.59	991,146	0	991,146	0
合计		39.54	66,469,696	0	66,469,696	0

二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施

(一) 公司科技创新水平

1、公司具备较强的技术研发实力，科技成果转化能力突出

公司自成立就十分重视研发投入和技术开发，目前已在测试工程方法、测

试方案开发、自动化测试等方面积累了较强的技术研发实力。公司是高新技术企业、工信部认定的“专精特新”小巨人企业，浦东新区企业研发机构。公司汇聚了国内优秀的集成电路测试研发、工程和管理人员，核心团队成员平均在测试行业拥有 10 年以上的从业经验。截至 **2026 年 6 月 30 日**，公司及其子公司已取得 **112 项**专利，其中发明专利 **28 项**，实用新型专利 **83 项**，**外观设计专利 1 项**。发行人在关键测试技术指标如最大同测数、最高测试频率、测试温度的覆盖范围等都达到或接近国际一流企业同级水平，获得了客户的广泛认可。2023 年度至 **2026 年上半年度**，公司核心技术应用产生的收入分别 68,692.59 万元、98,145.90 万元、149,456.19 万元及 **101,328.44 万元**。

2、公司行业地位突出，市场认可度高，已经成为国内自主可控的高端测试服务的主要供应商之一

自 2016 年 5 月成立以来，公司经营业绩实现了高速增长，截至目前，公司已经成为第三方集成电路测试行业中规模排名前列的内资企业之一。中兴、华为禁令事件发生后，公司积极把握行业发展历史机遇，重点突破各类高端芯片的测试工艺难点，成为中国大陆各大芯片设计公司自主可控的高端测试服务的主要供应商之一。公司的技术实力、服务品质、产能规模获得了行业的高度认可，积累了客户 A、客户 C、紫光展锐、中兴微电子、晶晨股份、兆易创新、复旦微电、比特大陆、安路科技、客户 B、甬矽电子、卓胜微、普冉股份、中芯国际、瑞芯微、纳芯微、集创北方、翱捷科技等知名客户。

（二）公司保持科技创新能力的机制和措施

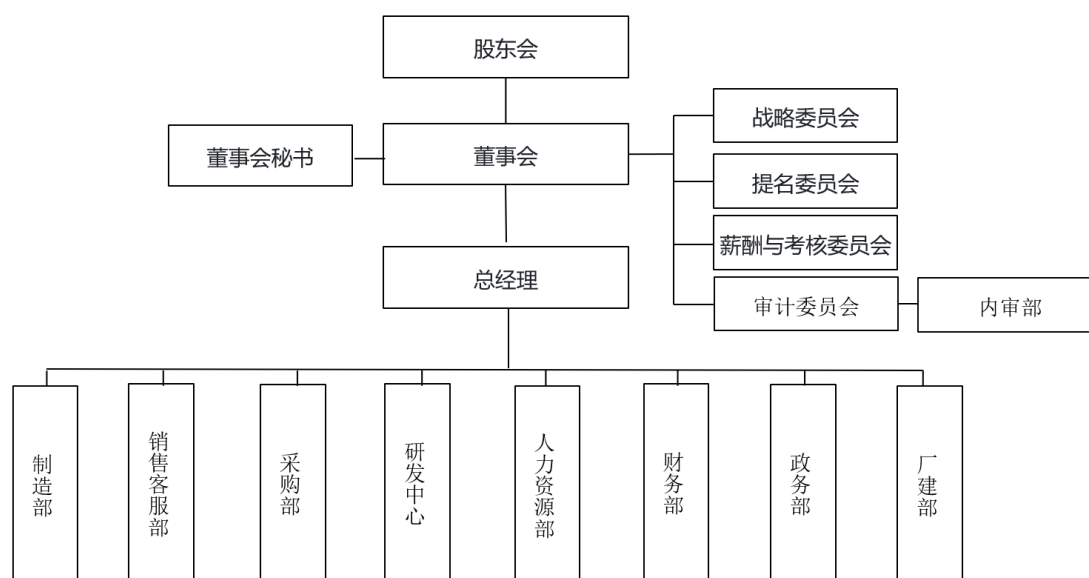
为了保持业内领先的研发创新实力，不断提升公司的行业技术地位，公司建立了一系列技术创新机制。具体来说，公司具备紧贴市场需求的创新驱动力，建立了完善的人才培养、储备体系与有效的人才激励机制，形成了浓厚的创新文化氛围。依托该等保持技术不断创新的机制，公司在测试工艺难点突破、测试方案开发、测试设备升级改造、测试作业自动化和智能化等方面均正在进行持续研发并积累了充分的技术储备。

综上所述，公司建立了保持科技创新能力的机制和安排，从而使公司具备持续创新的能力。

三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况

（一）公司组织结构图

截至报告期末，公司组织结构如下：



（二）对其他企业的重要权益投资情况

截至报告期末，公司拥有六家子公司：无锡伟测、南京伟测、深圳伟测、上海威矽、天津伟测和成都伟测，公司拥有三家参股公司：江苏泰治科技股份有限公司、蚌埠芯知微电子科技有限公司和上海信邀创业投资中心（有限合伙）。具体情况如下：

1、子公司基本情况

（1）无锡伟测半导体科技有限公司

公司名称	无锡伟测半导体科技有限公司	成立时间	2020年6月9日
注册资本	人民币43,000万元		
实收资本	人民币43,000万元		
注册地址及主要生产经营地址	江苏省无锡市新吴区新加坡工业园新达路 28-12 号厂房		
与发行人主营业务的关系	主要从事晶圆测试和芯片成品测试，与发行人主营业务相同，为发行人在无锡设立的测试生产和研发基地。		
股东构成	股东名称	持股比例	
	伟测科技	100.00%	
	合计	100.00%	

主要财务数据 (万元)	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	
	营业收入	95,143.74
	净利润	19,470.02
	总资产	345,355.14
	净资产	97,233.39
	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	
	营业收入	60,601.06
	净利润	8,131.75
	总资产	427,658.39
	净资产	105,790.54
审计情况	2025 年财务数据业经天健会计师事务所审计；2026 年 1-6 月未经审计	

(2) 南京伟测半导体科技有限公司

公司名称	南京伟测半导体科技有限公司	成立时间	2021年10月21日
注册资本	人民币25,000万元		
实收资本	人民币25,000万元		
注册地址及主要生产经营地址	江苏省南京市浦口区云实路 19 号		
与发行人主营业务的关系	主要从事晶圆测试和芯片成品测试，与发行人主营业务相同，为发行人在南京设立的测试生产和研发基地。		
股东构成	股东名称	持股比例	
	伟测科技	100.00%	
	合计	100.00%	
主要财务数据 （万元）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度		
	营业收入	38,476.57	
	净利润	1,954.98	
	总资产	310,450.62	
	净资产	46,949.13	
	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月		
	营业收入	27, 239. 43	
	净利润	2, 284. 52	
	总资产	359, 969. 05	
	净资产	51, 746. 15	
审计情况	2025 年财务数据业经天健会计师事务所审计；2026 年 1-6 月未经审计		

注：截至报告期末，南京伟测增加注册资本至 39,000.00 万元，暂未办理工商变更登记。

（3）深圳伟测半导体科技有限公司

公司名称	深圳伟测半导体科技有限公司	成立时间	2023年9月6日
注册资本	人民币10,000万元		
实收资本	人民币2,000万元		
注册地址及主要生产经营地址	深圳市宝安区西乡街道福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦602		
与发行人主营业务的关系	主要从事晶圆测试和芯片成品测试，与发行人主营业务相同，为发行人在深圳设立的测试生产和研发基地		
股东构成	股东名称	持股比例	
	伟测科技	100.00%	
	合计	100.00%	
主要财务数据 （万元）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度		
	营业收入	5,118.89	
	净利润	482.67	
	总资产	7,665.07	
	净资产	1,080.24	
	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月		
	营业收入	4, 117. 08	
	净利润	932. 36	
	总资产	9, 157. 52	
	净资产	2, 059. 88	
审计情况	2025 年财务数据业经天健会计师事务所审计；2026 年 1-6 月未经审计		

（4）上海威矽半导体科技有限公司

公司名称	上海威矽半导体科技有限公司	成立时间	2016年11月08日
注册资本	人民币300万元		
实收资本	人民币300万元		
注册地址及主要生产经营地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层		
与发行人主营业务的关系	主要从事晶圆测试和芯片成品测试方案的研发，为发行人的研发中心		
股东构成	股东名称	持股比例	
	伟测科技	100.00%	
	合计	100.00%	
主要财务数据	2025 年 12 月 31 日/2025 年度		

(万元)	营业收入	309.91
	净利润	-887.57
	总资产	2,792.86
	净资产	-460.15
	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月	
	营业收入	2, 502. 35
	净利润	-104. 66
	总资产	4, 707. 45
	净资产	-441. 95
审计情况	2025 年财务数据业经天健会计师事务所审计；2026 年 1-6 月未经审计	

(5) 天津伟测半导体科技有限公司

公司名称	天津伟测半导体科技有限公司	成立时间	2024年6月17日
注册资本	人民币1,000万元		
实收资本	人民币1,000万元		
注册地址及主要生产经营地址	天津市西青经济技术开发区业盛道 10 号 E 座 1-4 层		
与发行人主营业务的关系	主要从事晶圆测试和芯片成品测试方案的研发，为发行人的研发中心		
股东构成	股东名称	持股比例	
	伟测科技	100.00%	
	合计	100.00%	
主要财务数据 （万元）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度		
	营业收入	1,323.84	
	净利润	-254.22	
	总资产	2,043.07	
	净资产	628.67	
	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月		
	营业收入	1, 011. 29	
	净利润	-438. 51	
	总资产	2, 808. 79	
	净资产	245. 24	
审计情况	2025 年财务数据业经天健会计师事务所审计；2026 年 1-6 月未经审计		

(6) 成都伟测半导体科技有限公司

公司名称	成都伟测半导体科技有限公司	成立时间	2026年1月30日
注册资本	人民币10,000万元		
实收资本	人民币 100 万元		
注册地址及主要生产经营地址	成都高新区康强三路 1111 号 1 号楼 3 层附 A318 号（自编号）		
与发行人主营业务的关系	主要从事晶圆测试和芯片成品测试，与发行人主营业务相同，为发行人在成都设立的测试生产和研发基地。		
股东构成	股东名称	持股比例	
	伟测科技	100.00%	
	合计	100.00%	
审计情况	成都伟测暂未实际经营		

2、参股公司基本情况

(1) 江苏泰治科技股份有限公司

公司名称	江苏泰治科技股份有限公司	成立时间	2016年11月09日
注册资本	人民币4,455.49万元		
实收资本	人民币4,455.49万元		
注册地址及主要生产经营地址	南京市雨花台区安德门大街 57 号 7 幢 601-610 室		
与发行人主营业务的关系	半导体 CIM 软件研发，为半导体企业提供数字化智慧工厂整体解决方案，为发行人产业链上游供应商		

(2) 蚌埠芯知微电子科技有限公司

公司名称	蚌埠芯知微电子科技有限公司	成立时间	2022年3月8日
注册资本	人民币251.07万元		
实收资本	人民币251.07万元		
注册地址及主要生产经营地址	安徽省蚌埠市龙子湖区李楼乡龙湖科创园 11#楼 9 层 901 办公室		
与发行人主营业务的关系	汽车、手机等的显示屏触控芯片及触控解决方案，为发行人下游客户		

(3) 上海信邀创业投资中心（有限合伙）

公司名称	上海信邀创业投资中心（有限合伙）	成立时间	2021年6月8日
注册资本	人民币10,000.00万元		
实收资本	人民币7,257.00万元		
注册地址及主要	上海市虹口区纪念路 500 号 1 幢 225 室		

生产经营地址	
与发行人主营业务的关系	投资公司产业链相关的企业

四、控股股东和实际控制人的基本情况和上市以来的变化情况

（一）控股股东及实际控制人情况

1、控股股东情况

截至报告期末，蕊测半导体持有公司 27.18% 的股份，为公司的控股股东，其基本信息如下：

企业名称	上海蕊测半导体科技有限公司
注册资本	人民币 2,396 万元
实收资本	人民币 2,396 万元
法定代表人	骈文胜
公司成立时间	2015 年 12 月 29 日
注册地址和主要经营地	上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 C303 室
经营范围	一般项目：从事半导体科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理咨询，信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
企业地址	上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 C303 室
主营业务及其与发行人主营业务的关系	蕊测半导体不存在实际业务经营，仅为持有发行人股份

截至报告期末，蕊测半导体的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	骈文胜	1,235	51.54
2	闻国涛	621	25.92
3	路峰	230	9.60
4	邵颖	130	5.43
5	深圳市智汇科创科技有限公司	100	4.17
6	李峰	80	3.34
合计		2,396	100

蕊测半导体最近一年主要财务数据如下：

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日（万元）
资产总额	23,462.33
所有者权益总额	17,710.25
营业收入	-
净利润	21,537.92

2、实际控制人情况

截至**报告期末**，骈文胜先生直接持有发行人 **0.07%** 股权，并通过蕊测半导体、宁波芯伟间接持有发行人 **14.49%** 的股份，合计持有发行人 **14.56%** 股权，为发行人的实际控制人。

公司实际控制人的简历如下：

骈文胜，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，身份证号码 12011219700512****，无境外永久居留权，本科学历，1993 年，毕业于电子科技大学电子精密机械专业，本科学历，1993-2000 年，任摩托罗拉（中国）电子有限公司设备经理，2000-2004 年，任职于威宇科技测试封装（上海）有限公司；2004-2009 年，任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试厂长、封装厂长、资材处长；2009-2016 年，任职于江苏长电科技股份有限公司，任事业中心总经理、集团海外销售副总裁；2016 年 6 月至今，担任公司董事长、总经理。

（二）上市以来公司控股股东、实际控制人变化情况

自上市以来，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（三）控股股东及实际控制人所持有发行人股份被质押、冻结或潜在纠纷的情况

截至**报告期末**，公司控股股东及实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结或潜在纠纷的情况。

（四）控股股东及实际控制人对其他企业的投资情况

截至**报告期末**，公司实际控制人骈文胜持有公司员工持股平台宁波芯伟 38.92% 的合伙份额。除此之外，公司控股股东及实际控制人不存在对其他企业实施控制或重大影响的情况。

五、报告期内相关主体承诺事项及履行情况

（一）已作出的重要承诺及其履行情况

关于公司已作出的重要承诺及其履行情况，请参见公司 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海伟测半导体科技股份有限公司 2026 年半年报》之“第五节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。截至本募集说明书出具日，本次发行前相关主体所作出的重要承诺履行情况正常。

（二）本次发行所作出的重要承诺

1、关于对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行的承诺

（1）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺

公司的全体董事、高级管理人员作出承诺如下：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具之日起至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

7、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”。

（2）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施的承诺

公司控股股东上海蕊测半导体科技有限公司、实际控制人骈文胜作出承诺如下：

“1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

2、自本承诺出具之日起至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

3、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

2、关于是否参与本次可转债认购的承诺

根据《中华人民共和国证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定的要求，公司持股 5%以上股东、董事及高级管理人员对本次可转债认购相关事项承诺如下：

（1）持股 5%以上股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员的承诺

①本人/本企业将根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及伟测科技本次可转换公司债券发行时的市场情况决定是否参与认购，并将严格履行相应信息披露义务。

②若本人/本企业参与伟测科技本次可转债的发行认购，本人/本企业将严格遵守《证券法》关于买卖可转债的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定的短线交易等违法行为。

③本人/本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人/本企业违反上述承诺减持伟测科技可转债的，因减持公司可转债的所得收益全部归伟测科技所有，本人/本企业将依法承担由此产生的法律责任。

（2）独立董事的承诺

①本人承诺本人及本人配偶、父母、子女不参与认购伟测科技本次向不特定对象发行的可转换公司债券，亦不会委托其他主体参与认购。

②本人保证本人之配偶、父母、子女严格遵守短线交易的相关规定，并依法承担由此产生的法律责任。

③若本人违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。

六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、高级管理人员及核心技术人员的的基本情况

截至本募集说明书出具日，公司现有董事 6 名、高级管理人员 4 名、核心技术人员 3 名，具体任职情况如下：

序号	姓名	职务	性别
1	骈文胜	董事长、总经理、核心技术人员	男
2	闻国涛	董事、副总经理、核心技术人员	男
3	路峰	副总经理、核心技术人员	男
4	王沛	职工代表董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	女
5	宋海燕	独立董事	女
6	金敬长	独立董事	男
7	陈红燕	独立董事	女

公司董事、高级管理人员符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格；公司董事、高级管理人员及核心技术人员的选聘符合《公司章程》规定的选举或任免程序以及公司内部的人事聘用制度；董事、高级管理

人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

（二）董事、高级管理人员及核心技术人员简历

1、董事简历及任职情况

（1）骈文胜先生

骈文胜先生的简历参见本节之“四、控股股东和实际控制人的基本情况和上市以来的变化情况”之“（一）控股股东及实际控制人情况”之“2、实际控制人情况”。

（2）闻国涛先生

闻国涛，董事、副总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1978年3月出生，2001-2004年，任威宇科技测试封装（上海）有限公司设备工程师；2004-2016年，任职于日月光封装测试（上海）有限公司，历任测试设备主管、经理、封装厂长、测试厂长；2016年5月至今，担任公司董事、副总经理。

（3）王沛女士

王沛，副总经理、财务总监、董事会秘书、职工代表董事。女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1980年11月出生，2007-2011年，任上海领灿投资咨询有限公司融资业务部总监；2011-2020年，任职环旭电子股份有限公司证券部；2020年7月至今，任公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2024年4月至2025年10月，任公司董事；2025年10月至今，任公司职工代表董事。

（4）宋海燕女士

宋海燕，独立董事。女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。1976年出生，2001年4月至2013年4月，任上海市集成电路行业协会秘书长助理；2013年4月至今，任上海市集成电路行业协会副秘书长；2023年7月至今，任公司独立董事。

（5）金敬长先生

金敬长，独立董事。男，中国国籍，无其他境外永久居留权，本科学历。1958年出生，1997年至1999年，任摩托罗拉（中国）电子有限公司总经理；

2000 年至 2005 年，任威宇科技测试封装（上海）有限公司总经理；2006 年至今，任昆山中辰矽晶有限公司总经理，元鸿（山东）光电材料有限公司董事长、上海召业申凯电子材料有限公司董事长、昆山辰巨电子科技有限公司董事长、忻州元鸿信息材料有限公司执行董事。2026 年 7 月至今，任公司独立董事。

（6）陈红燕女士

陈红燕女士，独立董事。女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，非执业注册会计师，已取得国家法律职业资格证书。1986 年出生，2011 年至 2015 年，任瑞华会计师事务所项目经理；2015 年至 2017 年，任中泰证券股份有限公司高级项目经理；2017 年至 2022 年，任尚信资本管理有限公司投资总监；2022 年至今，任上海分值医学科技有限公司总经理，上海宏蒙教育科技有限公司监事，江苏捷峰高科能源材料股份有限公司监事，医发（上海）智能科技有限公司执行董事；2026 年 7 月至今，任公司独立董事。

2、高级管理人员简历及任职情况

（1）骈文胜先生

骈文胜先生的简历参见本节之“四、控股股东和实际控制人的基本情况和上市以来的变化情况”之“（一）控股股东及实际控制人情况”之“2、实际控制人情况”。

（2）闻国涛先生

闻国涛先生的简历参见本节之“六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（二）董事、高级管理人员及核心技术人员简历”之“1、董事简历及任职情况”之“（2）闻国涛先生”。

（3）路峰先生

路峰，副总经理。男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1971 年 2 月出生，1993-2000 年，任摩托罗拉（中国）电子有限公司工艺设备工程师、自动化经理；2000-2004 年，任威宇科技测试封装（上海）有限公司 IT 部门经理；2004-2006 年，任日月光封装测试（上海）有限公司 IT 部门经理；2006-2018 年，任职于晟碟半导体（上海）有限公司，历任 IT 部门经理、总监；

2018年5月至今，担任公司副总经理。

（4）王沛女士

王沛女士的简历参见本节之“六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（二）董事、高级管理人员及核心技术人员简历”之“1、董事简历及任职情况”之“（3）王沛女士”。

3、核心技术人员简历及任职情况

公司综合考虑生产经营实际需要、相关人员任职情况、对企业生产经营发挥的实际作用、掌握核心技术等因素，对核心技术人员进行了认定。经审慎认定，公司的核心技术人员为骈文胜、闻国涛、路峰。

（1）骈文胜先生

骈文胜先生的简历参见本节之“四、控股股东和实际控制人的基本情况和上市以来的变化情况”之“（一）控股股东及实际控制人情况”之“2、实际控制人情况”。

（2）闻国涛先生

闻国涛先生的简历参见本节之“六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（二）董事、高级管理人员及核心技术人员简历”之“1、董事简历及任职情况”之“（2）闻国涛先生”。

（3）路峰先生

路峰先生的简历参见本节之“六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（二）董事、高级管理人员及核心技术人员简历”之“2、高级管理人员简历及任职情况”之“（3）路峰先生”。

（三）董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

2025年度，公司时任董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	2025年度薪酬（万元）
1	骈文胜	董事长、总经理、核心技术人员	198.11
2	闻国涛	董事、副总经理、核心技术人员	157.23

序号	姓名	职务	2025 年度薪酬（万元）
3	路峰	董事、副总经理、核心技术人员	137.75
4	陈凯	董事	-
5	林秀强	独立董事	8.00
6	王怀芳	独立董事	8.00
7	宋海燕	独立董事	8.00
8	王沛	职工代表董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	119.13
9	刘琨	副总经理、核心技术人员	51.71

（四）董事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至本募集说明书出具日，公司现任董事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	目前兼职单位	在该单位任职情况
骈文胜	董事长、总经理、核心技术人员	上海蕊测半导体科技有限公司	执行董事
闻国涛	董事、副总经理、核心技术人员	上海蕊测半导体科技有限公司	监事
宋海燕	独立董事	上海市集成电路行业协会	副秘书长
金敬长	独立董事	昆山中辰矽晶有限公司	总经理
		元鸿（山东）光电材料有限公司	董事长
		上海召业申凯电子材料有限公司	董事长
		昆山辰巨电子科技有限公司	董事长
		忻州元鸿信息材料有限公司	执行董事
陈红燕	独立董事	上海分值医学科技有限公司	总经理
		上海宏蒙教育科技有限公司	监事
		江苏捷峰高科能源材料股份有限公司	监事
		医发（上海）智能科技有限责任公司	执行董事

（五）董事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

1、直接持股情况

截至报告期末，公司时任董事、高级管理人员及核心技术人员直接持股的情况如下：

姓名	职务	直接持股数（股）	直接持股比例
骈文胜	董事长、总经理、核心技术人员	112,696	0.07%
闻国涛	董事、副总经理、核心技术人员	88,123	0.05%
路峰	董事、副总经理、核心技术人员	88,123	0.05%
王沛	职工代表董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	66,601	0.04%
刘琨	副总经理、核心技术人员	48,713	0.03%
合计	/	404,256	0.24%

2、间接持股情况

截至报告期末，公司时任董事、高级管理人员及核心技术人员间接持股的情况如下：

序号	姓名	职务	间接持股主体	持股主体持有公司股份数量（股）	持有持股主体的权益比例	间接持股比例
1	骈文胜	董事长、总经理、核心技术人员	蕊测半导体	45,685,496	51.54%	14.49%
			宁波芯伟	1,548,525	52.69%	
2	闻国涛	董事、副总经理、核心技术人员	蕊测半导体	45,685,496	25.92%	7.18%
			宁波芯伟	1,548,525	15.20%	
3	路峰	董事、副总经理、核心技术人员	蕊测半导体	45,685,496	9.60%	2.78%
			宁波芯伟	1,548,525	18.24%	
4	刘琨	副总经理、核心技术人员	宁波芯伟	1,548,525	3.04%	0.03%
5	王沛	职工代表董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	宁波芯伟	1,548,525	6.44%	0.06%

截至报告期末，除上述人员外，公司其他时任董事、高级管理人员及核心技术人员不存在间接持股的情形。

（六）董事、监事和高级管理人员及核心技术人员变动情况

最近三年，公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员的变动具体情况如下：

1、董事变动情况

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司于2023年7月18日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过骈文胜先生、闻国涛先生、路峰先生、陈凯先生、

于波先生、祁耀亮先生为公司第二届董事会非独立董事，林秀强先生、王怀芳先生、宋海燕女士为公司第二届董事会独立董事。董事会换届选举完成后，徐伟先生不再担任公司独立董事，宋海燕女士担任公司第二届董事会独立董事。

2024年4月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，公司董事祁耀亮先生因工作变动原因辞去公司第二届董事会非独立董事职务。经公司董事会对王沛女士的提名，董事会提名委员会进行了资格审查并审核通过，公司补选王沛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2024年10月15日，于波先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事职务。

2025年10月24日，公司召开职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，选举王沛女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王沛女士原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

2026年7月15日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举骈文胜、闻国涛、宋海燕、金敬长、陈红燕为公司第三届董事会成员，其中宋海燕、金敬长、陈红燕为独立董事。同日，公司职工代表大会选举王沛为公司第三届董事会职工代表董事。

报告期内，公司董事的上述变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、监事变动情况

2023年6月30日，因公司第一届监事会任期届满，发行人召开职工代表大会，选举乔从缓担任公司第二届监事会职工代表监事；2023年7月18日，发行人召开2023年第一次临时股东大会选举产生的两名监事周歆瑶、高晓，共同组成公司第二届监事会。

2025 年 9 月 9 日，发行人召开 2025 年第三次临时股东大会，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定取消监事会。

3、高级管理人员变动情况

2026 年 7 月 15 日，发行人第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》，聘任骈文胜为公司总经理，聘任闻国涛、路峰、王沛为公司副总经理，聘任王沛为公司财务总监、董事会秘书。

报告期内，公司高级管理人员的上述变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、核心技术人员变动情况

2026 年 7 月 16 日，公司披露《关于核心技术人员变动的公告》，公司副总经理、核心技术人员刘琨先生因换届离任，不再担任公司副总经理且不再直接参与公司具体研发工作，但仍在公司其他岗位任职。基于其工作职责发生变化，公司不再认定刘琨先生为核心技术人员。

报告期内，公司核心技术人员上述变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（七）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

1、员工持股平台

截至**报告期末**，公司共设有 1 个以员工持股为主要目的合伙企业宁波芯伟，宁波芯伟直接持有发行人 1,548,525 股，占发行人总股本的 0.92%。

截至**报告期末**，宁波芯伟共有合伙人 9 名，其中，吉晋阳为普通合伙人、执行事务合伙人，其余人员为有限合伙人。该持股平台的具体情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例	合伙人类型
1	骈文胜	650	货币	38.92%	有限合伙人
2	路峰	300	货币	17.96%	有限合伙人
3	闻国涛	250	货币	14.97%	有限合伙人

序号	合伙人名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例	合伙人类型
4	王沛	150	货币	8.98%	有限合伙人
5	龚金新	110	货币	6.59%	有限合伙人
6	吉晋阳	90	货币	5.39%	普通合伙人
7	刘琨	50	货币	2.99%	有限合伙人
8	乔从缓	40	货币	2.40%	有限合伙人
9	周歆瑶	30	货币	1.80%	有限合伙人
合计		1,670	-	100.00%	/

2、发行人对员工的激励计划

截至报告期末，发行人对员工的激励计划如下：

（1）2023 年限制性股票激励计划

公司制定并执行了 2023 年限制性股票激励计划，截至报告期末，该计划的执行情况如下：

2023 年 4 月 19 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于

2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2023 年 6 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十次会议与第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了同意的核查意见。

2024 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。

(2) 2024 年限制性股票激励计划

公司制定并执行了 2024 年限制性股票激励计划，截至报告期末，该计划的执行情况如下：

2024 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会召开了第二次会议，会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。同日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。公司监事会对本激励计划发表了同意的核查意见。

2024 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2024 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2025 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。

2025 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意意见。

（3）2025 年限制性股票激励计划

公司制定并执行了 2025 年限制性股票激励计划，截至报告期末，该计划的执行情况如下：

2025 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，分别审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了同意的意见，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

2025 年 7 月 10 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东

大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

2025 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予事项发表了同意的意见，监事会对本次激励对象名单进行核实并发表了同意的核查意见。

七、发行人所处行业基本情况

公司主营业务为集成电路测试服务，根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“C 制造业”门类下的“C3973 集成电路制造”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1. 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造”。此外，公司所属的行业还是国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（2024 年修订）中的“鼓励类”产业。

公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司目前拥有晶圆测试、芯片成品测试及测试方案开发、SLT 测试、老化测试等全流程测试服务，测试的晶圆和成品芯片在类型上涵盖 AI 芯片、CPU、GPU、DPU、SoC 芯片、FPGA、MCU、存储芯片、射频芯片、高端 CIS 芯片等芯片种类，在工艺上涵盖各类制程，在晶圆尺寸上涵盖 12 英寸、8 英寸、6 英寸等主流产品，在下游应用上包括数据中心、通讯、计算机、汽车电子、工业控制、消费电子等领域。

（一）行业监管体系及最近三年监管政策的变化

1、行业主管部门及监管体制

公司行业主管部门主要为工信部，该部门主要职责为：制定行业发展战略、发展规划及产业政策；拟定技术标准，指导行业技术创新和技术进步；组织实施与行业相关的国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

中国半导体行业协会是公司所属行业的行业自律组织，主要负责贯彻落实政府产业政策；开展产业及市场研究，向会员单位和政府主管部门提供咨询服务；行业自律管理；代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。

工信部和中国半导体行业协会构成了集成电路行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

2、行业主要法律法规及政策

公司所属行业为集成电路制造业。二十一世纪以来，国家和地方政府出台了一系列法律法规与行业发展规划，将集成电路产业确定为战略性新兴产业之一，全力促进集成电路行业的发展。具体法律法规与行业发展规划如下：

序号	颁布时间	颁布单位	政策名称	相关内容
1	2026 年	发改委、工信部、财政部、海关总署、税务总局	《关于做好2026年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》（发改高技〔2026〕487号）	明确2026年享受税收优惠政策的集成电路企业清单制定程序、条件和标准；涵盖线宽小于28nm/65nm/130nm的集成电路生产企业、重点集成电路设计企业、先进封装测试企业、关键原材料及零配件生产企业等。
2	2025 年	中共中央	《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》	对集成电路等关键领域提出重要发展建议：完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
3	2025 年	国务院	《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》	明确支持AI芯片攻坚与国产生态培育；5000亿元新型政策性金融工具重点投向半导体等新兴产业；地方政府将半导体列为"一号工程"，2025年半导体设备国产化率目标70%。
4	2024 年	发改委、工信部、财政部、海关总署、税务总局	《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2024〕351号）	延续集成电路企业税收优惠政策，覆盖28nm/65nm/130nm以下生产企业、重点设计企业等；2023年已入清单企业2024年需重新申报；实行"地方初核-国家联审"机制。
5	2023 年	工信部、教育部、科学技术部、中国人民银行、中国银行保险监督管	《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》	抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，推动能源电子产业发展，狠抓关键核心技术攻关，创新人才培养模式，推进能源生产和消费革命，加快生态文明建设，确保碳达

序号	颁布时间	颁布单位	政策名称	相关内容
		理委员会、国家能源局等		峰碳中和目标实现。

（二）发行人所处行业近三年在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势

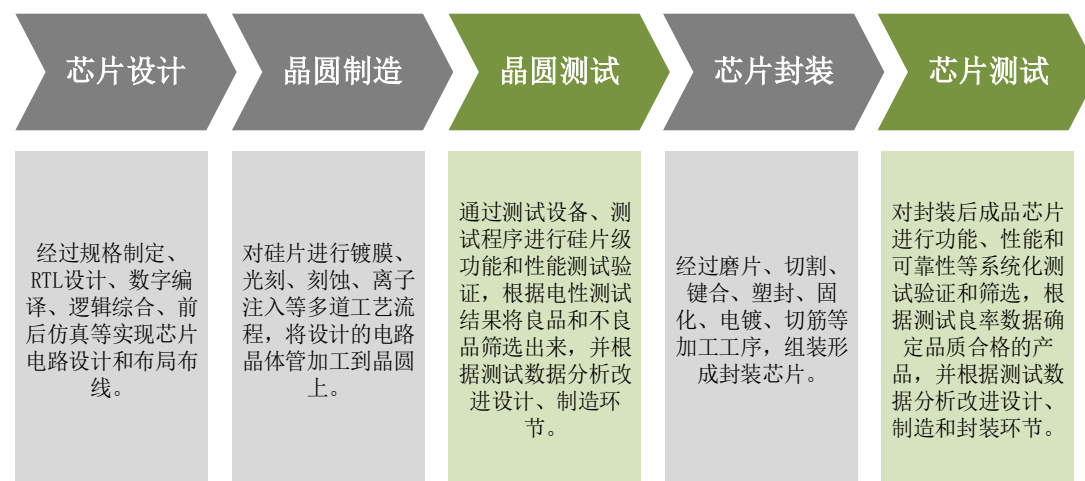
1、行业近三年在科技创新方面的发展情况

（1）集成电路行业发展概况

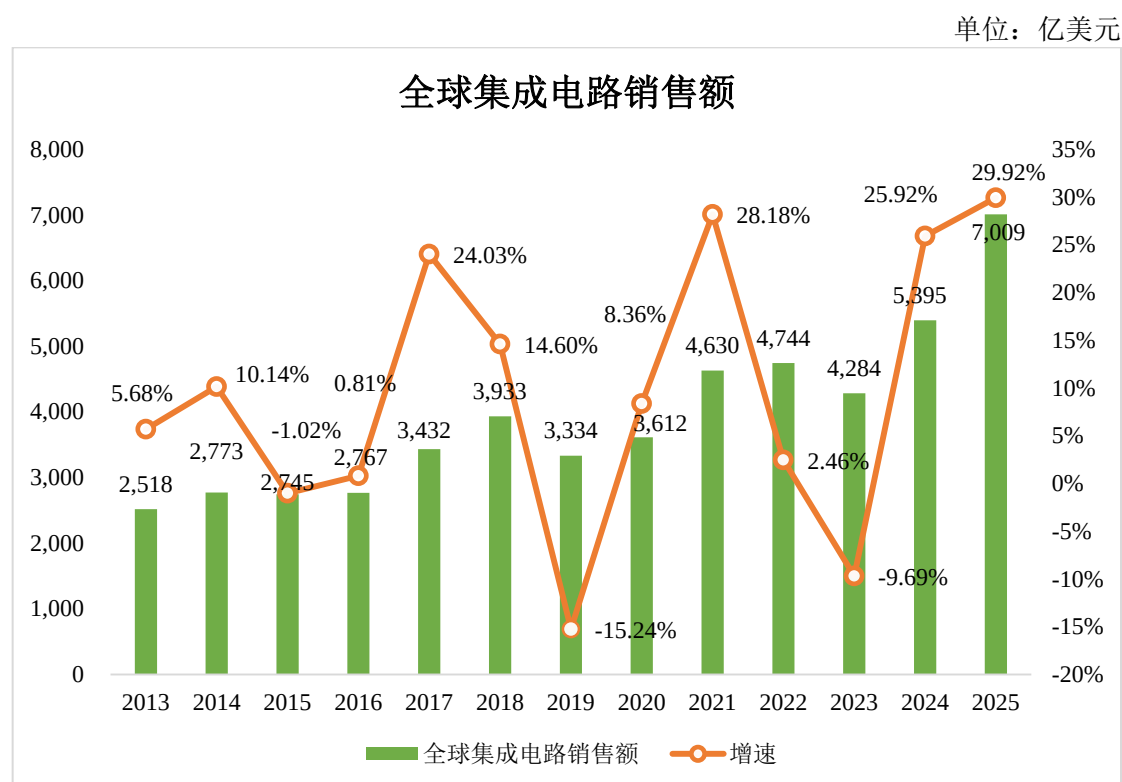
集成电路（Integrated Circuit，IC）是 20 世纪 50 年代后期发展起来的一种新型半导体器件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。

集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备，是计算机、家用电器、数码电子、工业控制、通信、航天等诸多产业发展的基础，是现代工业的生命线，也是改造和提升传统产业的核心技术。同时集成电路行业的推动作用强，倍增效应大，在国民经济发展上发挥着重要作用。

集成电路产业链包括芯片设计、制造、封装和测试等环节，各个环节目前已分别发展成为独立、成熟的子行业。按照芯片产品的形成过程，集成电路设计行业是集成电路行业的前端。集成电路设计企业设计的产品方案，通过代工方式由晶圆代工厂商、封装厂商、测试厂商完成芯片的制造、封装和测试，然后将芯片产成品作为元器件销售给电子设备制造厂商。



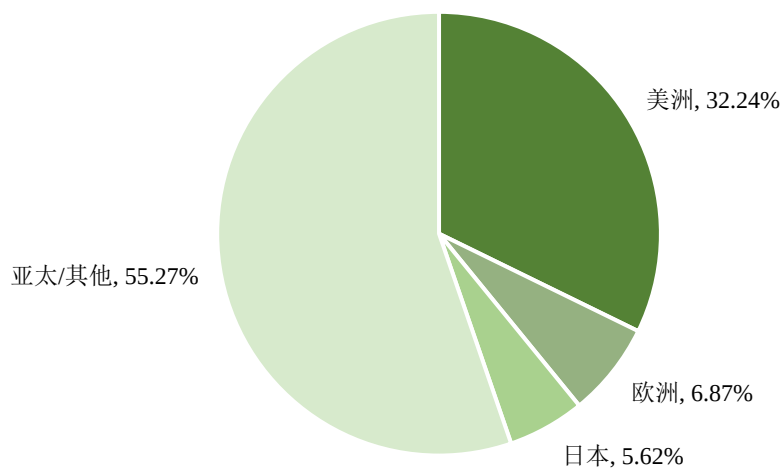
根据世界半导体贸易统计组织的统计数据，2013 年至 2025 年期间，全球集成电路产业收入年均复合增长率为 8.91%。2013 年至 2018 年期间，全球集成电路行业呈现快速增长趋势，行业规模由 2,517.76 亿美元增长至 3,932.88 亿美元。2019 年，受国际贸易摩擦冲击的影响，全球集成电路产业总收入为 3,333.54 亿美元，较 2018 年度下降 15.24%。随着贸易摩擦问题的缓解，5G 通信、物联网、人工智能等下游应用市场需求的持续增长，2020 年度及 2021 年度市场规模保持快速增长。2022 至 2023 年度受到宏观经济下行压力、下游消费电子行业需求疲软等影响，全球集成电路行业景气度有所调整，增速放缓。2023 年四季度以来集成电路行业需求呈明显复苏态势，受益于人工智能的爆发，开启了一个全新的、增长更强劲的“超级周期”。根据世界半导体贸易统计组织 2026 年 6 月预测，2026 年全球半导体市场销售额预计增长至 15,112 亿美元。



数据来源：全球半导体贸易统计组织（WSTS）

集成电路区域分布方面，亚太地区（含中国）已经成为全球最大的半导体市场。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据统计，2025 年亚太地区（含中国）为集成电路产业第一大市场，销售额占比达 55.27%，美洲位居次位，销售占比为 32.24%，欧洲是第三大市场，占比 6.87%。

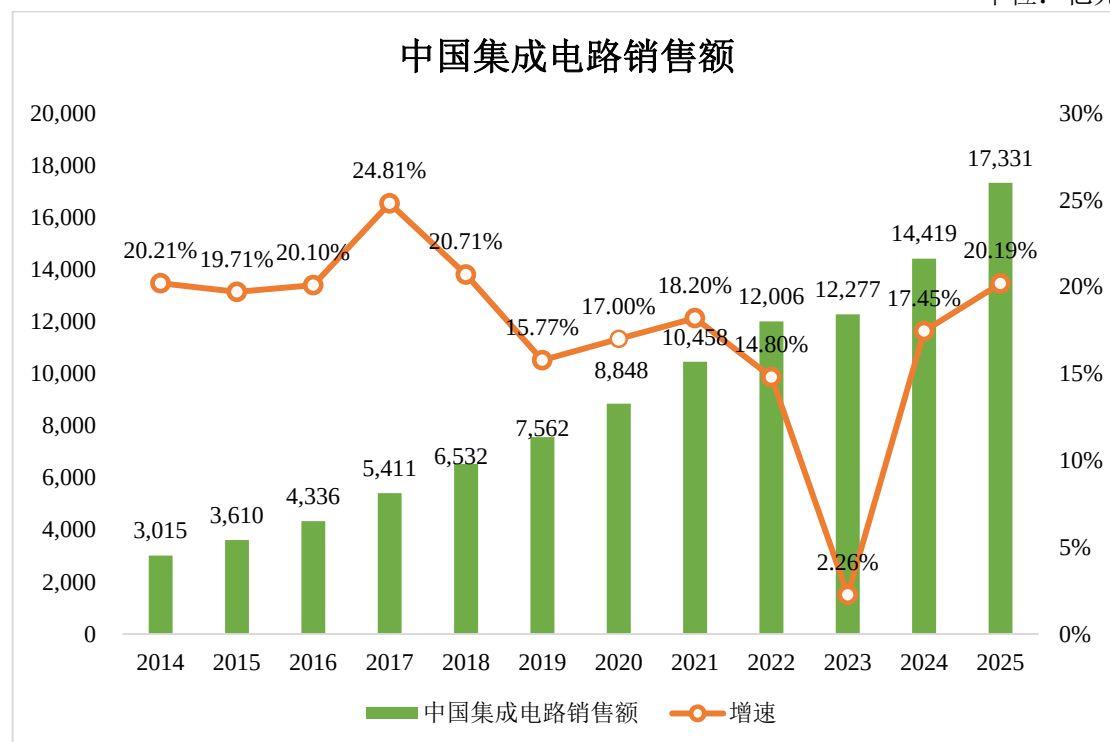
2025年全球半导体市场地区分布



数据来源：SIA、世界半导体贸易统计组织（WSTS）

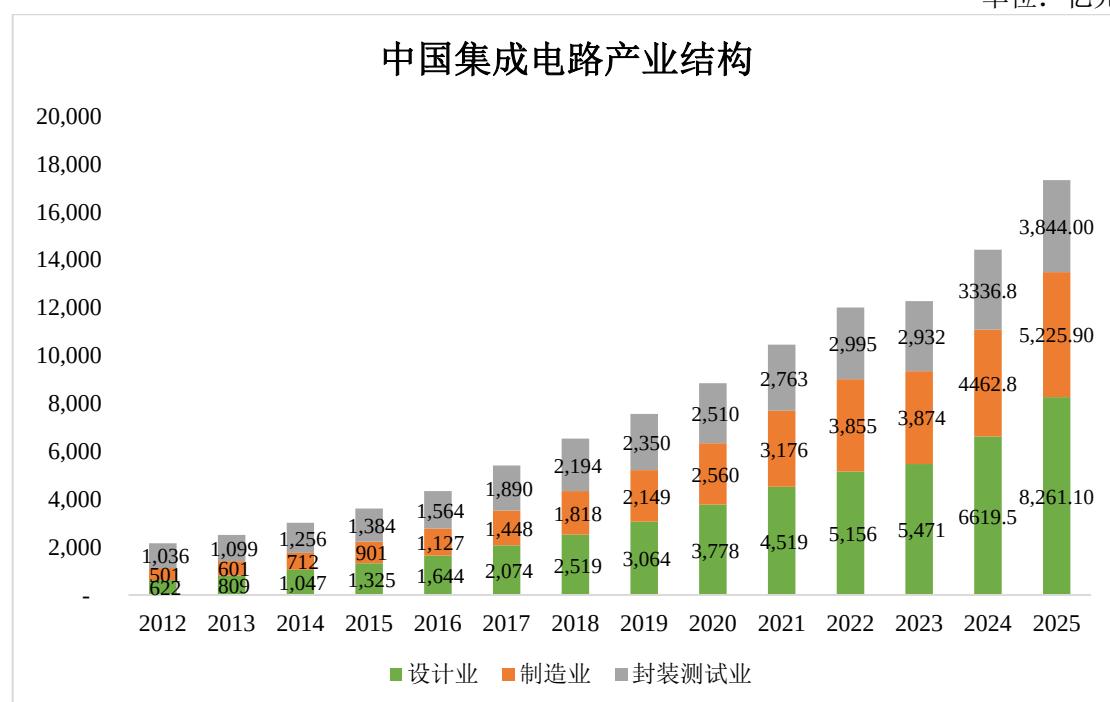
中国已经成为全球最大的集成电路市场之一。近年来，中国集成电路产业实现了长足发展，从市场规模的角度看，中国集成电路产业 2003-2025 年的年均复合增长率为 **19.39%**，已由 2003 年的 351.40 亿元扩大到 2025 年的 17,331.00 亿元。除了规模的提升，我国在设计、制造、封测、装备、材料全产业链环节取得诸多创新成果，企业自主创新能力不断提升，超摩尔领域加速兴起，跨学科、跨领域、跨区域协同创新日趋活跃。未来，在 5G、智能网联汽车、人工智能、超高清视频等新兴应用驱动下，我国集成电路产业的市场需求仍将不断增长。根据中国半导体行业协会统计，2025 年中国集成电路产业销售额为 17,331.00 亿元，同比增长 20.19%；其中据中国半导体行业协会数据，设计业销售额为 8,261.1 亿元，制造业销售额为 5,225.9 亿元，封装测试业销售额为 3,844.0 亿元。

单位：亿元



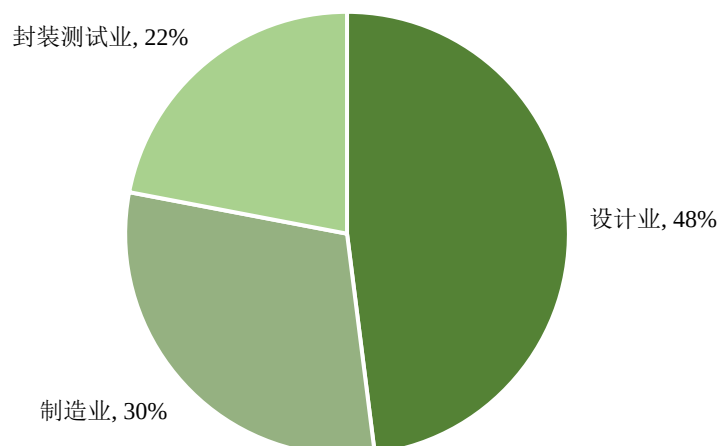
数据来源：中国半导体行业协会数据、上海市集成电路行业协会整理

单位：亿元



数据来源：中国半导体行业协会

中国集成电路产业结构比例（2025年）



数据来源：中国半导体行业协会

（2）集成电路测试行业发展概况

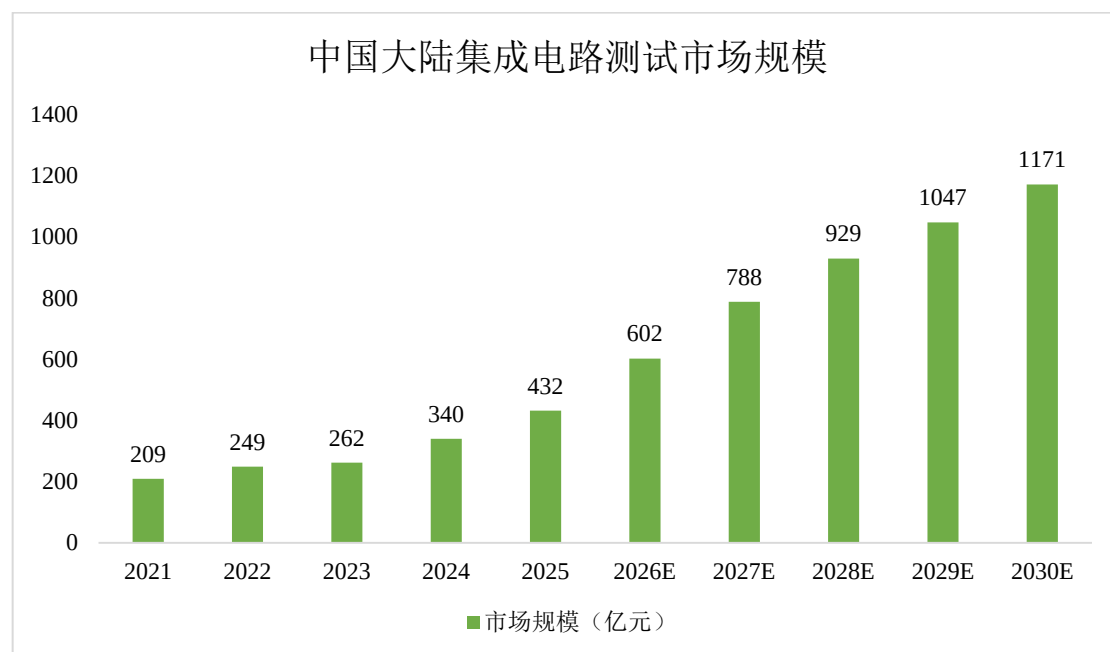
从产业链的环节来看，集成电路测试主要包括晶圆测试和芯片成品测试，两者在产业链的位置如下：



集成电路测试在集成电路产业链中有着举足轻重的作用，集成电路产品开发的成功与失败、产品生产的合格与不合格、产品应用的优秀与不良均需要验证与测试。随着集成电路产业的发展，在“封测一体化”的商业模式上，诞生了“独立第三方测试服务”的新模式，这是行业专业化分工的产物，也是行业追求更高效率的必然结果。“独立第三方测试服务”模式诞生于集成电路产业高度发达的中国台湾地区，并经过 30 年的发展和验证，证明了该模式符合行业的发展趋势。

全球半导体产业链重构与国内自主可控战略双轮驱动下，中国大陆集成电路测试市场正迎来高速增长期。随着本土芯片持续向中高端跃迁，高复杂度芯片的测试需求不断攀升，推动产业规模持续扩大。据灼识咨询统计，2025 年中国大陆集成电路测试市场规模已达 432 亿元。展望未来，受益于高端算力芯片、

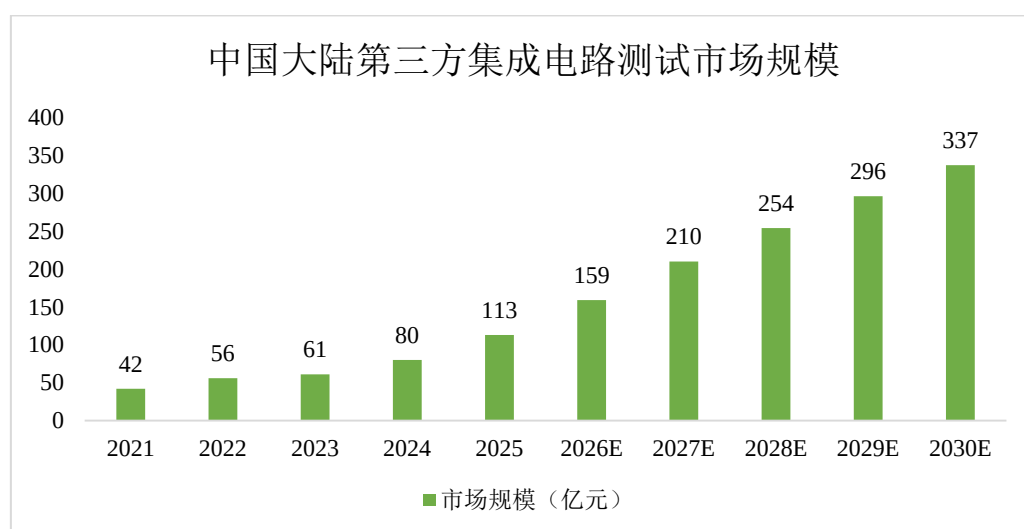
高端 SoC 及汽车电子等复杂产品测试需求的集中释放，预计到 2030 年市场规模将突破 1,171 亿元，2025—2030 年间年均复合增长率达 22.1%。



数据来源：灼识咨询

随着集成电路产业分工持续深化，第三方独立测试模式凭借专业性与独立性优势加速发展。制程演进及先进封装推动芯片测试复杂度显著提升，测试专业性已成为产业关键瓶颈；加之测试设备资本投入门槛较高，专业厂商通过规模效应可实现产业链成本与效率的最优配置，契合行业分工趋势。

据灼识咨询数据，2025 年境内第三方测试市场规模约 113 亿元，占整体集成电路测试服务市场约 26%；预计至 2030 年将增至 337 亿元，2025—2030 年复合增长率约 24.5%，市场占比有望随专业化分工深化持续提升。



数据来源：灼识咨询

（3）集成电路测试行业近三年在科技创新方面的发展情况

近年来随着端侧算力，具身智能，新能源汽车等领域新型应用终端的涌现，对 AI 算力芯片（CPU、GPU）、存储芯片（DRAM、HBM，Flash）和高端 CIS 芯片的需求不断增长。这几类芯片结构更为复杂，需求增长极快，集成电路测试行业逐渐进入到“复杂性时代”。

①针对 AI 算力芯片，测试行业近几年的创新情况

随着国产先进工艺的发展的产能扩充，国产 AI 训练算力芯片在过去一两年逐渐起量，在云端算力中扮演了越来越重要的角色，同时端侧 AI 被认为是下一阶段 AI 领域最大增长的部分，具身智能，移动端，智能汽车等对算力需求日益提高，国产端侧算力芯片特别是 3D 封装方案的推进指明了发展的方向。

随着算力的增大，产品的功耗在以每年翻倍的速度迅速提高，新的 3D 封装也带来了芯片物理形态的变化，这些变化对测试带来了巨大的挑战，行业通过引入更先进的设备，如探针台，分选机，老化炉等，增加对产品测试过程的管控，在不损坏高价值产品的前提下完成测试的完整覆盖。

②针对存储芯片，测试行业近几年的创新情况

随着 AI 算力的快速发展，存储芯片进入了前所未有的大周期，不管在云端还是端侧对存储芯片的需求量都高速增加，这对测试带来了巨大的机会。

存储测试是一个独立的领域，使用的测试机和相关配套的分选机和老化设备等都是专用的，存储测试因为时间比较久，无论 CP 还是 FT 都会追求更高的同测数来降低测试成本，需要更高集成度的测试机和更高同测数的分选机，探针台及探针卡，这类型的探针卡因为面积较大，对平整度和产线环境有较高的要求。

同时对于 3D 封装芯片的发展，其中包含的多层 DRAM 和 SOC 芯片的结合，也对测试带来了更多样性的要求，需要在 CP 阶段针对 DRAM 和 SOC 分别测试，芯片老化阶段也要兼顾 DRAM 和 SOC 芯片的不同特点设计老化方案以达到高覆盖率和产出效率的要求。

③针对高端 CIS 芯片，测试行业近几年的创新情况

高端 CIS 芯片随着国产化率的日益提高，对国内测试产能的需求也在与日俱增，同时，因为在汽车和具身智能上摄像头数量的逐年提升，也对整个高端 CIS 市场的需求带来快速增长。

高端 CIS 芯片的测试也是一个独立的测试领域，相关的设备包含测试机/探针台/分选机也都是特别定制的，同时因为成像效果对灰尘的敏感性，对生产环境的无尘等级要求比较高。行业通常会为 CIS 芯片的测试建立专区，通过对无尘等级的管控，批量特种测试设备和定制的测试流程完成 CIS 芯片 CP/FT 的完整测试流程。

2、集成电路测试行业发展现状及未来发展趋势

（1）全球集成电路测试代工产业主要分布于亚洲，尤其集中在中国台湾及中国大陆

全球主要封测一体厂商及独立第三方测试厂商的总部及其生产基地主要分布在亚洲，具体包括中国台湾、中国大陆、新加坡、韩国、日本和马来西亚。根据芯思想研究院数据，2025 年全球前十大封装测试厂商排名中，中国大陆有 5 家，中国台湾有 3 家，8 家合计市占率为 66.02%，且多数厂商仍处于快速增长阶段。全球前十大封装测试厂商中，除了京元电子为独立第三方测试厂商外，其余 9 家都是封测一体厂商。

（2）中国台湾地区的独立第三方测试产业处于全球领先地位

1987 年，京元电子成立，开启了行业最早的独立第三方测试服务模式。中国台湾地区是最早形成规模化的独立第三方测试代工产业的地区，其拥有的第三方测试企业在数量、规模、技术和市场份额上都处于全球领先地位。根据中国台湾半导体产业协会统计，2025 年中国台湾地区集成电路测试业市场规模为 2,286 亿新台币，中国台湾地区提供测试服务的厂商中，京元电子、矽格、欣铨三家独立第三方测试厂商是其中的代表性企业，也是全球独立第三方测试厂商前三强。2025 年，京元电子、欣铨、矽格三家独立第三方测试厂商全年营收共计 685.49 亿新台币，在中国台湾地区测试市场的占有率为 29.86%。

（3）封测厂主导中国大陆的测试市场，独立第三方测试厂商加速追赶

目前中国大陆相当比例的测试产能仍然集中在封测一体厂商的测试部门。

以中国大陆最大的封测厂商长电科技为例，其 2019 年的测试收入达 20 亿元（长电科技 2020 年以后年份的测试收入未公开披露），业务规模领先于第三方测试企业。然而，在专业测试需求不断扩大的背景下，封测厂面临测试产能结构性失衡和测试方案开发能力不足的困境。与此同时，独立第三方测试厂商凭借专业的技术水平和高效的服务速度，在测试行业的市场地位将不断提高。最近几年，中国大陆第三方测试的 4 家代表性的内资企业中伟测科技、利扬芯片和华岭股份陆续完成 IPO 上市并持续扩大测试产能，朗迅科技正处于 IPO 阶段，已形成加速追赶的态势。

（4）中国大陆独立第三方测试厂商规模较小，还处于发展的初期，未来发展空间较大

从发展时间上看，中国大陆独立第三方测试行业起步较晚，目前规模最大的四家企业中，除了华岭股份成立相对较早外，伟测科技、利扬芯片、朗迅科技分别成立于 2016 年、2010 年、2010 年，成立时间较短。从规模上看，四家企业与京元电子、欣铨、矽格等全球一流第三方测试代工企业在体量上差距较大。2025 年度，中国大陆最大的四家独立第三方测试企业伟测科技、朗迅科技、利扬芯片、华岭股份合计营收约为 45.73 亿元，仅占中国大陆的测试市场份额的 7.82%，而京元电子、欣铨、矽格合计营收为 685.49 亿新台币，在中国台湾地区测试市场的市占率为 29.86%。因此，无论从成立时间、目前规模、收入占比等角度看，中国大陆独立第三方测试厂商还处于发展的初期，随着我国测试行业市场规模的快速扩张以及独立第三方测试厂商专业化优势进一步显现，独立第三方测试厂商未来发展空间较大。

（5）芯片的高端化和封装制程的先进化进一步推动测试产能扩产

随着芯片设计的高端化，SoC 芯片、Chiplet 芯片等成为主流，以及圆片级封装（WLP）、2.5D 封装、3D 封装、Chiplet 等先进封装工艺的普及，将不同芯片进行统一封装、整合，在不进一步提升芯片制程的前提下实现芯片的小型化、轻薄化、集成化，已成为“后摩尔时代”提升芯片整体表现的最佳选择之一。

单颗芯片的价值量越来越高，为之配套的测试服务的重要性越发突出，测

试厂商需要解决多芯片协同测试带来的故障定位困难、测试需求冲突，高密度封装带来的测试接口限制，高功耗密度带来的热测试复杂性等一系列问题，测试从“单芯片级”向“系统级”跨越，对测试厂商的技术研发能力、产业链协同能力提出了进一步要求。

在该测试能力要求背景下，测试厂商集中进行高端芯片测试能力扩产，以应对芯片的高端化和封装制程的先进化。

（6）行业自主可控需求强烈，供应链本土化进程加速

根据中国海关总署的统计，2025 年度我国集成电路进口金额为 4,243.3 亿美元，且进出口逆差 2,224 亿美元，行业国产化渗透率较低。在地缘技术管制持续升级背景下，集成电路测试环节供应链安全风险凸显，倒逼国内封测产业将测试设备、测试方案自主可控上升为核心战略，国家主管部门及各级地方政府也相继推出了一系列产业、税收、研发等方面的政策和激励措施，鼓励各类产业基金、PE、VC 等社会资本聚焦“卡脖子”核心技术环节和关键企业进行投资布局，着力降低长期资本在投早、投小、投硬科技时的风险顾虑，推动形成“政策引导—市场主导—资本反哺”的良性循环，从而加速产业链关键瓶颈环节的实质性突破。

根据中国半导体行业协会数据，我国集成电路制造行业规模已从 2012 年的 501 亿元快速增长至 2025 年的 5,226 亿元。中国作为全球最大的集成电路消费市场和全球主要的芯片制造国，供应链的本土化有助于降低集成电路物流运输成本、缩短产品交付周期，有利于市场效率的提升和成本的优化，有利于产业链协同发展，技术进步。随着境内集成电路产能的快速扩张，测试、封装等一系列需求也将随之增长，并将进一步加速集成电路供应链的本土化进程。

（三）行业竞争格局、市场集中情况

1、两类竞争主体的市场占有率及变化趋势

集成电路测试服务最初主要由封测一体企业的测试部门对外提供，随着行业分工的细化，出现了独立第三方测试的模式并发展壮大，因此市场上存在“封测一体企业”和“独立第三方测试企业”两类企业参与测试行业的竞争。目前尚无两类模式各自市场占有率的权威统计数据，但中国台湾地区最大的三

家独立第三方测试企业合计收入占中国台湾地区测试市场比重接近 30%，可以从侧面反映两者的市场占有率情况。由于独立第三方测试企业在技术的专业性、服务品质、服务效率、公正性等方面存在较明显的优势，中国台湾和中国大陆主要的独立第三方测试企业都表现出高于行业平均的增速，可以推断独立第三方测试企业的市场占有率保持持续上升。

2、两类竞争主体的竞争与合作情况

“封测一体企业”和“独立第三方测试企业”之间保持了特殊的竞争和合作关系。随着先进封装制程的资金投入越来越大，以及测试技术难度的提升，封测一体厂商将主要精力和资金专注于封装业务，将测试业务外包给独立第三方测试企业来完成的比例越来越高。在晶圆测试方面，“封测一体企业”和“独立第三方测试企业”的合作多于竞争，前者的封装业务与晶圆测试业务关联度较低，因此将晶圆测试业务大量外包给后者；在芯片成品测试方面，“封测一体企业”和“独立第三方测试企业”的竞争与合作共存，前者将部分业务外包给后者的同时，自身也在发展芯片成品测试业务。

3、封测一体企业的竞争格局

封装测试是集成电路产业链的重要环节，经过多年的竞争，封测行业已经形成一批封测一体巨头。根据中商产业研究院的数据，2025 年全球封测市场规模超过 1,000 亿美元。全球排名前三的封测一体企业为日月光、安靠科技和长电科技；中国大陆排名前三的封测一体企业为长电科技、通富微电和华天科技，分别位列全球第三、第四和第五。

4、独立第三方测试企业的竞争格局

从全球来看，独立第三方测试的模式发源于中国台湾地区，经过多年发展，已经涌现出多家大型企业。其中，京元电子、欣铨、矽格是中国台湾地区规模最大的三家企业，同时也是全球最大的三家独立第三方测试企业，2025 年，京元电子、欣铨、矽格三家独立第三方测试厂商全年营收共计 685.49 亿新台币，在中国台湾地区测试市场的占有率为 29.86%。

从中国大陆来看，根据半导体综研的统计，中国大陆独立第三方测试企业共有 107 家，主要分布在无锡、苏州、上海、深圳以及东莞。根据各家企业公

开披露的数据，目前中国大陆收入规模超过 1 亿元的独立第三方测试企业主要有京隆科技、伟测科技、朗迅科技、利扬芯片、华岭股份、上海旻艾等少数几家公司。由于中国大陆的独立第三方测试企业起步较晚，因此呈现出规模小、集中度低的竞争格局，但是以伟测科技、朗迅科技、利扬芯片为代表的内资企业近几年发展速度较快，行业的集中度正在快速提升。

（四）发行人产品或服务的市场地位、主要竞争对手

1、发行人的市场地位

公司是国内领先的独立第三方集成电路测试企业，先后被评为国家高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业、浦东新区企业研发机构。自 2016 年 5 月成立以来，公司经营业绩实现了高速增长，成为第三方集成电路测试行业成长性较为突出的企业之一。截至目前，公司已经发展成为第三方集成电路测试行业中规模排名前列的内资企业之一。

公司积极把握集成电路测试产业国产化的历史机遇，一方面加大研发投入，重点突破各类高端芯片的测试工艺难点，另一方面大力扩充高端测试的产能规模。截至本募集说明书出具日，公司高端测试设备机台数量在中国大陆行业领先，已经成为中国大陆高端芯片测试服务的主要供应商之一。

公司的技术实力、服务品质、产能规模获得了行业的高度认可，积累了广泛的客户资源，其中不乏客户 A、客户 C、紫光展锐、中兴微电子、晶晨股份、兆易创新、复旦微电、比特大陆、安路科技、客户 B、甬矽电子、卓胜微、普冉股份、中芯国际、瑞芯微、纳芯微、集创北方、翱捷科技等知名厂商。

2、行业内的主要竞争对手

全球及中国大陆主要封测一体企业介绍如下：

单位：人民币亿元

公司简称	地区	公司介绍	2025 年度 营业收入	2025 年度 净利润
日月光	中国台湾	日月光投资控股股份有限公司（3711.TW）成立于 1984 年，是全球领先的半导体封装与测试服务企业，主营业务包括晶圆前段测试、晶圆测试、封装、材料及成品测试的一站式服务。2017 年日月光并购矽品精密之后，成为全球第一大封测企业，2025 年全球市占率为	1,413.40	89.04

公司简称	地区	公司介绍	2025 年度 营业收入	2025 年度 净利润
		26.1%。		
安靠科技	美国	安靠科技股份有限公司（AMKR.NASDAQ）成立于 1986 年，是全球第一家提供半导体封装和测试服务的外包商，目前为全球第二大封测代工厂商。安靠的主营业务为半导体封装和测试服务，具体包括晶圆凸点、晶圆测试、晶圆背面研磨、封装设计、封装、系统级和最终测试。	479.14	26.71
长电科技	中国大陆	江苏长电科技股份有限公司（600584.SH）成立于 1998 年 11 月，主营业务包括集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试并可向世界各地的半导体客户提供直运服务。长电科技是中国大陆第一大封测厂商。	388.71	15.65
通富微电	中国大陆	通富微电子股份有限公司（002156.SZ）成立于 1994 年 2 月，主营业务为集成电路封装测试、圆片测试、系统测试，是中国大陆第二大集成电路封测企业。	279.21	12.19
华天科技	中国大陆	天水华天科技股份有限公司（002185.SZ）成立于 2003 年 12 月，主营业务为集成电路封装测试，是中国大陆第三大集成电路封测企业。	172.14	7.11

注：日月光、安靠科技营业收入、净利润根据对应计价币种兑人民币全年平均汇率计算

全球及中国大陆主要独立第三方测试企业介绍如下：

单位：人民币亿元

公司简称	地区	公司介绍	2025 年度 营业收入	2025 年度 净利润
京元电子	中国台湾	京元电子股份有限公司（2449.TW）成立于 1987 年 5 月，主营业务为半导体产品的封装测试业务，测试服务项目包括：晶圆针测、IC 成品测试、预烧测试、封装及其他项目。截至 2022 年末，京元电子的晶圆测试产能 909 万片/年，芯片成品测试产能 186 亿颗/年，测试设备总数超过 4,500 台，是全球最大的专业测试厂之一。	80.56	25.50
欣铨	中国台湾	欣铨科技股份有限公司（3264.TWO）成立于 1999 年，主要经营业务为存储芯片晶圆测试、数字芯片及混合信号芯片的晶圆和成品测试、晶圆型预烧测试，为中国台湾地区前三大的晶圆测试厂，也是全球主要的第三方测试代工厂商之一。	32.35	6.55
矽格	中国台湾	矽格股份有限公司（6257.TWO）成立于 1996 年，主营业务为半导体封装和测试。矽格拥有超过千台的测试机台，为中国台湾地区前三大的晶圆测试厂，也是全球主要的第三方测试代工厂商之一。	45.17	7.68

公司简称	地区	公司介绍	2025 年度 营业收入	2025 年度 净利润
朗迅科技	中国大陆	杭州朗迅科技股份有限公司成立于 2010 年 5 月，专注于第三方集成电路测试业务，为国产自主可控芯片核心客户及产业链参与方提供芯片成品测试（FT）、晶圆测试（CP）及相关测试配套服务。朗迅科技是中国大陆独立第三方测试领域的龙头企业之一。	20.64	6.20
利扬芯片	中国大陆	广东利扬芯片测试股份有限公司（688135.SH）成立于 2010 年 2 月，主营业务包括集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。公司产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子及工控等领域。利扬芯片是中国大陆独立第三方测试领域的龙头企业之一。	6.18	-0.09
华岭股份	中国大陆	上海华岭集成电路技术股份有限公司（920139.BJ）成立于 2001 年 4 月，主营业务为集成电路测试服务，具体包括测试技术研究、测试软硬件开发、测试装备研制、测试验证分析、晶圆测试、集成电路成品测试、可靠性试验、自有设备租赁。华岭股份是中国大陆独立第三方测试领域的龙头企业之一。	3.16	-0.56

注：京元电子、欣铨及矽格营业收入、净利润根据对应计价币种兑人民币全年平均汇率计算

（五）发行人的主要竞争优势

1、人才优势

集成电路产业属于智力密集型行业，人才是集成电路企业最关键的要素。公司的核心团队深耕集成电路行业二十余年，是国内最早从事集成电路测试的一批资深人士，曾参与建立了中国大陆最早的晶圆测试工厂威宇科技测试封装（上海）有限公司。团队主要成员曾先后在摩托罗拉、日月光、长电科技等全球知名半导体企业或封测龙头企业从事测试业务技术研发和管理工作，拥有深厚的专业背景，对测试技术研发、测试方案开发、量产导入、精益生产、测试产线自动化管理有着丰富的实践经验，并且在市场研判、行业理解等方面具备领先于同行业的洞察力。公司亦高度重视研发人才的培养与引进。截至报告期末，公司研发技术人员占比近 20%，强大的研发团队保障了公司在技术方面的领先地位。

2、技术优势

公司自创立之初就定位于专业的独立第三方集成电路测试服务商，通过技

术研发和工艺升级提高测试服务的品质是公司始终的诉求。公司的技术先进性主要体现在测试方案开发能力强、测试技术水平领先和生产自动化程度高三个方面。在测试方案开发方面，公司突破了 5G 射频芯片、高性能 CPU 芯片、高性能算力芯片、FPGA 芯片、复杂 SoC 芯片等各类高端芯片的测试工艺难点，成功实现了国产化。在测试技术水平方面，公司在晶圆尺寸覆盖度、温度范围、最高 Pin 数、最大同测数、Pad 间距、封装尺寸大小、测试频率等参数上保持国内领先，并与国际巨头持平或者接近。在测试作业的自动化方面，公司对标国际巨头，通过将测试作业中积累的技术和经验融入 IT 信息系统，自主开发了符合行业特点的生产管理系统，提升了测试作业的信息化、自动化、智能化水平，提高了测试作业的准确率和效率。

3、客户优势

公司作为独立第三方测试企业没有封装业务，只有测试业务，因此能够从中立客观的角度公正地向客户呈现测试的客观结果，在此方面更易获得客户的认可。公司持续加大研发投入，重点突破各类高端芯片的测试工艺难点，成为大陆各芯片设计公司高端芯片测试的自主可控的重要供应商之一。公司的技术实力、服务品质、产能规模获得了行业的高度认可，积累了广泛的客户资源。

公司的客户包括了集成电路设计公司、晶圆制造企业、IDM 企业和封装企业，公司营业收入中占比较大的客户为集成电路设计公司，公司客户超过 200 家，其中高端芯片设计公司出于对其自身测试服务需求的把控、成本控制以及风险控制，将为其提供测试业务供应商的选择由境外转向境内。

4、产能规模优势

集成电路测试行业具有“大者恒大”的客观规律，除了备受重视的研发投入规模以外，测试产能规模是集成电路测试企业的核心竞争力之一。充足的产能规模能够吸引客户的重视，是接受行业内高端测试客户订单的必要条件。足够的测试产能还能让公司在行业处于相对上行的周期时快速响应客户的测试需求，在行业处于相对下行的周期时保证一定的生产规模，从一定程度上抵消行业波动对经营产生的不良影响。此外，目前国内大部分测试厂商定位中低端市场，在复杂和高端产品的测试能力上相对欠缺，故高端测试产能相对紧缺；而

进行高端测试需使用高端测试设备，这些设备采购价格较高，交付周期相对较长，且相关设备的研发及生产长期被海外巨头垄断，每年供给的数量相对有限。

与同行业公司相比，公司十分重视产能规模尤其是高端测试产能的建设。基于公司自身战略规划考量、兼顾不同客户的不同测试需求、集成电路行业新产品和终端应用对产品的需求和要求，以及对行业整体发展的认知，2025 年公司积极实施扩产计划，继续购入爱德万 V93000、泰瑞达 UltraFlex Plus、泰瑞达 UltraFlex 等高端测试相关设备。截至目前，公司的产能规模，尤其是高端测试产能规模在中国大陆独立第三方测试企业中处于相对优势水平，高端测试设备数量在中国大陆行业领先。在此基础上，公司进一步夯实了公司在中国大陆独立第三方测试企业中的行业领先地位。

5、区位优势

公司拥有上海、南京、无锡和深圳四个测试基地。公司以长三角市场和珠三角市场为双引擎，连接全球半导体产业链（设计、制造、设备），覆盖中高端制造集群，贴近终端客户，有利于快速响应客户对晶圆测试及芯片成品测试的需求、有利于降低芯片运输损耗与时间成本，有利于灵活调配产能与缩短供应链周期。同时，长三角和珠三角人才储备充足、高校资源丰富，公司在人才招聘上有着巨大优势。最后，长三角和珠三角各地区在产业政策和招商引资上也存在着丰富的优势。为进一步扩大市场占有率，公司已于 2026 年 1 月在成都成立子公司。公司将通过成都项目完善全国战略布局，填补西南区域空白，以此形成覆盖长三角、珠三角、环渤海和西南地区的全国性服务网络。

（六）行业壁垒或主要进入障碍

1、人才壁垒

人才是集成电路测试企业最关键的要素之一。测试厂商的测试方案开发、测试量产都依赖于理论知识和工程经验丰富的技术人员，测试工程师不仅要具备测试方案开发、设备调试等测试相关能力，还要兼备芯片设计、制造等领域的知识和经验。此外，随着芯片设计的高端化以及芯片的先进封装及异构化等趋势，芯片测试难度大幅上升，对从业人员的能力要求也不断提高。国内集成电路测试行业起步晚，相关领域人才相对不足，国内测试厂商需自主培养专业

人才。人才的培养通常需要经过长期的从业经历和持续的实战积累，培养周期长，因此新进入该行业的企业难以在短时间内获取经营所需大量专业人才，使得集成电路测试行业有着较高的人才壁垒。

2、技术壁垒

集成电路测试行业属于技术密集型产业，具备较高的技术壁垒。集成电路测试横跨微电子、硬件设计、软件设计、自动化、大数据分析等多个领域，是多学科、多领域综合的复杂系统工程，专业化程度较高，对测试厂商的测试技术开发和测试工艺有着严苛要求。此外随着摩尔定律的发展，芯片设计的高端化以及芯片的先进封装及异构化等趋势，芯片测试难度大幅上升，这要求测试厂商持续提升技术研发能力，不断开发新的测试方案，引入和调试新的测试平台，以快速响应新产品、新工艺、新制程的测试需求，以上因素形成了集成电路测试行业较高的技术壁垒。

3、客户壁垒

集成电路测试在集成电路产业链中有着举足轻重的作用，贯穿于集成电路设计、芯片制造、封装以及集成电路应用的全过程，在确保芯片良率、控制成本、指导芯片设计和工艺改进等方面起着至关重要的作用。因此，客户对测试服务厂商的测试技术实力和品质管控能力、方案开发能力、快速交付能力均有较高的要求。此外，为满足客户不同阶段、不同型号产品的测试需求，测试厂商需要与客户通过长时间的协作、磨合来改进测试方案，以保证测试服务的效率及其一致性和稳定性。因此，测试服务厂商一旦满足客户的供应商认证标准，进入其供应链体系，就不易被替换，从而形成显著的客户资源壁垒。

4、产能规模壁垒

集成电路行业具有“大者恒大”的规律，产能规模是集成电路测试企业重要的核心竞争力之一。充足的产能规模是承接行业内高端客户测试订单的基本条件，尤其在集成电路景气周期上行时期，拥有足够测试产能的企业会获得各类客户的重视与青睐。足够的产能还能让公司在行业处于相对上行的周期时快速响应客户的测试需求，在行业处于相对下行的周期时保证一定的生产规模，从一定程度上抵消行业波动对经营产生的不良影响。因此，产能规模较大的企

业在承接客户订单和日常经营方面具有明显优势，从而形成了行业的产能规模壁垒。

5、资本壁垒

集成电路测试行业属于资本密集型的重资产行业，有着较高的资本投入壁垒。测试业务所需的测试机、探针台和分选机等测试设备的采购价格相对昂贵、交付周期又相对较长；与此同时，为了维持竞争力，测试服务厂商需持续扩大测试规模，提前购买测试设备来保证充足的测试产能。大额的设备投入对测试服务厂商的资本实力提出了较高要求，从而形成了较高的资本壁垒。

（七）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性及其发展状况

1、与上游行业之间的关联性及其上游行业发展状况

集成电路测试行业上游为测试设备制造商和测试相关辅材、耗材制造商。目前测试公司所采购的主要测试设备多从国外进口，但相关耗材如探针卡、测试治具则较多从国内采购。

测试设备主要包括测试机、分选机、探针台三大类型。集成电路的测试需求通常需指定特定类型的测试平台，因此测试设备的种类直接决定测试厂商是否具备承接相应类型业务的能力，是影响公司测试服务能力的核心因素之一。目前测试设备市场主要由海外企业主导，呈现寡头垄断局面。在测试机领域，爱德万和泰瑞达凭借长期积累，合计占据约 90%的市场份额，其中高端市场基本由这两家垄断，不过，供应商 A 已在高端市场实现突破，而中端市场的国产化率也已经处于较高水平。在分选机领域，科休、供应商 A、爱德万、鸿劲精密、金海通在全球保持优势地位，国内厂商供应商 A、金海通实现了较大突破，已占据一定市场份额。探针台市场目前仍主要由日本企业主导，前两大厂商东京精密及东京电子合计占比超过 70%，但国产替代方面也已取得一定突破。总体而言，国内测试设备厂商在细分领域有所突破，但全球市场占比仍然有限。未来随着国家产业政策的支持及集成电路产业链自主可控的发展方向，国内厂商加速追赶，测试设备国产化率有望提升。

2、与下游行业之间的关联性及其下游行业发展状况

集成电路测试下游行业主要为集成电路设计行业。近年来，在下游需求维

持高景气度、产业政策大力支持、产业资本投入持续增加等因素的作用下，中国集成电路设计产业实现了长足发展。根据中国半导体行业协会统计，我国集成电路设计行业销售规模从 2012 年的 622 亿元增长至 2025 年的 8,261.1 亿元，年均复合增长率约为 22%。随着新能源汽车、人工智能及各类优质折叠屏手机等终端行业的发展，下游优秀设计公司在也在登陆资本市场的背景下，利用募集资金充分开展了对应的芯片研发，通过优质的芯片绑定了终端客户。终端行业的发展带动了设计公司的发展。未来，虽然集成电路行业发展会有周期性的波动，国产化进程仍在持续推进，我国集成电路产业的总体趋势依然是不断发展。

八、公司主要业务情况

（一）主营业务及主要产品概况

1、公司主营业务介绍

公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司目前拥有晶圆测试、芯片成品测试及测试方案开发、SLT 测试、老化测试等全流程测试服务，测试的晶圆和成品芯片在类型上涵盖 AI 芯片、CPU、GPU、DPU、SoC 芯片、FPGA、MCU、存储芯片、射频芯片、高端 CIS 芯片等芯片种类，在工艺上涵盖各类制程，在晶圆尺寸上涵盖 12 英寸、8 英寸、6 英寸等主流产品，在下游应用上包括数据中心、通讯、计算机、汽车电子、工业控制、消费电子等领域。

受中兴、华为禁令事件及国产算力芯片突破的双重驱动，2024 年以来，中国大陆高端芯片测试需求激增，订单加速回流本土。公司紧抓这一历史性机遇，采取“产能扩充+研发攻坚”双轮驱动策略，一方面快速提升高端测试产能，另一方面聚焦 AI 芯片、GPU 芯片、CPU 芯片、复杂 SoC 芯片、5G 射频芯片及高端 CIS 芯片等关键领域，攻克测试工艺瓶颈。目前，公司已发展为中国大陆高端芯片测试自主可控的主要供应商之一，并成长为国内 AI 算力芯片测试服务的核心供应商之一。

公司的技术实力、服务品质、产能规模获得了行业的高度认可，积累了广泛的客户资源。截至目前，公司客户数量 300 余家，客户涵盖芯片设计、制造、

封装、IDM 等类型的企业，其中不乏客户 A、客户 C、紫光展锐、中兴微电子、晶晨股份、兆易创新、复旦微电、比特大陆、安路科技、客户 B、甬矽电子、卓胜微、普冉股份、中芯国际、瑞芯微、纳芯微、集创北方、翱捷科技等知名厂商。公司的典型客户如下：

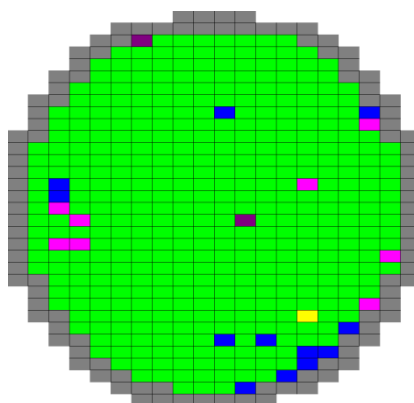
客户类型	典型客户
芯片设计公司	客户 A、紫光展锐、中兴微电子、晶晨股份、兆易创新、复旦微电、比特大陆、安路科技、合肥智芯、卓胜微、普冉股份、瑞芯微、纳芯微、集创北方、富瀚微、翱捷科技、恒玄科技、唯捷创芯、国芯科技、中颖电子、北京君正、客户 D、联芸科技、裕太微电子
封测厂	客户 B、长电科技、甬矽电子、华天科技、通富微电、客户 C
晶圆厂	中芯国际、武汉新芯

2、公司主要产品介绍

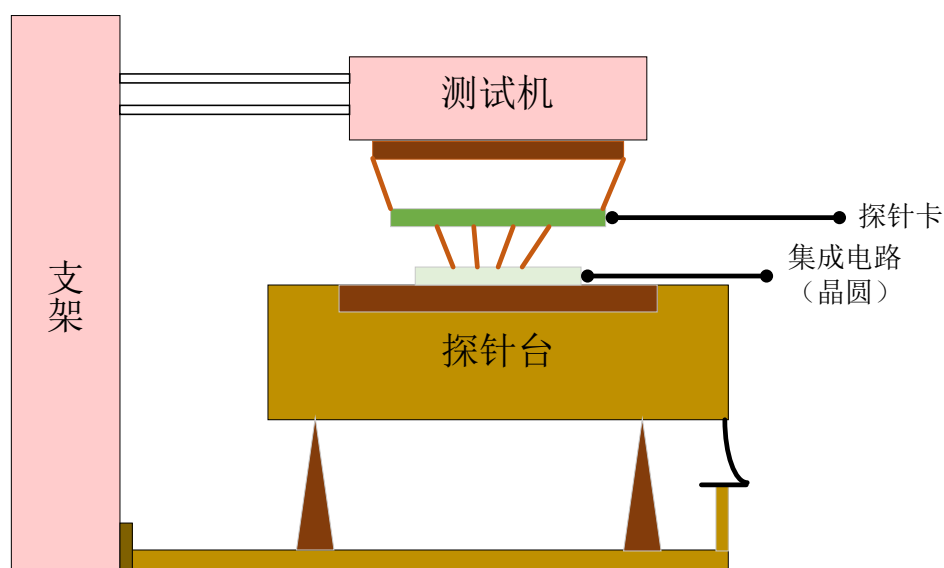
（1）集成电路测试

①晶圆测试

晶圆测试（Chip Probing），简称 CP，是指通过探针台和测试机的配合使用，对晶圆上的裸芯片进行功能和电参数测试，其测试过程为：探针台将晶圆逐片自动传送至测试位置，芯片的端点通过探针、专用连接线与测试机的功能模块进行连接，测试机对芯片施加输入信号并采集输出信号，判断芯片功能和性能是否达到设计规范要求。测试结果通过通信接口传送给探针台，探针台据此对芯片进行打点标记，形成晶圆的 Mapping，即晶圆的电性测试结果，Mapping 示意图如下：



晶圆测试系统通常由支架、测试机、探针台、探针卡等组成，示意图如下：

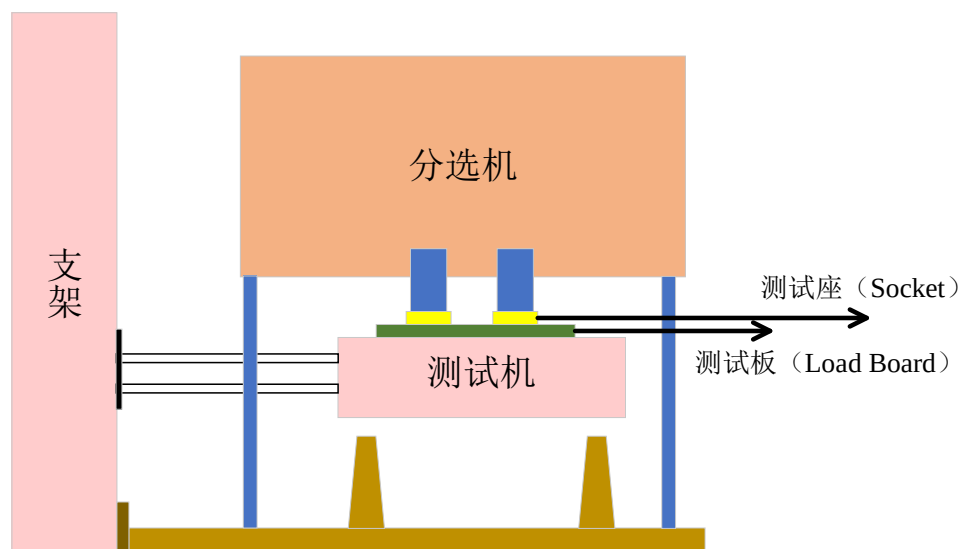


②芯片成品测试

芯片成品测试（Final Test），简称 FT，是指通过分选机和测试机的配合使用，对封装完成后的芯片进行功能和电参数测试，其测试过程为：分选机将被测芯片逐个自动传送至测试工位，被测芯片的引脚通过测试工位上的基座、专用连接线与测试机的功能模块进行连接，测试机对芯片施加输入信号并采集输出信号，判断芯片功能和性能是否达到设计规范要求。测试结果通过通信接口

传送给分选机，分选机据此对被测芯片进行标记、分选、收料或编带。

芯片成品测试系统通常由测试机、分选机、测试座组成，示意图如下：



(2) 其他服务

为了更好的服务客户、增强客户粘性，公司还会向客户提供测试设备租赁、测试辅材的销售等服务。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司是国内知名的独立第三方测试服务企业，通过自主研发的集成电路测

试技术、先进的集成电路测试设备以及高效快捷的测试生产和技术服务体系，向芯片设计企业、晶圆制造企业、封装企业和 IDM 企业提供晶圆测试、芯片成品测试服务，从而获取收入、赚取利润。

2、生产模式

公司根据客户订单及自身产能情况安排测试服务，并对测试产能进行总体控制和管理，及时处理测试中的生产问题，保证测试作业的顺利完成。公司的生产工作主要由制造部下属的各测试工厂来承担，其他部门配合完成。实际运行中，公司生产部门在接收客户来料后，相关部门完成客户信息建档和来料检验，销售客服部投单排产，生产部门依照工单组织测试作业。

3、销售模式

公司测试服务采用直销的销售模式，主要的客户群体为集成电路设计、制造、封装和 IDM 企业，客户分布区域以长三角地区为主，向南延伸至珠三角地区，向北延伸至东北地区，向西延伸至西部地区。

在销售的组织架构方面，公司的销售工作由销售客服部承担，销售客服部设置市场销售和客服计划两大职能岗位。市场销售人员主要负责营销方案的制订、新客户的接洽及引进，客服计划人员主要负责投料排产、客户关系维护以及回款管理等。

在客户开拓方面，公司目前已建立起一支专业能力强、行业经验丰富的销售团队，主动开发各类新客户。同时，基于公司服务品质的良好口碑，老客户引荐也是公司十分重要的获客方式。

在销售定价方面，公司销售人员经前期洽谈确定客户需求后，与客户商量确定测试服务价格，由于各家客户的晶圆及芯片都是不同的，因此测试服务价格以测试平台的配置和所需的工时为基础进行定价。

在合同签订及结算方式方面，公司成功进入客户的供应商体系后，双方签订框架性协议，开展长期合作。公司针对不同客户采取不同的信用政策，一般客户的信用期为 30-90 天，资金结算方式以银行转账为主。

4、采购模式

公司的采购类别主要包括测试设备、测试辅材及其他类的采购。测试设备主要包括测试机、探针台、分选机等，以日本、中国台湾、美国、韩国等国家和地区的进口设备为主，亦有部分国产设备，主要根据产能需求、市场状况并结合不同设备的交期情况进行采购；测试辅材主要包括探针卡、插座、治具、包装材料等，主要根据季度或月度的备件计划并结合具体测试项目的需求状况进行采购；其他类主要包括日常办公设备、设备维护材料等，主要根据生产及办公的实际需求进行采购。

公司各部门所需原材料均通过采购部门集中采购，并按照公司《采购控制程序书》《供应商管理程序书》执行采购制度。

公司已获得 ISO9001、ISO14000、LATF16949、ISO45001 等质量管理体系认证。在新供应商准入方面，除了考察供应商质量、价格、交期、技术水平外，还要求其通过相关行业的质量认证体系，通过资格审查和认证稽核的供应商才能够进入公司《合格供应商名录》。对于现有供应商，公司根据《供应商控制程序书》定期对供应商进行审核，确保供应商的产品符合公司的生产要求。

5、研发模式

公司采取市场为导向、客户需求为核心的研发战略，形成了完整、高效的创新机制，建立了完善的研发流程管理制度。公司的研发工作由研发中心承担，主要研发方向有三个：一是不同类型芯片尤其是高端芯片的测试工艺难点的突破和具体测试方案的开发；二是各类基础性的测试技术的研发以及测试硬件的升级和改进；三是自动化生产、智能化生产等 IT 系统的研发。

公司建立了科学规范的、以项目为核心的研发管理体系，并形成了一套完善的研发流程管理制度。

（三）主营业务分析

1、主要产品产能、产量和销售情况

公司主营业务为提供晶圆测试和芯片成品测试服务，公司按产品的测试工时向客户收取测试费用，获得测试收入。报告期内，公司主要服务类别的产能

（理论产能总工时）、产量（测试总工时）和产能利用率情况如下表所示：

项目	期间	理论产能总工时 (小时)	测试总工时 (小时)	产能利用率(%)
晶圆测试	2026年1-6月	2,724,841.18	2,057,672.99	75.52
	2025年度	4,313,130.91	3,072,837.79	71.24
	2024年度	3,689,890.96	2,759,850.50	74.79
	2023年度	2,969,991.20	1,976,416.16	66.55
芯片成品测试	2026年1-6月	2,374,098.06	1,851,740.56	78.00
	2025年度	3,290,746.56	2,568,166.06	78.04
	2024年度	2,143,295.05	1,719,200.66	80.21
	2023年度	1,369,544.27	775,708.95	56.64

报告期内，公司主要产品销售收入及占主营业务收入的比重情况如下：

单位：万元，%

项目	2026年1-6月		2025年度		2024年度		2023年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
晶圆测试	49,516.02	48.87	86,128.42	57.63	61,467.28	62.63	44,250.82	64.42
芯片成品测试	51,812.42	51.13	63,327.77	42.37	36,678.62	37.37	24,441.77	35.58
合计	101,328.44	100	149,456.19	100	98,145.90	100	68,692.59	100

2、报告期前五大客户情况

报告期内，公司前5名客户销售的具体情况如下：

单位：万元，%

期间	客户	销售金额	销售占比
2026年1-6月	客户A	16,845.78	15.72
	客户C	6,748.44	6.30
	紫光展锐（上海）科技股份有限公司	6,047.79	5.64
	矽品科技（苏州）有限公司	3,680.80	3.43
	客户D	3,541.67	3.30
	合计	36,864.47	34.39
2025年度	客户A	25,854.97	16.42
	客户B	13,135.16	8.34
	客户C	10,331.23	6.56
	紫光展锐（上海）科技股份有限公司	8,492.97	5.39

期间	客户	销售金额	销售占比
	合肥智芯半导体有限公司	4,518.42	2.87
	合计	62,332.75	39.59
2024 年度	客户 A	23,880.97	22.18
	客户 B	6,644.04	6.17
	紫光展锐（上海）科技有限公司	5,998.44	5.57
	普冉半导体（上海）股份有限公司	4,481.24	4.16
	客户 C	4,080.51	3.79
	合计	45,085.20	41.87
2023 年度	客户 B	7,153.88	9.71
	紫光展锐（上海）科技有限公司	6,468.72	8.78
	深圳市中兴微电子技术有限公司	5,961.94	8.09
	晶晨半导体（上海）股份有限公司	4,808.30	6.53
	客户 A	4,707.01	6.39
	合计	29,099.86	39.51

注：同一控制下的客户按合并口径披露。

报告期内，公司不存在向前五大客户的销售占比超过 50%、向单个客户的销售占比超过 30%的情形。公司客户集中度有所波动，整体维持在 40%左右。2024 年以来，受集成电路行业周期恢复叠加人工智能需求爆发影响，部分下游客户经营情况产生变化，前五大客户有所变动。公司客户集中度的变化具备合理性，不存在下游行业较为分散而发行人自身客户较为集中的情况。报告期内公司前五大客户变动，主要系部分客户因自身业绩波动及市场需求变化等原因，各年度销售金额有所变化，从而进入或退出公司前五大客户名单，具体分析如下：

期间	新增客户名称	新增原因
2026年1-6月	矽品科技（苏州）有限公司	国内知名封测厂商，自2025年起与公司建立合作关系。2026年上半年度其销售额增幅较大进入前五大客户名单，主要系矽品科技将公司作为其测试服务的核心供应商，逐步提高公司在其体系内的测试服务供应比例所致。
	客户 D	国内知名AI芯片设计企业，自2025年起与公司建立合作关系。2026年上半年度其销售额增幅较大进入前五大客户名单，主要系AI芯片市场需求爆发，其业务规模增长，采购测试服务增长所致。
2025年度	合肥智芯半导体有限公司	国内知名汽车级MCU芯片设计企业，与公司具有多年合作关系。2025年度其销售额增幅较大进入前五大客户名单，主要系其汽车电子芯片业务规模增长，采购测试服务

期间	新增客户名称	新增原因
		增长所致。
2024年度	普冉半导体（上海）股份有限公司	国内知名存储芯片设计企业，科创板上市公司，与公司具有多年合作关系。2024年度其销售额增幅较大进入前五大客户名单，主要系存储芯片市场复苏明显，普冉股份的业务规模增长、采购测试服务增长所致。
	客户 C	国内知名先进封装厂商，其承接客户A的芯片封装订单，经客户A同意，将部分测试订单转交给公司负责。公司从2024年开始与其合作，随着客户A业务的恢复，测试需求爆发式增长，客户C进入前五大客户名单。
2023年度	客户 B	国内排名前列的先进封装厂商，其承接了客户A的封装订单，经客户A同意，将部分测试订单转交给公司负责。公司从2022年开始与客户B合作，2023年度下半年，随着客户A业务的恢复，测试需求爆发式增长，客户B成为公司第一大客户。
	紫光展锐（上海）科技有限公司	从2020年开始与公司合作，系全球知名的芯片设计公司，在通信领域具有较高的行业地位。2023年度进入前五大客户名单，主要系紫光展锐将公司作为其测试服务的核心供应商，逐步提高公司在其体系内的测试服务供应比例所致。

3、境内外销售情况

公司为集成电路测试服务提供商，业务均发生在境内，不存在于境外开展测试服务的情形。公司的客户分为境外客户及境内客户，境外客户会将晶圆及芯片成品送至境内让公司进行测试。报告期内，公司主营业务收入以境内客户为主，公司境内外客户销售金额及占比情况如下：

单位：万元，%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内客户	98,603.45	97.31	146,083.30	97.74	95,156.22	96.95	65,215.36	94.94
境外客户	2,725.00	2.69	3,372.89	2.26	2,989.68	3.05	3,477.23	5.06
合计	101,328.44	100	149,456.19	100	98,145.90	100	68,692.59	100

（四）原材料、能源采购情况和主要供应商

1、主要耗材采购情况

报告期内，公司主要采购原材料内容为探针卡、测试治具及测试座等耗材，其采购情况具体如下：

单位：万元，%

类别	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
----	--------------	---------	---------	---------

	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
探针卡	7,719.36	3.84	4,631.49	1.54	4,077.41	2.56	1,087.79	0.88
测试治具及测试座	4,139.14	2.06	2,276.78	0.76	1,091.12	0.69	953.92	0.77

2、主要能源采购情况

公司提供集成电路测试服务所需的主要能源为电力，报告期内，公司耗用能源情况如下表：

分类	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
采购金额（万元）	6,328.06	9,516.56	5,972.39	4,225.68
采购量（万度）	9,963.78	13,523.69	8,250.36	5,803.30

3、前五名供应商采购情况

报告期内，公司前 5 名供应商及采购金额的具体情况如下：

单位：万元，%

时间	供应商	采购金额	占采购总额比重
2026 年 1-6 月	Advantest Corporation（爱德万）	73,189.19	36.40
	HON. PRECISION, INC.（鸿劲精密）	16,759.68	8.34
	供应商 A	14,588.35	7.26
	Teradyne（ASIA）PTE.LTD.（泰瑞达）	12,921.02	6.43
	上海建灏建设集团有限公司	12,696.63	6.31
	合计	130,154.86	64.73
2025 年度	Advantest Corporation（爱德万）	101,650.75	33.82
	HON.PRECISION,INC.（鸿劲精密）	29,634.07	9.86
	Teradyne（ASIA）PTE.LTD.（泰瑞达）	22,404.98	7.45
	上海建灏建设集团有限公司	19,756.27	6.57
	天津金海通半导体设备股份有限公司	19,491.65	6.48
	合计	192,937.72	64.19
2024 年度	Advantest Corporation（爱德万）	55,936.62	35.13
	Semics Inc.	13,898.83	8.73
	HON.PRECISION,INC.（鸿劲精密）	12,003.88	7.54
	上海建灏建设集团有限公司	11,894.63	7.47
	Teradyne（ASIA）PTE.LTD.（泰瑞达）	11,311.32	7.10

时间	供应商	采购金额	占采购总额比重
	合计	105,045.29	65.96
2023 年度	Advantest Corporation（爱德万）	56,389.03	45.80
	上海建溧建设集团有限公司	13,316.85	10.82
	Teradyne（ASIA）PTE.LTD.（泰瑞达）	9,282.93	7.54
	HON.PRECISION,INC.（鸿劲精密）	7,187.88	5.84
	Semics Inc.	6,468.11	5.25
	合计	92,644.80	75.25

报告期内，发行人向前五大供应商采购占比分别为 75.25%、65.96%、64.19%和 **64.73%**，占比先降后升。报告期内，公司向前五大供应商采购占比超过百分之五十，向第一大供应商 Advantest Corporation（爱德万）采购占比超过 30%。报告期内公司采购主要内容为测试设备，目前测试设备市场呈现寡头垄断局面。据 Advantest Corporation（爱德万）在其 2025 年投资者材料中明确表述，全球半导体测试机市场泰瑞达和爱德万市场份额占比约为 80%。公司供应商集中度较高，主要系测试设备市场集中度较高。报告期内随着公司持续扩大高端测试产能，积极购置爱德万 V93000 等高端测试机台，因此向 Advantest Corporation（爱德万）采购金额从 2025 年起大幅上涨。

报告期内，公司前五大供应商中，新增供应商具体分析如下：

新增期间	供应商名称	变动原因
2026 年 1-6 月	供应商 A	国内知名半导体测试设备供应商，A 股上市公司，与公司具有多年合作关系。2026 年 1-6 月进入公司前五大供应商名单，主要系公司扩充芯片成品测试产能，增加了对该供应商的测试机采购所致。
2025 年度	天津金海通半导体设备股份有限公司	国内知名分选机供应商，A 股上市公司，与公司具有多年合作关系。2025 年度进入公司前五大供应商名单，主要系公司扩充芯片成品测试产能，增加了对该供应商的分选机采购所致。
2023 年度	上海建溧建设集团有限公司	成立于 2010 年，是一家集工业厂房建设和机电安装等为一体的施工总承包企业。2023 年度成为公司前五大供应商，主要系南京测试基地项目向其采购土建工程服务金额较大所致。

4、境内外采购情况

报告期内，公司境内外采购情况及占比情况如下：

单位：万元，%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	83,559.74	41.56	134,714.31	44.82	59,470.85	37.35	34,965.23	28.40
境外	117,500.03	58.44	165,870.85	55.18	99,775.70	62.65	88,141.95	71.60
合计	201,059.76	100.00	300,585.16	100	159,246.56	100	123,107.19	100

公司现有机器设备以进口设备为主，主要供应商包括爱德万、泰瑞达等国际知名测试设备厂商。公司进口设备主要是测试机、探针台、分选机及相关配件，是公司测试业务的关键设备。截至本募集说明书出具日，公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备尚未受到美国的出口管制。若未来国际贸易摩擦加剧，公司所需的测试设备出现进口受限的情形，将对公司生产经营产生不利影响。关于“进口设备依赖的风险”的风险已在募集说明书“第三节 风险因素”之“一、与发行人相关的风险”进行了披露。

（五）发行人董事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或者持有发行人 5%以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益

截至本募集说明书出具日，公司曾任董事陈凯持有普冉股份 0.07%的股份。除此之外，公司董事、高级管理人员、其他核心技术人员、主要关联方和持股 5%以上股东在上述供应商或客户中未持有权益。

（六）安全生产及污染治理情况

公司主营业务为集成电路测试服务，不存在产品的加工和制造。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业分类为“C 制造业”门类下的“C3973 集成电路制造”小类，不属于高危险、重污染行业。

（七）现有业务发展安排及未来发展战略

公司始终专注在芯片测试领域，坚持“以中高端晶圆及成品测试为核心，积极拓展工业级、车规级及高算力产品测试”的发展策略，致力于成为国内领先、世界一流的集成电路测试服务及解决方案提供商。公司主要从事集成电路测试及解决方案服务，通过多年的技术积累和市场开拓，已在晶圆测试、芯片成品测试及集成电路测试方案开发等方面积累了丰富的核心技术和经验，拥有

较强的自主开发测试方案的能力和高效可靠的集成电路测试服务能力，并赢得了众多的长期客户。

近年来，集成电路行业的高速发展给公司发展带来了良好的机遇，公司将围绕已经确定的发展战略，顺应集成电路行业整体发展趋势，贴近客户、理解客户并服务好客户，不断提升服务水准与创新能力，在助力行业发展的同时，也不断提升公司在行业中的地位。

九、与产品有关的技术情况

（一）公司研发投入构成及占营业收入比例情况

报告期内，公司研发费用构成及占营业收入的比例情况参见本募集说明书“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“七、经营成果分析”之“（四）期间费用分析”。

（二）核心技术及研发人员情况

1、核心技术人员情况

截至本募集说明书出具日，公司核心技术人员为骈文胜、闻国涛、路峰。上述人员简历情况参见本节“六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（二）董事、高级管理人员及核心技术人员简历”。

报告期内，公司核心技术人员及其变动情况参见本节“六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（六）董事、监事和高级管理人员及核心技术人员变动情况”。

2、研发人员情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司员工人数为 3,235 人，其中研发人员为 593 人，占比 18.33%。报告期各期末，公司研发技术人员人数及占比情况如下：

单位：人

项目	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
研发技术人员	593	522	458	302
员工人数	3,235	2,673	1,913	1,410
研发技术人员占比	18.33%	19.53%	23.94%	21.42%

（三）核心技术来源、公司的重要专利技术及其应用情况

1、公司的核心技术来源及其创新应用情况

公司的主要核心技术来源于自主研发。公司创始团队与研发团队均在集成电路测试行业深耕多年，专注于测试技术开发和测试工艺的改进，目前已经形成了一系列核心技术，具体如下：

序号	核心技术名称	技术来源	对应专利或软件著作权	应用范围
一、测试方案开发技术				
1	5G 通信射频前端晶圆测试解决方案	自主研发	一种集成电路精确测试小电阻的方法（专利号：202011160294.6）	5G 射频前端芯片
2	基于 ARM 架构的高性能处理器的测试解决方案	自主研发	一种 Wafer ID 烧写防呆的系统（专利号：202011523844.6）	处理器芯片
3	高性能汽车电子芯片测试解决方案	自主研发	多晶硅工艺保险丝的熔断装置及方法（专利号：202110248636.8）	汽车电子芯片
4	高性能区块链算力芯片晶圆测试方案	自主研发	芯片内部温度检测仪电路设计布图（登记号：BS.215515048）	AI、区块链芯片
5	WiFi6 无线网络通讯芯片测试解决方案	自主研发	一种电路板测试装置（专利号：201721231664.4）	无线网络芯片
6	基于 TCG 架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案	自主研发	晶圆区域性问题的分析系统及方法（专利号：202110310750.9）	安全芯片
7	高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案	自主研发	一种防止集成电路针测扎偏的装置（专利号：201721787486.3）	数字通信芯片
8	第 3 代快闪存储器 IP 的晶圆测试方案	自主研发	电流值智能检测仪电路设计布图（登记号：BS.215515021）	存储器芯片
9	高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案	自主研发	一种抗干扰晶圆测试机外壳（专利号：201720068188.2）	数模转换芯片
10	32 位微控制单元芯片晶圆测试解决方案	自主研发	一种子母式探针卡装配结构（专利号：202120864029.X）	微控制器芯片
11	高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案	自主研发	一种易于安装的晶圆测试装置（专利号：201720068329.0）	图像传感器芯片
12	现场可编程逻辑门阵列芯片测试解决方案	自主研发	智能电压值检测装置电路设计布图（登记号：BS.215515064）	可编程逻辑门阵列芯片
13	高性能人工智能芯片测试解决方案	自主研发	一种基于测试封装 Mapping 自动检查校验方法及系统	AI/云计算芯片

序号	核心技术名称	技术来源	对应专利或软件著作权	应用范围
			(专利号: 202210299882.0)	
14	新能源汽车动力管理芯片测试解决方案	自主研发	一种半导体测试机环境校正装置(专利号: 202220516853.0)	汽车电子芯片
15	汽车电子通信总线芯片测试解决方案	自主研发	一种测试机转接板(专利号: 202123430442.4)	汽车电子芯片
16	高精度时钟源芯片测试方案	自主研发	一种半导体测试装置(专利号: 202320342787.4)	时钟芯片
17	chiplet 核心测试技术和解决方案	自主研发	-	Chiplet 先进封装芯片
18	93K 通用测试转换软件	自主研发	一种 93K 批量转化标准 TESTSUITE 名称的方法(专利号: 202511554830.3)	测试开发方法
19	晶圆测试新型测试方法	自主研发	一种低成本晶圆测试方法(专利号: 202511914697.8)	晶圆测试技术
20	一种用于 ATE 测试头 Pogo Pin 阵列的全参数综合检测装置及智能诊断方法	自主研发	测试方法及其测试装置(专利号: 202610004536.3)	自动化测试设备维护与校准技术
21	一种具有气路联锁功能的芯片测试盖体及芯片更换方法	自主研发	温控系统及封装测试方法(专利号: 202610250586.X)	芯片成品测试技术
二、测试工艺难点突破与精益测试提效技术				
1	芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术	自主研发	多晶硅工艺保险丝的熔断装置及方法(专利号: 202110248636.8)	晶圆测试 芯片成品测试
2	晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术	自主研发	一种 Wafer ID 烧写防呆的系统(专利号: 202011523844.6)	晶圆测试
3	测试机配置匹配提效技术	自主研发	一种测试机匹配检测系统及其方法(专利号: 202011533224.0); 一种集成电路检测设备(专利号: 202121569857.7)	晶圆测试 芯片成品测试
4	晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术	自主研发	一种防止集成电路针测扎偏的装置(专利号: 201721787486.3)	晶圆测试
5	低温测试工艺结霜控制技术	自主研发	一种防止测试载板结霜的装置(专利号: 202120866185.X); 料盘翘曲平整装置(专利号: 202121715058.6)	晶圆测试 芯片成品测试
6	晶圆测试良率分析和优选管控技术	自主研发	晶圆区域性问题的分析系统及方法(专利号: 202110310750.9)	晶圆测试

序号	核心技术名称	技术来源	对应专利或软件著作权	应用范围
7	薄片晶圆测试技术	自主研发	-	晶圆测试
8	多平台联动提效技术	自主研发	一种多平台联动提效机构 (专利号: 202011489734.2)	晶圆测试
三、设备改造升级技术				
1	探针台自动清洁装置	自主研发	一种芯片测试机上的真空除尘结构(专利号: 201721787488.2)	晶圆测试
2	测试机多方位使用兼容装置	自主研发	一种芯片测试机的翻转机构(专利号: 201721787489.7)	晶圆测试 芯片成品测试
3	解决背银、背金晶圆的测试稳压装置	自主研发	一种背银、背金晶圆测试稳压装置(专利号: 201720068189.7)	晶圆测试
4	晶圆进出晶舟盒防呆自动监测装置	自主研发	-	晶圆测试
5	晶圆测试机抗干扰外壳装置	自主研发	一种抗干扰晶圆测试机外壳(专利号: 201720068188.2)	晶圆测试
6	晶圆外观检测平台的改造装置	自主研发	一种真空吸附检测台的承载平台(专利号: 201721231321.8)	晶圆测试
四、测试治具设计技术				
1	修调卡及线缆快速验证装置	自主研发	一种方便操作的便携式有线线缆检测机构(专利号: 202120554510.9)	晶圆测试 芯片成品测试
2	自动降温装置	自主研发	一种自动降温器(专利号: 201721231457.9); 一种用于半导体自动分选机快速降温装置(专利号: 202121422099.6)	晶圆测试
3	延长墨管使用寿命的装置	自主研发	一种自动油墨打点器(专利号: 201721231624.X) 一种延长墨管使用寿命的装置(专利号: 202120868460.1)	晶圆测试
4	可选择性导片装置	自主研发	-	晶圆测试
5	测试方案开发的系统验证板	自主研发	一种 Chroma Q-type 转接板开路断路检验装置(专利号: 202120877907.1)	晶圆测试 芯片成品测试
6	晶圆测试中对位辅助调整装置	自主研发	一种可以提高打点产品效率的模具(专利号: 201721231323.7)	晶圆测试
7	晶圆测试探针卡精密管控技术	自主研发	腐蚀粉在整形铂金探针的应用和铂金探针的整形方法(专利号: 202110234659.3);	晶圆测试

序号	核心技术名称	技术来源	对应专利或软件著作权	应用范围
			一种探针卡拆卸防呆装置 (专利号: 202120870208.4)	
8	可靠性测试中高性能热传导防压痕测试夹具	自主研发	一种旋盖式芯片测试夹具	芯片成品测试
五、自动化测试及数据分析技术				
1	数据挖掘与多维度分析系统	自主研发	伟测自动测试报告系统(软著号:软著登字第 2042850 号); 伟测 TEL 型号探针台的晶圆图转换软件(软著号:软著登字第 8590308 号); 伟测 TXT&Excel 与晶圆 &Bin 坐标对比软件(软著号:软著登字第 8672298 号); 伟测测试机 STDF 大文件压缩转换软件(软著号:软著登字第 8672285 号); 伟测测试机 XML/TXT 文件探针台的 MAP 图转换软件(软著号:软著登字第 9248208 号);	数据分析系统
2	测试参数大数据多维度统计分析系统	自主研发	伟测自动测试报告系统(软著号:软著登字第 2042850 号); 伟测 TEL 型号探针台的晶圆图转换软件(软著号:软著登字第 8590308 号); 伟测 TXT&Excel 与晶圆 &Bin 坐标对比软件(软著号:软著登字第 8672298 号); 伟测测试机 STDF 大文件压缩转换软件(软著号:软著登字第 8672285 号); 伟测测试机 CSV 文件到 TSK 探针台的晶圆图转换软件(软著号:软著登字第 9043690 号); 伟测测试机 XML/TXT 文件探针台的 MAP 图转换软件(软著号:软著登字第 9248208 号);	数据分析系统
3	生产稼动率统计分析和管控系统	自主研发	伟测自动测试报告系统(软著号:软著登字第 2042850 号); 伟测 TEL 型号探针台的晶圆	数据分析系统

序号	核心技术名称	技术来源	对应专利或软件著作权	应用范围
			图转换软件（软著号：软著登字第 8590308 号）	
4	Mapping 分析系统	自主研发	伟测自动测试报告系统（软著号：软著登字第 2042850 号）； 伟测 TEL 型号探针台的晶圆图转换软件（软著号：软著登字第 8590308 号）； 伟测 TXT&Excel 与晶圆 &Bin 坐标对比软件（软著号：软著登字第 8672298 号）； 伟测测试机 STDF 大文件压缩转换软件（软著号：软著登字第 8672285 号）； 伟测测试机 CSV 文件到 TSK 探针台的晶圆图转换软件（软著号：软著登字第 9043690 号）； 伟测测试机 XML/TXT 文件探针台的 MAP 图转换软件（软著号：软著登字第 9248208 号）	数据分析系统
5	Test Time & Index Time 侦测与分析系统	自主研发	伟测自动测试报告系统（软著号：软著登字第 2042850 号）； 伟测 TEL 型号探针台的晶圆图转换软件（软著号：软著登字第 8590308 号）	数据分析系统
6	一种合理的高频信号时序设计方法	自主研发	-	高可靠性测试
7	一种有效的 SerDes Burnin 整体老化方案	自主研发	-	高可靠性测试
8	一种信号传输效率提升和功耗降低的接口设计方法	自主研发	-	高可靠性测试
9	测试数据自动化分析处理系统	自主研发	伟测测试数据自动化分析处理软件（软著号：软著登字第 16733804 号）； 半导体测试数据 Sigma 分析计算软件（软著号：软著登字第 16733706 号）； 伟测测试机数据分析软件（软著号：软著登字第 16551465 号）； 半导体测试数据可视化与统计分析系统（软著号：软著登字第 16551454 号）； 测试数据解析软件（软著	数据分析系统

序号	核心技术名称	技术来源	对应专利或软件著作权	应用范围
			号：软著登字第 17435910 号)； MD5 码转换系统（软著号：软著登字第 15126043 号)； Down map 刷新 Rawdata 系统（软著号：软著登字第 15005955 号)； SUA_Summ 分析工具软件（软著号：软著登字第 16145279 号)； 伟测测试机的 Map 角度同步软件（软著号：软著登字第 14852197 号)； 伟测数据同步分析系统（软著号：软著登字第 17725460 号)；	
10	测试生产自动化数据采集分析系统	自主研发	Map 自动关联比对工具软件（软著号：软著登字第 16415064 号)； Rawdata 坐标合并系统（软著号：软著登字第 16287920 号)； 自动化点废坐标系统（软著号：软著登字第 16189394 号)； 伟测 Over Ink 坐标智能提取软件（软著号：软著登字第 16215332 号)； dlogTDO 数据-LVM 信息输出系统（软著号：软著登字第 16270689 号)； 测试机信息自动化采集系统（软著号：软著登字第 17433347)； 芯片静电累积实时监测预警服务软件（软著号：软著登字第 17054731 号)； 伟测 Prober 数据与 Tester 数据坐标一致性确认软件（软著号：软著登字第 16906226)	数据分析系统
11	STDF 数据处理系统	自主研发	伟测测试数据 STDF 多格式转换软件（软著号：软著登字第 16189310 号)； STDF 转 ATDF 修改系统（软著号：软著登字第 16733815 号)； STDF 文件信息清洗系统（软著号：软著登字第	数据分析系统

序号	核心技术名称	技术来源	对应专利或软件著作权	应用范围
			15401629 号)； 伟测测试数据 STDF 报表自动生成软件（软著号：软著登字第 15428902 号）； 半导体 STDF 文件测试 limit 筛除软件（软著号：软著登字第 15627194 号）	
12	测试修调系统	自主研发	基于 MCU 的电压、频率并行修调测试系统（软著号：软著登字第 16969779 号）	测试技术
13	测试开发自动化系统	自主研发	ATE/芯片自动测试流程管理软件（软著号：软著登字第 17705356 号）； 芯片量产测试 pattern 动态编写管理系统（软著号：软著登字第 17119965 号）； 基于 chroma 平台测试程序自动 QA 检查软件（软著号：软著登字第 17098765 号）； 基于 Chroma3380P 平台自动化测试软件（软著号：软著登字第 17025518 号）	测试开发技术

2、核心技术的具体表征和先进性

(1) 测试方案开发技术

①5G 通信射频前端晶圆测试解决方案

具体表征：

解决了以下难题：晶圆测试过程中一般要进行射频参数测试，这个过程要用到特制的探针卡，成本较高；晶圆测试过程中受限于探针和晶圆接触状况不可控，接触电阻和接触阻抗也会变得不可控，这会对各类参数测试造成负面影响。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：针对该测试探针卡费用过高的问题，公司采用的办法是：通过直流参数和低速交流参数对射频性能进行相关性仿真，并辅助以相应的算法实现对芯片射频参数的相关性分析。该方案具有良好的可移植性，可以推广到其他射频前端器件测试中，如低噪声放大器、衰减器等。针对晶圆测试过程中探针和触点的接触问题，本方案通过使用多通道差

分测试消除了信号干扰，并辅以校准技术使得测试精度大幅提高，同时降低了测试成本。该方案具有良好的可移植的特性，可以推广到其他各类直流参数测试中，如：模拟测试，数字芯片直流性能测试等。

②基于 ARM 架构的高性能处理器的测试解决方案

具体表征：

解决了以下难题：新型主流移动处理器均采用最先进的工艺，晶体管的数量超过 150 亿个，这种高覆盖率的测试对测试机向量深度的要求极高，甚至超过测试机硬件上限；新型移动处理器集成了 5G 射频基带，而其高带宽和低底噪的特性也给测试带来全新的挑战；芯片的复杂度较高，测试开发的难度较大，测试开发周期较长。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：针对产品对向量深度要求高的问题，公司通过对测试图样进行压缩处理可以实现芯片在现有向量深度下进行高覆盖率的测试，保证了测试的品质；针对 5G 射频基带高带宽和低底噪的问题，本方案实现了 5G-NR 基带在测试平台高覆盖率下的参数特性测试和性能分析；针对产品测试开发周期长的问题，本方案可以实现芯片设计的数据自动转换并能够将设计的验证代码自动链接到测试开发环境，使测试开发周期大幅缩短。

③高性能汽车电子芯片测试解决方案

具体表征：

解决了以下难题：高性能汽车电子芯片测试的一个巨大的挑战是多流程测试机结果的分析 and 测试结果的一致性的分析以及保证测试结果的可追溯性；汽车电子的各类总线均为高压数字逻辑总线，这些电平的值通常会超过测试设备仪表的范围。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：本方案设计了一系列的测试电路模块，并对熔丝烧写、修调测试等芯片模块开发全新的高稳定性的测试方法，同时还针对性的开发了测试数据分析算法，保障了测试结果的一致性；本方案

设计了新型的信号放大和衰减模块，解决了现有测试设备电平值不满足产品需求的问题，且该方案具有可移植的特性。

④高性能区块链算力芯片晶圆测试方案

具体表征：

解决了以下难题：新型算力芯片的计算核心数量高达数百个以上，测试难度较大且测试准确性要求高；核心工作电压低至 0.3V，最大电流高达数十安培以上，且工作中要求在功耗急剧变化的过程中芯片的电压稳定在 $\pm 5\text{mV}$ 以内，精度要求极高；新型算力芯片本身功耗较大且测试中需要严格控制产品结温。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：针对计算单元多且芯片核心需要准确、稳定的小电压大功耗电源的问题，公司对芯片供电电路、测试硬件以及测试方法和算法进行设计和优化，形成一整套完整可靠的晶圆测试方案，并能广泛运用于区块链、人工智能等先进芯片测试中；针对较高的结温控制要求，公司对测试硬件、测试设备以及测试方案进行重新设计，实现了精准的结温控制。

⑤WIFI6 无线网络通讯芯片测试解决方案

具体表征：

解决了以下难题：WIFI6 采用更高 1024-QAM 的调制技术，需要基带有更低的信号噪声，另外 WIFI6 的频段是采用低频和高频的双频模式且具有将近 10G 的理论信号带宽，这意味着测试的信号带宽和频点均出现成倍的增加，测试难度较高；由于射频信号的不完整会影响射频信号能量的传递并带来噪声，尤其在高频点测试时这个问题变得更加突出，所以在测试过程中需要保证整个系统状态稳定可靠。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：针对 WIFI6 射频基带高带宽和低底噪的问题，本方案不仅能够实现在传统自动化测试设备上进行射频参数测试，还整合了 WIFI6 的协议测试，最终实现了较高的测试覆盖率；针对测试稳定性

要求较高的问题，本方案从射频信号传输线的路径着手，从测试负载板走线到外接射频信号的射频接线以及射频接口的多个方面进行设计和优化，确保测试中信号通过的路径均稳定一致。

⑥基于 TCG 架构的先进网络安全芯片晶圆测试解决方案

具体表征：

解决了以下难题：该类产品一个典型的特征为不同芯片完成多种加密、解密算法需要不同的时间，造成测试时序混乱，不利于多工位并行测试的执行。其次，该芯片需要在测试过程中模拟多种攻击模式来测试芯片的安全机制。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：针对不同产品结果返回时序不统一的问题，公司通过数据采样分析并辅以结果分析算法解决了不同产品在各种加密算法测试下返回结果时序不统一的问题，实现了自动化测试。针对攻击测试，公司通过硬件设计和控制机制实现对于各类电压、频率下芯片安全的测试。

⑦高速数字通信芯片的晶圆测试解决方案

具体表征：

解决了以下难题：高速数字通信芯片的传输速度高达数十 Gb/s，在测试过程中易出现高速数字信号在传输路径上由于信号不完整而发生能量损失进而引起信号的噪声和误码；晶圆测试阶段由于探针卡和晶圆的接触面积小非常容易造成由于接触不好引起的信号完整性差的问题，而这会加剧引起信号的噪声和误码。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：针对晶圆测试中易出现的误码和噪声问题，本方案使用特制的高速探针和特别走线设计降低路径上信号的反射和插入损耗，此外，在测试方法上使用伪随机二进制脉冲序列生成、眼图、信号抖动的注入与测量，并辅助以相应的数字信号处理计算进行高速信号进行参数化测试、误码率检测、时钟数据恢复、信号完整性测试；针对晶圆测试接触面积小的问题，公司对探针台进行相关的技术开发实现量产测试中接触情况稳

定可控。

⑧第3代快闪存储器IP的晶圆测试方案

具体表征：

解决了以下难题：新型快闪存储器IP通常需要集成到MCU、SoC的产品中，传统的方法需要分别使用存储器测试设备和SoC测试设备对快闪存储器IP和MCU独立进行多流程测试，这样会造成测试流程多、测试时间长和测试交付周期久，晶圆的AI垫由于扎针次数多进而影响封装品质，且也会对芯片设计中芯片面积的控制产生不利影响；快闪存储器的测试时间较长，测试成本高。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：使用SoC测试设备代替传统的存储器测试系统实现各类存储器测试，对测试方案的优化涉及制程工艺和读写稳定性修调、随机读写、棋盘法/反棋盘法、斜向法等算法，兼顾了记忆单元电流测试以及存储单元的修复等测试。新的方案有效简化了测试流程，减少品质风险，降低测试成本，加速产品的交付周期；对SoC测试机资源进行整合，实现资源平行互用有效提升了同测数，实现了高并行度的测试，进一步降低测试成本；该方案具有可移植的特性，易推广到其他各类存储器测试中。

⑨高速高分辨率电流型数模转换器晶圆测试解决方案

具体表征：

解决了以下难题：该类产品是高速电流型的数模转换芯片，而现有的测试设备的信号采样仪表通常是电压型模数转换采样仪表，无法直接对高速电流信号进行采样，另外要实现高速电流信号无损的转换为高速电压信号具有一定难度；该类产品是高速的数模转化器件，采样速率高达数百MHz，且测试时易出现高速数字信号和高速模拟信号互相干扰的问题以及多工位之间信号串扰问题。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：公司通过设计电流电压转换模块、高速电路和相关的校准方案可以实现利用自动化测试设备的电压型模数采样仪表对信号进行高效的采样分析计算，还辅助以特定的校准补偿算法实现对产品

性能参照的准确分析和测试；针对容易出现干扰和串扰的问题，公司对探针卡进行改造并辅助以电磁屏蔽方案，保证了多工位测试的一致性和稳定性。

⑩32 位微控制单元芯片晶圆测试解决方案

具体表征：

解决了以下难题：单片机产品发展的方向越来越偏向于各种定制化应用场景，相关测试也随之变化，但是市场对开发时间的要求越来越短，测试开发的压力较大；单片机芯片测试成本越来越高。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：针对开发周期较长的问题，公司从硬件开发和软件开发两个方面着手，一是硬件开发最优化，即对通用型硬件重新设计和优化，缩短硬件开发周期，二是设定相关程序能够自动开发软件并完善测试标准库，实现测试程序的自动化生成；公司借助通用化硬件的使用和软件开发自动化大幅降低了测试开发成本。

⑪高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案

具体表征：

解决了以下难题：图像传感器的测试中需要提供均匀的光照强度和长期稳定的平行光源对图像传感器进行感光测试和分析，另外图像传感器的测试通常需要根据不同产品定制化光源；图像传感器的测试的分析算法十分复杂且需要根据实际图像数据调整相应的分析算法，传统方法为针对各个产品进行定制化的分析，开发周期较长。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：针对光源问题，公司设计了专用 1024 步可调通用平行 LED 光源，并且该光源可以根据产品需要添加减光膜，另外该光源可实现自动化进行光照强度校正和补偿，提高了测试的稳定度和精度；针对相关算法开发周期长的问题，公司自主开发了标准的图像处理、分析算法库，实现图像传感器测试的标准化，研发周期可缩短 70%。

⑫现场可编程逻辑门阵列芯片测试解决方案

具体表征：

解决了以下难题：该新型芯片具有高达数千万的逻辑门，且该芯片集成了 ARM 处理器核心，要实现其全功能测试需要极高的测试向量的深度；同一类型芯片需要根据不同客户的需求定制化开发，造成测试开发效率低，重复工作量大。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：针对向量深度需求高的问题，公司通过设计测试图样的压缩处理方案和算法向量生成方案，实现了高覆盖率的 DFT 测试和功能测试；针对定制化的测试需求，公司优化了测试算法，实现现场可编程逻辑门阵列测试库代码和向量生成工具标准化，可以自动生成测试程序，大幅提升了开发效率。

⑬高性能人工智能芯片测试解决方案

具体表征：

解决了以下难题：高性能人工智能芯片采用 Chiplet 技术，拥有 144 个处理器核心，晶体管的数量超过 500 亿个，具备超 50T 算力，最大功耗 300 瓦，整合如 PCIe5.0 等最新高速通信协议，广泛运用于云计算中心，AI 训练等新兴 AI 和高性能计算场景。该类芯片测试的测试覆盖率要求极高，且需要高速接口测试和分析能力，数字通道上高达数十 GB 的数据采样和分析能力。此外，此类芯片需要测试电源在高达数百安培的电流下供电的稳定性和一致性，这对测试过程中温度的控制能力提出了极高要求。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：针对该类芯片测试需要极高的测试覆盖率，公司对测试图样进行了压缩处理，在降低了测试向量深度的同时，进一步设计使用高速接口进行 DFT 向量的测试。该方法既分担了测试向量深度的需求，又部分覆盖了高速接口功能测试；针对该类芯片测试需要高速接口测试和分析能力，公司开发了专用的高速测试方案，同时实现了功能测试和性能分析的高覆盖测试；针对该类芯片测试需要高达数十 GB 的数据采样和分析能力，公司通过设计合适的外围电路需求并辅助以特定的软件控制和计算，实现

了对大量数据的采样分析能力；针对大电流条件下的电压稳定性，公司通过设计专门的电路和制定合适的测试控制方案，实现对电压和芯片发热的精准控制。

⑭新能源汽车动力管理芯片测试解决方案

具体表征：

解决了以下难题：新能源汽车动力管理芯片测试要求在高达 100V 的高压和大于 1A 的大电流条件下实现电压高精度测试和控制 $\pm 0.5\text{mV}$ 的能力；与此同时该产品需要高达 20 路的并行测试能力；对复杂逻辑控制进行分析和判断的测试；需要极高的测试稳定性和测试一致性。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：针对产品测试需要在高达 100V 的高压和高于 1A 的大电流条件下实现电压高精度测试和控制 $\pm 0.5\text{mV}$ 的能力，公司设计了一系列差分浮动测试模块并辅助以相应的程序控制和相应的校准测试，可实现在该条件下电压精度测试和控制达到 $\pm 0.3\text{mV}$ 的水平；与此同时进行优化串并设计实现了 8 颗芯片高达 160 路的并行测试能力；对复杂逻辑控制，本测试方案提供了自动控制库的自动链接，可以快速进行测试更新和控制；针对测试稳定性和测试一致性，公司开发的测试方案提供了实时数据分析和智能化程序实时更新等方案。

⑮汽车电子通信总线芯片测试解决方案

具体表征：

解决了以下难题：汽车电子通信总线芯片测试要求测试方案能够自动切换 CAN/Lin/Flex Ray/MOST 几类汽车总线协议，且汽车电子的各类总线均为高压数字逻辑总线。这些均对测试方案构成挑战。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：本方案设计了一套完整的涵盖主流汽车总线 CAN/Lin/Flex Ray/MOST 的测试方案，且该方案可以自动根据实际产品需求进行这 4 类主流总线协议的自动切换，切换不需要额外附加电路直接进行软件处理；与此同时该方案是一个采用协议开源架构模型，因此即使后续

有新的汽车总线协议提出，也可在软件升级后实现新协议的自动更新。且该方案有良好的可移植特性，可在主流测试平台上移植。

⑩高精度时钟源芯片测试方案

具体表征：

解决了以下难题：高精度时钟源芯片电子信号的同步基准广泛的运用于高性能算力芯片/AI/高速数字通信/射频通信等领域。要实现该产品测试，需要实现 24MHz-400MHz 的频率范围进行精度 $\leq \pm 0.5\text{ppm}$ 的时钟信号精准测试；且输出电平可以程控 LVDS/LVPECL/LVTTL 自由切换，且要求 LVDS 的单端电平幅度 $\leq 0.2\text{V}$ ；输出电平需要高达 156.75MHz 进行精准修调，修调精度要求 $\pm 2\text{mV}$ 。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：针对需要实现 24MHz-400MHz 的频率范围进行精度 $\leq \pm 0.5\text{ppm}$ 的时钟信号精准测试，公司对测试采样电路以及测试硬件以及测试方法和算法进行设计和优化，形成一整套完整可靠的时钟测试方案，可以实现测试精度 $\leq \pm 0.5\text{ppm}$ ；与此同时该方案可使客户程序自动控制任意电平转换，且切换时间小于 1us,电平的精度 $\leq \pm 2\text{mV}$ ；同时公司设计了专用的高速电平采样来维持电路，能够精准的采样高速信号任意位置的电平并进行自动化测试，经过校准后的测试精度 $\leq \pm 0.5\text{mV}$ ；方案中整体或者部分均有良好的可移植性，可在主流测试平台上移植。

⑪chiplet 核心测试技术和解决方案

具体表征：

解决了以下难题：chiplet 是多个裸芯（die）互联的先进封装，传统的测试方案难以满足互联下的接口，功能等测试，以及异构集成的热管理下测试，稳定性和覆盖率会受到影响。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：通过规划边界扫描测试以及扫描测试，可以提高测试覆盖率，根据产品特性设计核分时或模块分时的工作方式，降低产品功耗，进行有效的热管理，提高产品稳定性和良率。该方案具有良好

的扩展性和兼容性，可以应用于多种 chiplet 产品。

⑱93K 通用测试转换软件

具体表征：

解决了以下难题：针对 Advantest V93000 SMT7 测试程序中，Pattern 转换生成的 Testsuite 名称缺乏统一规范，手动或 VIM 命令修改效率低、易出错、无法适配多格式的痛点，提供自动化解决方案。

先进性：

本自动化方案可以实现以下目标：数据隔离处理：针对导出 Testflow.csv 多模块混杂、列数不一致的问题，通过单独截取 Testsuites 模块生成临时文件，解决了无法直接批量处理的瓶颈，避免格式报错；全自动化批量转换：仅需执行程序即可完成全量 Testsuite 名称的规范化处理，无需人工逐条修改或多次执行 VIM 命令，大幅提升 offline coding 效率；多格式兼容适配：通过可配置的字符串提取机制，兼容不同客户提供的多种原始 Pattern 命名格式，无需修改核心逻辑即可适配新场景；低门槛易操作：无需使用者掌握复杂 VIM 命令，可一键完成处理，降低人力成本与人为错误风险；且该方案具有较好的移植性，在主流操作系统中均可使用。

⑲晶圆测试新型测试方法

具体表征：

解决了以下难题：业内目前对超多数量 gross die 的 8 英寸晶圆测试的解决方法是使用适配 12 英寸晶圆的探针台，这就对晶圆测试的成本构成挑战。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：本低成本测试方法可以通过一套软件（包括测试程序和 map 转换工具）层面的组合处理绕过 8 英寸探针台的硬件规格限制，来实现对超多数量 gross die 的 8 英寸晶圆的测试。

⑳一种用于 ATE 测试头 Pogo Pin 阵列的全参数综合检测装置及智能诊断方法

具体表征：

解决了以下难题：在集成电路测试领域，面对多类型芯片、小批量调试或封装变更频繁的应用场景，传统测试方案往往需要重新设计硬件接口，导致开发周期延长、测试成本上升。尤其在高密度引脚、细间距封装（fine-pitch package）的应用中，现有测试工具普遍存在适配能力差、连接不可靠、信号干扰严重等问题，易出现探针错位、短路或接触不良等现象，严重影响测试结果的准确性与可重复性。

先进性：

公司开发的技术可以实现以下目标：公司自主研发的可重构型测试用具，通过模块化设计，能够适配多种封装型号的待测芯片，实现待测芯片的自动对准与夹持，以及测试接口的自动配置，从而解决适配性、精度和效率问题。本技术通过视觉传感器识别芯片初始位置与姿态，并控制由多个独立移动单元构成的可移动边界产生位移，推动待测芯片至测试位置，实现高精度中心对准。同时，通过预存的引脚布局映射关系，自动激活与待测芯片引脚位置匹配的金属探针电性通路，无需手动更换探针阵列，大幅度缩短了测试时间，降低了测试工具的维护成本。

②①一种具有气路联锁功能的芯片测试盖体及芯片更换方法

具体表征：

解决了以下难题：彻底解决传统实验室芯片测试依托热流仪方案存在的多项行业共性难题。传统测试方式气密性差，高低温测试过程中测试环境易受外界空气干扰，导致测试工况不稳定；温控精度低下，无法满足高端芯片精准温控测试要求；待测芯片更换流程繁琐、人工干预多，更换效率极低；同时传统设备架构固化、灵活性差，难以适配千变万化的芯片测试定制需求，小批量自动化测试难以落地，最终造成测试数据偏差大、实验效率低、产品测试品质不可控，严重制约芯片研发迭代与批量测试生产。

先进性：

本技术采用模块化可重构硬件设计，突破传统测试设备架构局限，系统灵活性、通用性和可扩展性大幅提升，可适配各类半导体芯片测试需求，覆盖芯片研发到中小批量量产测试全流程。通过主腔体密封结构搭配橡胶吸盘辅助密

封设计，双重强化测试腔体气密性，彻底改善高低温测试工况下密封失效、环境不稳定的问题，从硬件层面保障测试环境的封闭性与稳定性，有效规避外界环境干扰对测试结果的影响，大幅提升测试数据的真实性与可靠性。同时模块化架构可实现快速适配调试，简化芯片更换与设备调试流程，彻底解决传统测试操作繁琐、自动化程度低的痛点。

（2）测试工艺难点突破与精益测试提效技术

①芯片测试中熔丝烧调工艺精密控制技术

具体表征：

解决了以下难题：熔丝烧调是在芯片测试中针对芯片的阻值进行修调，以实现同类芯片分档位规格的使用。若烧调发生偏差或错误，将直接导致芯片失效或报废；若在上板使用后再发现烧调错误，甚至造成整个功能板报废。

先进性：

公司开发的技术可以实现以下目标：本技术通过熔断执行装置模块和测试机控制输出精确电压（在 10nS 时间内从 0 上升到工作电压且无向下震荡）到芯片进行烧调操作，精确度较高。此外，在烧调连续生产过程中，由于环境变化和干扰，容易出现偏差和控制难题，本方案设计烧调前后的电阻等参数的数据收集和统计分析监控软件，可以实时进行参数监控和停机报警，有效保证烧调品质和芯片的最终良率。

②晶圆测试中烧写写入工艺防呆管控技术

具体表征：

解决了以下难题：许多高端芯片需要在测试环节写入标记性信息（如 Wafer ID、XY 坐标），用于芯片后期应用功能的启动识别和异常追溯等。若信息写入错误，将直接造成芯片无法启动和使用。若上板组装后才发现烧写错误，将直接造成整机无法正常工作，导致重大的质量事故。

先进性：

公司开发的技术可以实现以下目标：本技术通过在基于 MES 系统中开发的工单录入模块、测试访问模块和数据对比模块，准确快速实现客户工单 ID 与

Wafer 实物在现场机台读取 ID 进行实时算法核对；系统核对无误后测试系统执行测试程序，自动将正确 ID 信息写入芯片；否则将停机报警停止写入操作。该技术科学的实现了错误信息写入芯片的防呆管控。

③测试机配置匹配提效技术

具体表征：

解决了以下难题：相同测试机不同配置对应不同芯片测试需求，在大规模代工量产中需要频繁切换产品，对配置规划和排产管理工作提出挑战。首先对机台配置变化需要及时动态掌握和管理，否则直接造成信息混乱，部分生产无法进行，事后停机人为确认调整，浪费宝贵机时产能；另外由于代工客户及产品众多，造成配置需求差异。在匹配机台配置和排产安排时，给计划人员工作提出极高挑战，若安排不够优化，将造成效率低下甚至不能生产。

先进性：

公司开发的技术可以实现以下目标：本技术自动采集测试机台配置信息，并自动与 MES 中待测芯片需求配置进行优化匹配，通过算法给出最优排程或改机最优建议。本技术可以大幅度减轻人为工作量，并预防因人为错误以及机台配置信息掌握不及时等造成生产效率低下甚至不能生产的情况。

④晶圆测试过程中针痕精密管控工艺技术

具体表征：

解决了以下难题：晶圆测试属于高速运动下精密控制：晶圆在高速步进（0.2s）情况下，需要在最小 35umX35um 测试触点（Pad）范围内，精确控制探针针痕的大小、深度和位置偏差（如扎针 3 次后累计面积小于测试触点面积的 20%；针痕外框距离触点 Pad 边框距离大于 2um 同时扎针深度小于 5um 等等），相当于控制一个 15umX10um 的物体在 30umX30um 范围内，高速运动 3 次，这对运行精度、定位管理、自动化控制提出极高的要求；若发生针痕的太大或过深或偏移等任何一项超出规格，都将造成晶圆报废。

先进性：

公司开发的技术可以实现以下目标：本技术拥有从防止扎偏的装置校验、

针痕调教对位方法到作业过程针痕检查监控方法和停机报警等一整套精密管控工艺方法。本技术自主研发了防止针痕扎偏装置，在生产前进行校验。在生产中从针痕调教对位方法到针痕检查监控方法均有完善系统的精密管控工艺文件，同时可以自动监控针痕是否太大、过深或偏移等，任何一项异常发生时将自动停机报警；本技术有效实现针痕精密管控，保证晶圆测试于高速运动下精密控制，确保了测试的品质。

⑤低温测试工艺结霜控制技术

具体表征：

解决了以下难题：部分高端芯片有严格的性能要求，需进行低温测试。相关芯片在低温（-40 度）下测试时，容易发生测试板和晶圆等器件结霜问题，对生产工艺和测试硬件提出挑战。若发生结霜问题，轻则造成测试不稳定，导致良率不准确；重则直接造成晶圆或芯片报废。

先进性：

公司开发的技术可以实现以下目标：公司自主研发的防止测试载板结霜的装置，可以防止因测试载板结霜而导致的测试不稳定的问题，避免良率不准确。本技术通过对探针卡和探针台及分选机进行密封处理并辅以空气干燥充氮等装置的运行，可以有效杜绝晶圆或芯片结霜，避免测试异常。公司自主研发的料盘翘曲平整装置对芯片成品测试的稳定性和密封效果等形成有效支撑和保障。

⑥晶圆测试良率分析和优选管控技术

具体表征：

解决了以下难题：5G 网络、人工智能等高端、高可靠性要求的工业和汽车电子芯片在测试筛选环节需要尽可能剔除异常和不稳定芯片，避免终端使用时性能不稳定。若性能不稳定的芯片应用到终端，极有可能造成通讯网络异常或重大安全事故。

先进性：

公司开发的技术可以实现以下目标：针对晶圆测试工艺中常见的晶圆区域性问题进行归类分析和失效建模。根据建模规则对多个异常测试点周围区域测

试通过的点的位置，列为有风险的测试点，并剔除。该技术能够有效识别在测试通过的测试点（芯片）中有风险的测试点，并根据规则进行点废处理，进而筛选留下更为可靠的芯片。本技术为客户的高可靠性应用场景极大化剔除了潜在风险。

⑦薄片晶圆测试技术

具体表征：

解决了以下难题：随着极小化和更高散热性芯片需求的出现，小于 200nm 厚度的薄片晶圆越来越广泛，给晶圆测试带来了新的挑战：首先薄片晶圆带有不同程度的翘曲造成机台无法吸附传送，只能使用人工手动的方式进行传送摆放，效率低下。其次在人工手动传送摆放过程中，薄片晶圆极易发生破损和破片，直接造成芯片报废等质量事故。

先进性：

公司开发的技术可以实现以下目标：本技术方案通过设计特定金属载片，通过晶圆与载片之间的吸附力将薄片晶圆和载片一体转换成正常厚度和强度晶圆，有效实现机台正常吸附传送，避免破损破片等质量事故。特殊金属材质的使用也确保了原本的测试电压电流的特性不会有所改变，保证了测试的准确性和良率。

⑧多平台联动提效技术

具体表征：

解决了以下难题：因芯片功能和技术要求的差异，测试厂一般要配置各种不同品牌型号测试机，而各客户产能需求又难以保持线性平稳，因此造成测试机利用率相较于通用型的探针台要低很多，导致测试机产能的浪费；另外受限于测试机测试资源通道数量的上限，也封顶限制了探针卡设计和同测芯片数量，对产能造成制约。

先进性：

公司开发的技术可以实现以下目标：本技术通过设置一个独立的信号分析转换单元，使用 GPIB 端口将探针台和至少两台测试机互相通讯的信号信息收

集到主控制板上，由主控芯片的程序模块利用特殊的算法将信号进行拆分和合并，完成同步或顺延时序控制和通讯，进而灵活实现多平台配置和联动测试；该技术实现多平台配置和联动测试，使得同测数量大幅提升，测试时间缩短40%-60%；同时有效提高了测试机利用率。

（3）测试设备改造升级技术

①探针台自动清洁装置

具体表征：

技术方案：一般测试过程中，晶圆接触点的铝削易被带到晶圆表面，造成污染或遗留针痕；本方案在机台内部的特定位置安装吹气口，将晶圆表面的颗粒物吹除。

先进性：

公司开发的技术方案可以实现以下目标：在测试的过程中，根据晶圆的内部测试走向，安装对应的清洁蓬头，确保了晶圆表面的洁净度，保证了测试品质。

②测试机多方位使用兼容装置

具体表征：

技术方案：本方案解决了测试机出厂方位固定而不易与探针台搭配的问题。由于测试机出厂时的搭载方向一般是固定的，不易做出调整。本方案通过对测试机支架的改造和与探针台搭载位置的计算，使支架可以在 180° 和 90° 两个不同方位进行有效快捷的转换，以达到预计的使用效果。

先进性：

公司开发的技术方案可以实现以下目标：使原本单一方位使用的测试机可以多方位与探针台搭载使用，有效的降低了成本，提高了使用的效率和便捷性。

③解决背银、背金晶圆的测试稳压装置

具体表征：

技术方案：背银、背金晶圆的测试需要在测试过程中给晶圆的背面提供

200V 以上的高压，并确保整片晶圆每个位置输入电压的误差在 1%以内；通常晶圆输入端到另一端的电压值会出现 10%左右的衰减，此时会大大影响测试结果的准确性。

先进性：

公司开发的技术方案可以实现以下目标：本方案利用圆形装置，在晶圆 6 个等分的端点位置制作相应的端口，并用高压线做成一条回路，最终实现每个位置输入电压的误差控制在 1%以内，保证了测试的准确性。

④晶圆进出晶舟盒防呆自动检测装置

具体表征：

技术方案：本方案对机台进出口的传感器进行了改造和位置调整，通过相关设置，可有效防止晶圆滑出晶圆盒。

先进性：

公司开发的技术方案可以实现以下目标：针对性的根据不同晶圆盒的位置差异，计算出传感器的合理安装点位，做到不同种晶圆盒的无死角监控，避免了晶圆的损坏，提高了机台作业的连续性。

⑤晶圆测试机抗干扰外壳装置

具体表征：

改造技术方案：本方案通过转接板上的串联和并联电路可以对 MOS 芯片进行多工位同测；通过 LDO 稳压器电路使输出电压保持稳定，降低信号震荡。

先进性：

公司开发的技术改造方案可以实现以下目标：本方案解决了电源管理类芯片测试工位少的问题，提高了测试效率，并通过 LDO 稳压器电路使输出电压保持稳定，提高了测试准确性。

⑥晶圆外观检测平台的改造装置

具体表征：

技术方案：本方案将外观检测台上的承载平台改造成为平面平台，并配合

限位柱和真空发生器，使承载台位置不会因人为错误发生改变，且一次校准就可以保持持续使用，减少了重复校准带来的时间浪费。

先进性：

公司开发的技术方案可以实现以下目标：通过对平台的有效改造，根据人员实际使用过程中的困难点和风险点，制作对应限位装置和保护装置，改造后使用更加便捷，风险降到最低。

（4）测试治具设计技术

①修调卡及线缆快速验证装置

具体表征：

技术方案：在测试前，通过该装置的电信号检查快速、直观的判断修调卡及连接线是否异常。

先进性：

公司开发的技术方案可以实现以下目标：本方案可以快速、准确的判断修调卡及连接线是否正常工作，减少不必要的重复验证，指导技术人员快速分析排查问题，提高了生产效率。

②自动降温装置

具体表征：

技术方案：部分高端芯片需执行高温测试，相应的探针台和分选机也开始兼容高温环境。然而，机台的降温一般靠自然降温，耗时较长，降低了设备利用率。

先进性：

公司开发的技术方案可以实现以下目标：本方案根据机台内部空气流动的规律，设计了相适用的降温治具，该治具可套用于机台加热配件上，将降温时间从 1-2 小时缩减到 30 分钟，大大缩短了时间。

③延长墨管使用寿命的装置

具体表征：

技术方案：晶圆测试中，通常通过油墨打点来区分和识别晶圆上的良品与次品。如果油墨在分开使用的状况下，停滞流动时就会干枯卡顿，1-2 小时不使用就会报废。

先进性：

公司开发的技术方案可以实现以下目标：本方案通过 1-2 秒的定时启动器，安装多工位的油墨打点启动器，将未在使用的油墨始终保持流动状态，有效的提高了油墨的使用率和寿命。

④可选择性导片装置

具体表征：

技术方案：当测试过程中出现低良率或紧急出货的现象，就需要进行分片操作，本方案针对晶圆盒 25 个位置制作了相应的转换装置，从而实现两个晶圆盒物料的互相对点装换。

先进性：

公司开发的技术方案可以实现以下目标：一般治具只能将 6 寸、8 寸物料 25 片整体转换晶圆盒，无法做到无序无规则的一次性对点转换，此治具有效的解决了这方面的缺陷，并加快了分批作业的效率。

⑤测试方案开发的系统验证板

具体表征：

技术方案：该通用验证板及验证方法包含如下几个部分：数字测试开发验证模块并辅以数字开发验证测试程序；混合信号测试开发验证模块并辅以混合信号测试开发验证测试程序；时间参数测试开发验证模块并辅以时间参数测试开发验证测试程序和自定义产品验证通用模块。

先进性：

公司开发的技术方案可以实现以下目标：通过平台完成测试开发中测试工程师的培训，并借助验证板进行设计验证方案以解决测试中遇到实际问题；测试开发项目前期可行性检验以及测试方案验证；在硬件设计制作过程中测试工程师可以提前开始测试程序的开发和调试。

⑥晶圆测试中对位辅助调整装置

具体表征：

技术方案：根据测试的位置制作对应的模具，可以从之前的每次四十分钟提高到每片二十分钟，缩短了对位调整时间，提高了生产效率。

先进性：

公司开发的技术方案可以实现以下目标：本方案通过制作对应的模具将位置固定牢，防止位置上的偏移，有效的提高了打点的效率和作业的连续性，即一次性调节完成后，不再需要反复调节。

⑦晶圆测试探针卡精密管控技术

具体表征：

技术方案：该精密管控技术主要包含 2 个部分：通过电解腐蚀以及探针的整形方法的研发，精密管控被电解腐蚀的探针的形状和针径规格；通过拆卸探针卡防呆装置，自动检测探针卡移动情况并标注在输出人机界面，实现防呆管理，降低了探针卡和晶圆在使用过程中由于漏对位而导致的损坏风险。该精密管控技术的应用，确保生产品质的稳定性以及生产过程的持续性，延长了探针卡的使用寿命。

先进性：

公司开发的技术方案可以实现以下目标：本方案通过设置合理的电解腐蚀参数，控制整形后的端面，避免使用研磨方式导致的钝针，延长了探针的使用寿命。增设了“拆卸探针卡防呆装置”并连接至机台控制板输出人机界面，通过监测装置的状态变化以管控探针卡移动，实现对探针卡移动的监测和精密管控，有效保护了探针卡。

⑧可靠性测试中高性能热传导防压痕测试夹具

具体表征：

技术方案：车载物联网芯片需要进行高频信号的收发，因此该芯片在测试时芯片温度较高，需及时散热避免芯片烧坏；另外该类芯片的衬底一般较薄，而现有测试夹具在使用时存在探针施加到芯片的力过大的情况，容易对芯片造

成划痕。公司针对以上问题开发出了高性能热传导防压痕测试夹具，该测试夹具通过导热压块可以及时传导芯片在测试时产生的热量，且导热压块和螺杆上开设了散热孔，可及时散出热量，避免温度过高。此外，该夹具通过螺杆在安装螺孔中旋转来带动导热压块下降，通过限制螺杆的旋转角度可以控制螺杆的下降距离，从而避免导热压块因下降距离过长而施加到芯片的压力过大，可以防止芯片出现划痕。

先进性：

公司开发的技术方案可以实现以下目标：该夹具方案具有操作简单、故障定位准确、方便快捷等特点，保证了车载物联网芯片可靠性测试的品质，提高了测试良率。

(5) 自动化测试及数据分析技术

①数据挖掘与多维度分析系统

具体表征：

本系统基于公司海量的测试数据和持续的算法优化搭建了成熟的数据分析系统，实现了测试数据的多维度分析，能够准确评估相关良率和测试效率，并及时反馈给相关部门。

先进性：

分析的实时性、多维度和可视性在行业内领先；对于大量数据样本可以快速实现统计计算；对于数据分析结果的多样本反馈可以提供产线更多决策信息。

②测试参数大数据多维度统计分析系统

具体表征：

本系统利用各类中高端测试机产生的不同种类的数据，针对测试参数和指标类型的样本，进行大数据统计分析，并形成了公司特有的数据类型和格式，获得了客户的广泛认可。

先进性：

本系统对重点产品关键测试值进行产品级别的分析；可分析高端机台的测

试稳定性和测试效率情况；综合各种测试信息进行多维度比对，更好地统计预测测试结果。

③生产稼动率统计分析和管控系统

具体表征：

本系统利用大数据对测试设备综合稼动率进行管理，如在不同时间区间对测试机或不同芯片的综合稼动效率统计分析。

先进性：

本系统根据已有的数据样本监控生产稼动率；按照数据的时序性进行样本统计分析；根据机台的利用率自动进行智能排机，并实时监测机台利用率。

④Mapping 分析系统

具体表征：

本系统通过程序化的数据搜集、分析和建模，提前进行晶圆级的数据分析和晶圆图异常预警，根据相关分析指标报警以及自动化处理。

先进性：

本系统能够第一时间了解测试异常情况；可以及时反馈数据异常情况，并告知失效具体类型；通过大样本和多种类的数据建模，提高了分析的针对性，可将生产异常的影响降到最低。

⑤Test Time & Index Time 侦测与分析系统

具体表征：

本系统可侦测产品测试时间，并将其与大数据比较，从而发现测试异常情况。

先进性：

本系统可对测试时间异常的程序和机台实时监测，有益于测试异常监控系统的搭建和完善。

⑥一种合理的高频信号时序设计方法

具体表征：

解决了以下难题：在 SerDes 老化过程中，高频信号时序设计不合理可能导致误码率高、信号质量不稳定，影响 SerDes 的正常工作。传统的高频信号时序设计方法难以精确控制时序，容易受到各种干扰因素的影响。

先进性：

公司开发的高频信号时序设计方法可以实现以下目标：通过精确的时序规划和优化算法，确保 SerDes 在老化过程中的正常工作。该方法能够有效降低误码率，提高信号质量和稳定性。同时，该方案具有良好的通用性和可扩展性，可以应用于不同类型的 SerDes 芯片和老化测试场景。

⑦一种有效的 SerDes Burnin 整体老化方案**具体表征：**

解决了以下难题：传统的 SerDes 老化方案存在早期失效率较高、产品可靠性和稳定性不足的问题，难以准确评估产品质量。缺乏系统性的老化方法，无法全面检测产品潜在缺陷。

先进性：

公司开发的 SerDes Burnin 整体老化方案可以实现以下目标：通过优化的老化流程和精准的测试策略，能够显著降低产品的早期失效率。提高产品的可靠性和稳定性，为产品质量评估提供有力支持。该方案具有高度的针对性和适应性，可以根据不同的 SerDes 产品特性进行定制化调整。

⑧一种信号传输效率提升和功耗降低的接口设计方法**具体表征：**

解决了以下难题：SerDes Burnin 系统中，接口设计不合理会导致信号传输效率低下、功耗较高，影响系统性能。传统接口设计难以实现驱动板和老化炉的无缝连接与高效协同工作。

先进性：

公司开发的接口设计方法可以实现以下目标：通过创新的设计思路和优化

算法，提升信号传输效率并降低功耗，用于优化 SerDes Burnin 系统的性能。采用一体化设计结构，实现驱动板和老化炉的无缝连接和高效协同工作。该方案具有良好的可扩展性和兼容性，可以应用于不同规格的 SerDes Burnin 系统。

⑨测试数据自动化分析处理系统

具体表征：

本系统实现了半导体测试数据的全流程自动化处理，通过数据解析、清洗、转换、Sigma 统计计算与可视化展示，对测试数据进行全面分析与监控。系统支持 MD5 码加密验证确保数据安全性，可自动刷新原始数据（Rawdata）并保持与 Map 图的角度同步，实现多源测试数据的实时同步分析与批量处理。

先进性：

本系统能够自动化完成测试数据的解析、分析与统计计算，显著提升数据处理效率，减少人工干预；通过 Sigma 分析计算与可视化统计，快速识别数据异常与工艺偏差，支持实时决策；采用 MD5 码加密技术保障数据完整性与安全性；系统具备良好的扩展性，可与多种测试机台无缝对接，实现数据同步分析与 Map 图角度校准，为企业提供精准、高效、可靠的测试数据解决方案，提升产品质量控制能力。

⑩测试数据自动化分析处理系统

具体表征：

本系统实现了测试生产全流程的数据自动化采集、整合与智能分析。通过自动化采集测试机运行数据，实现 Map 图自动关联比对、Rawdata 坐标合并与一致性校验，支持自动点废坐标管理、Over Ink 坐标智能提取与重测控制。系统可输出 dlogTDO 数据与 LVM 信息，确保测试数据格式标准化；同时集成芯片静电累积实时监测预警功能，对生产环境与设备状态进行动态监控，实现 Prober 与 Tester 数据坐标的一致性确认，保障数据追溯的准确性与可靠性。

先进性：

本系统能够自动化完成测试生产数据的实时采集与多源数据整合，消除人工录入误差，提升数据采集效率与准确性；通过 Map 图自动关联比对与坐标合

并技术，实现晶圆级数据的精准映射与追溯；智能提取 Over Ink 坐标并自动化管理点废流程，减少重测浪费，提升生产良率；具备芯片静电累积实时监测与预警能力，提前识别生产风险，降低静电损伤导致的质量损失；系统支持多格式数据标准化输出，确保与上下游系统的无缝对接；通过 Prober 与 Tester 数据坐标一致性确认机制，保障测试数据的完整性与可追溯性，全面提升测试生产的智能化水平与质量管理能力。

⑪STDF 数据处理系统

具体表征：

本系统实现了半导体测试数据 STDF（Standard Test Data Format）文件的自动化处理与多格式转换。系统支持 STDF 与 ATDF 等多种标准格式的相互转换与内容修改，具备 STDF 文件信息自动清洗功能，可批量去除冗余数据；支持测试数据报表的自动化生成，实现从原始 STDF 文件到可视化分析报表的一键式处理，提升数据处理效率与标准化水平。

先进性：

本系统能够高效完成 STDF 文件的多格式转换，兼容行业主流数据标准，解决不同测试机台与系统间的数据互通问题；通过自动化信息清洗与 limit 筛选功能，有效剔除无效数据，显著提升数据质量与可靠性；报表自动生成功能大幅缩短数据分析周期，降低人工处理成本；系统支持批量处理与定制化配置，满足不同生产场景的灵活需求，为企业提供标准化、高效率的测试数据处理能力，助力质量追溯与工艺优化决策。

⑫测试修调系统

具体表征：

本系统采用 MCU（微控制器）作为核心控制单元，实现半导体芯片电压与频率参数的高速并行修调测试。系统支持多通道同步修调操作，通过程序化控制自动完成电压修调值与频率修调值的计算、验证与写入，实现对芯片电气特性的精准校准与优化。

先进性：

本系统能够实现电压与频率的并行修调，显著提升测试效率，缩短单颗芯片的修调周期；基于 MCU 的数字化控制方式提高了修调精度与稳定性，减少人为操作误差；系统支持自动化修调流程与闭环验证，确保修调结果的准确性与一致性，有效提升芯片良率与性能指标，降低生产成本。

⑬测试开发自动化系统

具体表征：

解决了以下难题：芯片测试开发当前主要依靠纯人力进行项目过程和进度管理和追踪，测试软硬件设计/开发和调试验证，测试程序 QA 验证和数据分析收集等相关项目研发管理和技术操作，存在开发效率低下、成本高昂、人为误差频发等痛点，不能很好满足当前行业对测试开发的要求。

先进性：

公司开发的测试方案可以实现以下目标：测试开发自动化系统是一套面向芯片测试开发领域，芯片测试开发项目管理、芯片测试向量（pattern）自动生成、智能化 chroma 平台测试程序自动质检与智能化 chroma 平台测试程序自动撰写于一体的综合性自动化解决方案。依托本系统可以自动化实现从测试开发项目导入->测试方案设计->AI 测试代码开发->测试用例调试->测试代码 QA 以及整个项目开发过程中的各个节点，资源，进度，问题的自动化监控。该方案有良好的可移植特性，可在主流测试平台上移植。

3、核心技术的科研实力和成果情况

集成电路测试行业具有技术密集型的特征，技术创新能力是公司核心竞争力的直接体现。公司自成立就十分重视研发投入和技术开发，目前已在测试工程方法、测试方案开发、自动化测试等方面积累了一定的优势。公司是高新技术企业、工信部认定的“专精特新”小巨人企业，并且与客户 A、紫光展锐、晶晨股份、中兴微电子、兆易创新等知名半导体企业建立了长期稳定的合作关系。

公司汇聚了国内优秀的集成电路测试研发、工程和管理人员，核心团队成員平均在测试行业拥有 10 年以上的从业经验。公司的核心技术系自主开发，并随着测试经验的积累逐步完善。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其子公司已取

得 112 项专利，其中发明专利 28 项，实用新型专利 83 项，外观设计专利 1 项。发行人在关键测试技术指标如最大同测数、最高测试频率、测试温度的覆盖范围等都达到或接近国际一流企业同级水平，获得了客户的广泛认可。

十、主要固定资产、无形资产

（一）主要固定资产

1、固定资产基本情况

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、专用设备、办公设备及运输工具等。截至 2026 年 6 月末，公司主要固定资产情况如下：

单位：万元

类别	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率（%）
房屋及建筑物	59,835.17	4,521.97	-	55,313.21	92.44
办公设备	491.04	290.52	-	200.52	40.84
专用设备	648,713.64	148,012.86	-	500,700.78	77.18
运输工具	246.25	100.47	-	145.78	59.20
合计	709,286.11	152,925.82	-	556,360.29	78.44

注：成新率=（账面净值+减值准备）/原值

2、房屋建筑物及土地情况

截至 2026 年 6 月末，公司及其子公司拥有的房产土地情况如下：

序号	权证编号	坐落位置	面积（m²）	用途	权利人	使用期限	取得方式	他项权利
1	沪（2025）浦字不动产权第 087369 号	浦东新区合庆镇红星村 15/8 丘	总面积：29,342.30	工业用地	伟测科技	2025 年 06 月 25 日至 2045 年 06 月 24 日止	出让	抵押 [1]
2	苏（2021）无锡市不动产权第 0242580 号	新达路 28-11，28-12	房屋建筑面积：5,951.07 独用土地使用权面积：9,094.80	工业用地/工业、交通、仓储	无锡伟测	至 2053 年 08 月 29 日止	出让	抵押
3	苏（2025）无锡市不动产权第 0178552 号	电科路 2；锡新二路 52	房屋建筑面积：61317.51 宗地面积：25,543.40	工业用地/工业、交通、仓储	无锡伟测	至 2072 年 08 月 28 日止	出让	抵押 [2]

序号	权证编号	坐落位置	面积 (m ²)	用途	权利人	使用期限	取得方式	他项权利
4	苏 (2024) 宁浦不动 产权第 0039686 号	浦口区云 实路 19 号	宗地面积: 30,707.09; 建筑面积: 54,759.08	工业用地/ 工业, 仓 储 (危), 工业 (配 套), 集 体宿舍	南京 伟测	2023 年 03 月 09 日至 2053 年 03 月 08 日止	出让/ 自建 房	抵押 [3]

注 1: 伟测科技与中国建设银行上海张江分行签署 116512302026-001 号《抵押合同》将沪 (2025) 浦字不动产权第 087369 号抵押给中国建设银行上海张江分行作为 116512302026-001 号《固定资产银团贷款合同》的担保方式, 抵押期限自 2026 年 2 月 1 日至 2031 年 12 月 20 日, 该抵押已办理抵押登记。

注 2: 无锡伟测与招商银行无锡分行签署 510HT202313748702、510HT202313748702-1 号《抵押合同》将苏 (2025) 无锡市不动产权第 0178552 号不动产抵押给招商银行无锡分行作为 510HT2023137487《固定资产借款合同》的担保方式之一, 抵押期限自 2023 年 4 月 24 日至 2029 年 4 月 23 日, 该抵押已办理抵押登记。

注 3: 南京伟测与交通银行江苏省分行签署了 C240821MG3206398 号《抵押合同》将苏 (2024) 宁浦不动产权第 0039686 号不动产抵押给交通银行江苏省分行作为 Z23070R15610286 号《固定资产借款合同》的担保方式之一, 债务履行期限自 2023 年 7 月 26 日至 2031 年 6 月 25 日, 该抵押已办理抵押登记。

3、租赁房产情况

截至 2026 年 6 月末, 公司及其子公司的主要生产、办公租赁使用权情况如下:

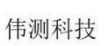
序号	出租方	承租方	租赁标的	租赁用途	面积	租赁期间
1	上海新发创运置业有限公司	伟测科技	上海市浦东新区东胜路 38 号 2 幢	生产	1,984.89m ²	2024/03/30-2027/03/29
2	上海新发创运置业有限公司	伟测科技	上海市浦东新区胜利路 188 号 9 幢 (又称 D1 幢)	生产、办公	3,704.43m ²	2021/03/01-2031/02/28
3	上海新发创运置业有限公司	伟测科技	上海市浦东新区东胜路 38 号 A3-2F (北侧部分)	生产	437.54m ²	2025/04/06-2026/11/05
4	无锡星洲工业园区开发股份有限公司	无锡伟测	无锡新加坡工业园 301 地块 503 号厂房	生产、办公	12,736.68m ²	2026/06/01-2028/05/31
5	南京天弘源资产管理有限公司	南京伟测	南京市浦口经济开发区双浦路 77 号辉瑞控股南京智能装备产业园 A4 栋防火分区 5	生产、办公	5,195.5m ²	2024/12/01-2029/11/30
6	深圳市润东晟物业管理服务	深圳伟测	深圳市宝安区西乡街道 107 国道西乡段 467 号润东晟工	生产、办公	7,000m ²	2023/09/01-2026/08/31

序号	出租方	承租方	租赁标的	租赁用途	面积	租赁期间
	有限公司		业园 4 栋 2-3 楼			
7	深圳市润东晟物业管理服务有限公司	深圳伟测	深圳市宝安区西乡街道 107 国道西乡段 467 号润东晟工业园 4 栋 1 楼	办公	1,050m ²	2024/06/01-2026/08/31
8	深圳市润东晟物业管理服务有限公司	深圳伟测	深圳市宝安区西乡街道润东晟工业园 4 栋厂房楼顶天窗	生产	47.6m ²	2026/01/01-2026/08/31
9	天津瑞能电气有限公司	天津伟测	天津市西青经济技术开发区业盛道 10 号（1-2 层）	办公、实验室及辅助办公	1,268m ²	2024/06/17-2030/09/04
10	天津瑞能电气有限公司	天津伟测	天津市西青经济技术开发区业盛道 10 号（3-4 层）	办公、实验室及辅助办公	1,268m ²	2025/09/05-2030/09/04
11	日月光封装测试（上海）有限公司	上海威矽	上海市张江高科技园区郭守敬路 669 号 H3-3F	研发和实验室	1,900m ²	2025/08/20-2028/08/19
12	成都高投芯未半导体有限公司	成都伟测（筹）	成都市高新区康强三路 1111 号 1 号楼 3 层附 A318 号	工厂	15.1m ²	2026/01/28-2026/07/28

（二）主要无形资产

1、商标权

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其子公司取得商标情况如下：

序号	权利人	商标图样	注册号	类别	有效期限	取得方式
1	伟测科技		20878315	42	2017-12-07 至 2027-12-06	原始取得
2	伟测科技		20878280	42	2017-09-28 至 2027-09-27	原始取得
3	伟测科技		20878303	42	2017-12-14 至 2027-12-13	原始取得
4	伟测科技		79970881	42	2025-01-07 至 2035-01-06	原始取得

2、专利技术情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其子公司已取得 112 项专利，其中发明专利 28 项，实用新型专利 83 项，外观设计专利 1 项，详情如下：

(1) 发明专利

序号	名称	权利人	申请号/专利号	申请日	取得方式	他项权利
1	晶圆区域性问题的分析系统及方法	伟测科技	202110310750.9	2021 年 03 月 24 日	原始取得	无
2	一种测试机匹配检测系统及其方法	伟测科技	202011533224.0	2020 年 12 月 23 日	原始取得	无
3	一种 Wafer ID 烧写防呆的系统	伟测科技	202011523844.6	2020 年 12 月 22 日	原始取得	无
4	一种多平台联动提效机构	伟测科技	202011489734.2	2020 年 12 月 17 日	原始取得	无
5	一种集成电路精确测试小电阻的方法	伟测科技	202011160294.6	2020 年 10 月 27 日	原始取得	无
6	腐蚀粉在整形铂金探针的应用和铂金探针的整形方法	伟测科技	202110234659.3	2021 年 03 月 03 日	原始取得	无
7	一种晶圆 MAP 图的转换系统和转换方法	伟测科技	202110234648.5	2021 年 03 月 03 日	原始取得	无
8	一种悬臂式探针寿命测算方法	伟测科技	202110234623.5	2021 年 03 月 03 日	原始取得	无
9	温控系统及封装测试方法	伟测科技	202610250586. X	2026 年 03 月 03 日	原始取得	无
10	一种查表法结合全值仿真或二分法的电压 Trim 测试方法	天津伟测、伟测科技	202610149246. 8	2026 年 02 月 03 日	原始取得	无
11	晶圆检测装置及检测设备	伟测科技	202610128856. X	2026 年 01 月 30 日	原始取得	无
12	晶圆测试装置	伟测科技	202610114304. 3	2026 年 01 月 28 日	原始取得	无
13	晶圆测试装置及测试设备	伟测科技	202610106639. 0	2026 年 01 月 27 日	原始取得	无
14	测试方法及其测试装置	伟测科技	202610004536. 3	2026 年 01 月 05 日	原始取得	无
15	多晶硅工艺保险丝的熔断装置及方法	无锡伟测	202110248636.8	2021 年 03 月 08 日	继受取得	无
16	一种集成电路芯片检测设备	无锡伟测	202410445062.7	2024 年 04 月 15 日	原始取得	无
17	一种基于测试封装 Mapping 自动检查校验方法及系统	南京伟测	202210299882.0	2022 年 03 月 25 日	原始取得	无

序号	名称	权利人	申请号/专利号	申请日	取得方式	他项权利
18	晶圆分导设备及其工作方法	南京伟测	202210299371.9	2022 年 03 月 25 日	原始取得	无
19	一种基于 ATE 通用 CIS 芯片测试系统及方法	南京伟测	202210300651.7	2022 年 03 月 25 日	原始取得	无
20	一种全方位检测晶舟盒内晶圆的装置	南京伟测	202210299267.X	2022 年 03 月 25 日	原始取得	无
21	一种晶舟盒内晶圆位置检测装置	南京伟测	202210289165.X	2022 年 03 月 23 日	原始取得	无
22	一种低温探针台清针砂纸的更换装置和更换方法	南京伟测	202210276338.4	2022 年 03 月 21 日	原始取得	无
23	晶圆分导设备及其工作方法	南京伟测	202210579733.X	2022 年 03 月 25 日	原始取得	无
24	晶圆分导设备	南京伟测	202210579725.5	2022 年 03 月 25 日	原始取得	无
25	一种基于机器学习的 IC 点数设备及清点方法	南京伟测	202411912723.9	2024 年 12 月 24 日	原始取得	无
26	一种 93K 批量转化标准 TESTSUITE 名称的方法	南京伟测、天津伟测	202511554830.3	2025 年 10 月 29 日	原始取得	无
27	一种低成本晶圆测试方法	南京伟测、深圳伟测	202511914697.8	2025 年 12 月 18 日	原始取得	无
28	一种强制执行标签尾数和合批先行比对的包装方法	南京伟测	202610070085.3	2026 年 01 月 20 日	原始取得	无

注：上述发明专利的专利期限为二十年，自申请日起算。上述第 15 项专利系无锡伟测从发行人处受让取得，转让过程合法、有效，并已在国家知识产权局备案。

(2) 实用新型专利

序号	名称	权利人	申请号/专利号	申请日	取得方式	他项权利
1	一种测试机的安装装置	伟测科技	202122756640.3	2021 年 11 月 11 日	原始取得	无
2	一种车间多功能一体车	伟测科技	202122953388.5	2021 年 11 月 29 日	原始取得	无
3	一种自动式镊子打磨装置	伟测科技	202123005416.7	2021 年 12 月 1 日	原始取得	无
4	一种探针台测试机头安装支架	伟测科技	202122998571.7	2021 年 12 月 1 日	原始取得	无
5	一种通讯数据	伟测科技	202122998535.0	2021 年 12	原始取得	无

序号	名称	权利人	申请号/专利号	申请日	取得方式	他项权利
	线			月 1 日		
6	一种晶片传送手臂和半导体设备	伟测科技	202122998534.6	2021 年 12 月 1 日	原始取得	无
7	一种测试机接线防错插装置	伟测科技	202123224487.6	2021 年 12 月 21 日	原始取得	无
8	一种晶圆分片装置	伟测科技	202123226239.5	2021 年 12 月 21 日	原始取得	无
9	一种针卡测试防呆装置	伟测科技	202123226284.0	2021 年 12 月 21 日	原始取得	无
10	一种半导体生产设备降温装置	伟测科技	202123284450.2	2021 年 12 月 24 日	原始取得	无
11	一种晶圆转运装置	伟测科技	202123284451.7	2021 年 12 月 24 日	原始取得	无
12	一种半导体压模治具	伟测科技	202123344227.2	2021 年 12 月 28 日	原始取得	无
13	一种半导体测试设备的吸嘴	伟测科技	202123344188.6	2021 年 12 月 28 日	原始取得	无
14	一种测试头移动装置	伟测科技	202123338666.2	2021 年 12 月 28 日	原始取得	无
15	一种半导体材料干燥柜	伟测科技	202220313360.7	2022 年 2 月 16 日	原始取得	无
16	一种防掉落的晶圆打点工作台	伟测科技	202220313893.5	2022 年 2 月 16 日	原始取得	无
17	一种芯片封合装置	伟测科技	202220325171.1	2022 年 2 月 17 日	原始取得	无
18	一种芯片包装卡盘安装装置	伟测科技	202220321961.2	2022 年 2 月 17 日	原始取得	无
19	一种晶圆吹风清洁装置	伟测科技	202220343257.7	2022 年 2 月 21 日	原始取得	无
20	一种晶圆片输送存放装置	伟测科技	202220343256.2	2022 年 2 月 21 日	原始取得	无
21	一种半导体编带机面带导向装置	伟测科技	202220399536.5	2022 年 2 月 25 日	原始取得	无
22	一种方卡上歪及松动的报警装置	伟测科技	202220398198.3	2022 年 2 月 25 日	原始取得	无
23	一种厂务压缩空气湿度检测装置	伟测科技	202220398545.2	2022 年 2 月 25 日	原始取得	无
24	一种对接板锁紧装置	伟测科技	202220516851.1	2022 年 3 月 9 日	原始取得	无
25	一种常高温机台腔体内部温	伟测科技	202220514572.1	2022 年 3 月 9 日	原始取得	无

序号	名称	权利人	申请号/专利号	申请日	取得方式	他项权利
	度降温装置					
26	一种半导体测试机环境校正装置	伟测科技	202220516853.0	2022年3月9日	原始取得	无
27	一种电脑支架	伟测科技	202220514569.X	2022年3月9日	原始取得	无
28	一种基于半导体测试的限位柱	伟测科技	202221683741.0	2022年6月30日	原始取得	无
29	一种晶圆测试台降温装置	伟测科技	202221683735.5	2022年6月30日	原始取得	无
30	一种具有防碰撞功能的中继板	伟测科技	202221704479.3	2022年7月4日	原始取得	无
31	一种传感器探头快速拆装结构及晶圆测试机承载平台	伟测科技	202222616452.5	2022年9月30日	原始取得	无
32	一种机台维护器具推送装置	伟测科技	202222613914.8	2022年9月30日	原始取得	无
33	一种降温装置的支架及降温装置	伟测科技	202320690238.6	2023年3月31日	原始取得	无
34	一种冷凝水隔绝装置及降温装置	伟测科技	202320690307.3	2023年3月31日	原始取得	无
35	一种芯片测试机站台固定支架	伟测科技	202320342786.X	2023年2月28日	原始取得	无
36	一种芯片测试机的支撑机构	伟测科技	202320342785.5	2023年2月28日	原始取得	无
37	一种半导体测试装置	伟测科技	202320342787.4	2023年2月28日	原始取得	无
38	一种温度测试机台封闭结构	伟测科技	202320690230.X	2023年3月31日	原始取得	无
39	一种防回弹装置及烤箱	伟测科技	202321363987.4	2023年5月31日	原始取得	无
40	一种限位装置及晶圆检验承载台	伟测科技	202321364346.0	2023年5月31日	原始取得	无
41	一种快接式吸头及其辅助扳手	伟测科技	202422853587.2	2024年11月22日	原始取得	无
42	一种一体式芯片托盘轨道挡板	伟测科技	202422853588.7	2024年11月22日	原始取得	无
43	一种半导体测	伟测科技	202423087039.X	2024年12	原始取得	无

序号	名称	权利人	申请号/专利号	申请日	取得方式	他项权利
	试设备用水平度验证装置			月 13 日		
44	一种外抽包装机用承载台	伟测科技	202423087040.2	2024 年 12 月 13 日	原始取得	无
45	一种芯片检测装置用支撑平台	伟测科技	202423101776.0	2024 年 12 月 16 日	原始取得	无
46	一种自动清洁的清针装置、控制系统	伟测科技	2024231017671	2024 年 12 月 16 日	原始取得	无
47	一种机台恒温装置	伟测科技	202423101770.3	2024 年 12 月 16 日	原始取得	无
48	一种存储柜	无锡伟测	202321886066.6	2023 年 7 月 18 日	原始取得	无
49	一种用于半导体编带机的导带轮装置	无锡伟测	202223554859.6	2022 年 12 月 29 日	原始取得	无
50	一种方便操作的便携式有线线缆检测机构	无锡伟测	202120554510.9	2021 年 3 月 18 日	原始取得	无
51	一种探针卡针延长寿命用的垫座	无锡伟测	202120556145.5	2021 年 3 月 18 日	原始取得	无
52	一种子母式探针卡装配结构	无锡伟测	202120864029.X	2021 年 4 月 25 日	原始取得	无
53	一种延长墨管使用寿命的装置	无锡伟测	202120868460.1	2021 年 4 月 25 日	原始取得	无
54	一种防止测试载板结霜的装置	无锡伟测	202120866185.X	2021 年 4 月 25 日	原始取得	无
55	一种探针卡拆卸防呆装置	无锡伟测	202120870208.4	2021 年 4 月 25 日	原始取得	无
56	一种 Chroma Q-type 转接板开路断路检验装置	无锡伟测	202120877907.1	2021 年 4 月 26 日	原始取得	无
57	一种用于半导体自动分选机快速降温装置	无锡伟测	202121422099.6	2021 年 6 月 24 日	原始取得	无
58	一种集成电路检测设备	无锡伟测	202121569857.7	2021 年 7 月 9 日	原始取得	无
59	料盘翘曲平整装置	无锡伟测	202121715058.6	2021 年 7 月 26 日	原始取得	无
60	一种半导体测试用温度控制装置	无锡伟测	202122920286.3	2021 年 11 月 25 日	原始取得	无

序号	名称	权利人	申请号/专利号	申请日	取得方式	他项权利
61	一种用于 tray 盘上下料的防呆装置	无锡伟测	202122923218.2	2021 年 11 月 25 日	原始取得	无
62	一种用于半导体芯片烘干的载具	无锡伟测	202123368966.5	2021 年 12 月 29 日	原始取得	无
63	一种测试机转接板	无锡伟测	202123430442.4	2021 年 12 月 30 日	原始取得	无
64	一种用于硅片分选机的分筛收纳装置	无锡伟测	202220317050.2	2022 年 2 月 16 日	原始取得	无
65	一种卷盘包装芯片拆料装置	无锡伟测	202220551687.8	2022 年 3 月 14 日	原始取得	无
66	一种用于 tray 盘包装的防呆装置	无锡伟测	202220960981.4	2022 年 4 月 22 日	原始取得	无
67	一种用于多探针台的低温控制系统	无锡伟测	202222324582.1	2022 年 9 月 1 日	原始取得	无
68	一种设备降温系统的过滤系统	无锡伟测	202221328607.9	2022 年 5 月 30 日	原始取得	无
69	一种用于冷水机固定式散热排气的装置	无锡伟测	202423141428.6	2024 年 12 月 19 日	原始取得	无
70	一种裸片晶圆及超薄晶圆测试设备	南京伟测	202123241853.9	2021 年 12 月 22 日	原始取得	无
71	一种晶圆测试装置	南京伟测	202123242728.X	2021 年 12 月 22 日	原始取得	无
72	一种晶圆清理装置	南京伟测	202123285659.0	2021 年 12 月 24 日	原始取得	无
73	一种半导体测试装置	南京伟测	202220321949.1	2022 年 2 月 17 日	原始取得	无
74	一种探针卡托盘	南京伟测	202220321964.6	2022 年 2 月 17 日	原始取得	无
75	一种探针卡保护装置	南京伟测	202220343247.3	2022 年 2 月 21 日	原始取得	无
76	一种 Cable Mount LB 安装拆卸辅助支架	南京伟测	202322944071.4	2023 年 10 月 31 日	原始取得	无
77	一种芯片测试分选机远程暂停外挂装置	南京伟测	202421219911.9	2024 年 05 月 30 日	原始取得	无
78	一种芯片测试过程中取料装置	南京伟测	202521426332.6	2025 年 07 月 08 日	原始取得	无

序号	名称	权利人	申请号/专利号	申请日	取得方式	他项权利
79	一种接地线接地快接装置	深圳伟测	202320406000.6	2023 年 03 月 07 日	继受取得	无
80	一种半导体测试机防呆装置	深圳伟测	202320690229.7	2023 年 03 月 31 日	继受取得	无
81	一种自动升降式吊车	深圳伟测	202321378785.7	2023 年 05 月 31 日	继受取得	无
82	一种测试机水管存放机构	深圳伟测	202322187103.0	2023 年 08 月 15 日	继受取得	无
83	一种测试机支架及测试机	深圳伟测	202322192835.9	2023 年 08 月 15 日	继受取得	无

注：上述实用新型专利的专利期限为十年，自申请日起算。上述第 79、80、81、82、83 项专利系深圳伟测从发行人处受让取得，转让过程合法、有效，并已在国家知识产权局备案。

(3) 外观设计专利

序号	名称	权利人	申请号/专利号	申请日	取得方式	他项权利
1	快速接头	深圳伟测	202530736035.0	2025 年 12 月 12 日	原始取得	无

注：上述外观设计专利的专利期限为十五年，自申请日起算。

3、集成电路布图设计情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其子公司拥有 3 项集成电路布图设计登记证书，具体情况如下：

序号	布图设计权利人名称	布图设计名称	布图设计登记号	布图设计申请日	布图设计创作完成日	布图设计首次投入商业利用日	布图设计颁证日	他项权利
1	伟测科技	电流值智能检测仪电路设计布图	BS.215515021	2021 年 2 月 8 日	2020 年 8 月 20 日	-	2021 年 4 月 9 日	无
2	伟测科技	芯片内部温度检测仪电路设计布图	BS.215515048	2021 年 2 月 8 日	2020 年 8 月 20 日	-	2021 年 3 月 26 日	无
3	伟测科技	智能电压值检测装置电路设计布图	BS.215515064	2021 年 2 月 8 日	2020 年 8 月 20 日	-	2021 年 3 月 26 日	无

4、软件著作权情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其子公司拥有 163 项软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	开发完成日期
1	伟测科技	伟测测试机跨平台晶圆图自动生成转换系统[简称：跨平台转换]V1.0	2024SR0455039	原始取得	全部权利	未发表	2024 年 2 月 6 日
2	伟测科技	伟测自动实时检测测试机晶圆图区域失效软件[简称：实时检测测试机晶圆图区域失效]V1.0	2024SR0444003	原始取得	全部权利	未发表	2022 年 2 月 10 日
3	伟测科技	伟测老化炉板卡系统的流程设计和应用实现软件[简称：针卡系统的流程设计和应用]V1.0	2024SR0443571	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 2 月 15 日
4	伟测科技	伟测客户暂扣产品自动放行流程管控软件[简称：暂扣产品自动放行]V1.0	2024SR0397604	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 11 月 26 日
5	伟测科技	伟测自动异常测试流程管控软件[简称：异常测试流程管控软件]V1.0	2023SR0936382	原始取得	全部权利	未发表	2022 年 5 月 16 日
6	伟测科技	伟测客户特殊流程自动投料测试软件[简称：特殊流程自动投料测软件]V1.0	2023SR0933653	原始取得	全部权利	未发表	2021 年 10 月 31 日
7	伟测科技	伟测实时自动化多维标度分析软件[简称：实时自动化多维标度分析]V1.0	2023SR1061121	原始取得	全部权利	未发表	2022 年 6 月 20 日
8	伟测科技	伟测自动规则卡控处理测试异常软件[简称：异常测试处理软件]V1.0	2023SR1095189	原始取得	全部权利	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日
9	伟测科技	伟测客户自动邮件回货报表软件[简称：伟测客户自动邮件回货报表]V1.0	2023SR1280733	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 7 月 9 日
10	伟测科技	伟测自动化单一标签防呆打印软件[简称：单一标签防呆打印]V1.0	2023SR1498718	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 7 月 26 日

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	开发完成日期
11	伟测科技	伟测自动化合并转换晶圆图管控方法软件[简称：晶圆图管控方法]V1.0	2023SR1763023	原始取得	全部权利	未发表	2023年8月27日
12	伟测科技	伟测老化炉板卡管理系统软件[简称：老化炉板卡管理系统]V1.0	2024SR0262798	原始取得	全部权利	未发表	2023年10月10日
13	伟测科技	伟测多类型格式测报自动生成软件 V1.0	2023SR0803218	原始取得	全部权利	未发表	2022年6月20日
14	伟测科技	伟测自动规则卡控处理多流程测试软件[简称：自动规则卡控处理软件]V1.0	2023SR0372582	原始取得	全部权利	未发表	2021年10月31日
15	伟测科技	伟测测试机晶圆图与客户文件自动下载合并软件[简称：自动下载合并软件]V1.0	2023SR0287844	原始取得	全部权利	未发表	2021年10月31日
16	伟测科技	伟测多类型自动化文件传输软件[简称：多类型自动化文件传输软件]V1.0	2022SR1432707	原始取得	全部权利	未发表	2021年12月30日
17	伟测科技	伟测测试机针卡系统的流程设计和应用实现软件[简称：针卡系统的流程设计和应用]V1.0	2022SR1085074	原始取得	全部权利	未发表	2021年12月30日
18	伟测科技	伟测在线实时复测预警决策自动化软件[简称：实时复测预警决策]V1.0	2022SR1085033	原始取得	全部权利	未发表	2022年2月10日
19	伟测科技	伟测检测测试机 STDF 参数坐标非重复一致性的软件[简称：参数坐标非重复一致性检测]V1.0	2022SR1085076	原始取得	全部权利	未发表	2021年10月13日
20	伟测科技	伟测自动实时检测测试机晶圆图偏移软件[简称：实时检测测试机晶圆图偏移]V1.0	2022SR1070456	原始取得	全部权利	未发表	2022年2月10日
21	伟测科技	伟测 FT 测试机 STDF 大文件区域性参数统计分析软件[简称：STDF 大文件区域性参数分析]V1.0	2022SR1037437	原始取得	全部权利	未发表	2021年10月31日
22	伟测	伟测测试机 STDF 文	2022SR0460719	原始	全部	未发表	2022年1

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	开发完成日期
	科技	件到 TSK 探针台的 Map 图转换软件[简称: STDF 文件到 TSK 探针台的 Map 图转换]V1.0		取得	权利		月 25 日
23	伟测科技	伟测测试机 TSK 探针台的 Map 图转换方法软件[简称: TSK 探针台的 Map 图转换]V1.0	2022SR0460745	原始取得	全部权利	未发表	2022 年 1 月 25 日
24	伟测科技	伟测半导体芯片测试过程断电防护管理软件 V1.0	2022SR0454479	原始取得	全部权利	未发表	2021 年 10 月 21 日
25	伟测科技	伟测半导体芯片测试参数信息管理软件 V1.0	2022SR0451163	原始取得	全部权利	未发表	2021 年 9 月 9 日
26	伟测科技	伟测客户自动投料卡控对比软件[简称: 自动投料卡控]V1.0	2024SR0854969	原始取得	全部权利	未发表	2024 年 6 月 24 日
27	伟测科技	通用数据汇总系统 [简称: 集合]V1.0	2024SR0857058	原始取得	全部权利	未发表	2024 年 6 月 24 日
28	伟测科技	基于 Chroma ATE 平台的射频前端芯片自动化测试软件 V1.0	2026SR0383759	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 3 月 5 日
29	伟测科技	基于存储通道安全加密芯片 HX0168 的 chroma 平台测试软件 V1.0	2026SR0377185	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 3 月 4 日
30	伟测科技	基于 Chroma3380P 平台自动化测试软件 V5.0	2026SR0357124	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 3 月 2 日
31	伟测科技	基于车规级 BMS 专用隔离通信芯片的 Chroma 平台自动化测试软件 V1.0	2026SR0334209	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 2 月 26 日
32	伟测科技	基于 Chroma ATE 平台的射频功率放大器芯片自动化测试软件 V1.0	2026SR0334194	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 2 月 26 日
33	伟测科技	基于 Chroma3380P 平台的 CMOS 光芯片自动化测试软件 V1.0	2026SR0334162	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 2 月 26 日
34	伟测科技	基于 J750HD 平台的高速时钟芯片通用测试软件 V1.0	2026SR0334104	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 2 月 26 日
35	伟测科技	测试数据解析软件 [简称: 数据解析] V1.0	2026SR0221629	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 2 月 3 日

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	开发完成日期
36	伟测科技	基于 V93K 平台的 SOC 芯片的自动化测试软件 V1.0	2026SR0102886	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 1 月 16 日
37	伟测科技	基于 chroma 平台的车规级数字转换器芯片测试软件 V1.0	2026SR0101995	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 1 月 16 日
38	伟测科技	基于 Chroma3380P 平台自动化测试 Lin 收发器程序软件 V1.0	2026SR0101934	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 1 月 16 日
39	伟测科技	基于 Chroma3380P 平台的雷达波束赋形芯片测试软件 V1.0	2026SR0101306	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 1 月 16 日
40	伟测科技	基于车规级电控专用 MCU 芯片的 Chroma 平台自动化测试软件 V1.0	2026SR0100982	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 1 月 16 日
41	伟测科技	基于 chroma 平台测试程序自动 QA 检查软件[简称: Chroma Auto QA Tool]V1.0	2025SR2442567	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 12 月 18 日
42	伟测科技	基于 Chroma3380P 平台的雷达波束赋形芯片自动化测试软件 V1.0	2025SR2440598	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 12 月 18 日
43	伟测科技	基于 Chroma3380P 平台的 SIT1462 芯片测试自动化软件 V1.0	2025SR2438489	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 12 月 18 日
44	伟测科技	TS4160_AX6250 微控制芯片基于 chroma 平台测试软件 V1.0	2025SR2369653	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 12 月 8 日
45	伟测科技	基于 Chroma3380P 平台自动化测试软件 V1.0	2025SR2369320	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 12 月 8 日
46	伟测科技	基于 Chroma3380P 平台自动化测试软件 V4.0	2025SR2260089	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 11 月 24 日
47	伟测科技	基于 Chroma 平台的 UT32404x MCU 系列芯片自动化测试软件 V1.0	2025SR2249367	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 11 月 21 日
48	伟测科技	MS60F302x 系列微控制器芯片基于 chroma 平台测试软件 V1.1	2025SR2249358	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 11 月 21 日
49	伟测科技	基于 Chroma3380P 平台的一款车载蓝牙	2025SR2247917	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 11 月 21 日

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	开发完成日期
		芯片自动化测试软件 V1.0					
50	伟测科技	基于 Chroma3380P 平台的 VL7724 芯片测试自动化软件 V1.0	2025SR2246642	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 11 月 21 日
51	伟测科技	PID 页面比对系统 [简称: PID 比对] V1.0	2025SR2077625	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 10 月 27 日
52	伟测科技	STDF 转 ATDF 修改系统 [简称: STDF 转 ATDF] V1.0	2025SR2077617	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 10 月 27 日
53	伟测科技	伟测测试数据自动化分析处理软件 [简称: 测试数据自动化分析处理软件] V1.0	2025SR2077606	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 10 月 27 日
54	伟测科技	半导体测试数据 Sigma 分析计算软件 [简称: Sigma 分析计算] V1.0	2025SR2077508	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 10 月 27 日
55	伟测科技	基于 Chroma3380P 平台自动化测试软件 V2.0	2025SR1895326	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 28 日
56	伟测科技	伟测测试机数据分析软件 [简称: 数据分析软件] V1.0	2025SR1895267	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 28 日
57	伟测科技	半导体测试数据可视化与统计分析系统 [简称: 可视化统计分析] V1.0	2025SR1895256	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 28 日
58	伟测科技	MES 一键登录自动化系统 [简称: MES 一键登录自动化] V1.0	2025SR1895234	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 28 日
59	伟测科技	基于 Chroma3380P 平台的 IPC100 芯片测试自动化软件 V1.0	2025SR1891657	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 28 日
60	伟测科技	基于 Chroma ATE 平台自动化测试 NSCSA3636Q 芯片软件 V1.0	2025SR1890644	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 28 日
61	伟测科技	基于 Chroma ATE 平台的车规级 MCU 类型芯片自动化测试软件 V1.0	2025SR1890635	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 28 日
62	伟测科技	基于车规级本地互联网络收发芯片的 Chroma 平台自动化	2025SR1797100	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 17 日

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	开发完成日期
		测试软件 V1.0					
63	伟测科技	基于 Chroma ATE 平台车规级 MCU 类型芯片常规测试软件 V1.0	2025SR1797038	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 17 日
64	伟测科技	基于 Chroma3380P 平台的 eMMC 主控芯片自动化测试软件 V6.0	2025SR1797024	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 17 日
65	伟测科技	基于 chroma 平台测试 GS32F0039Q 芯片软件 V1.0	2025SR1782611	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 16 日
66	伟测科技	基于 Chroma3380P 平台自动化测试软件 V3.0	2025SR1782609	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 16 日
67	伟测科技	Map 自动关联比对工具软件[简称: Map 比对] V1.0	2025SR1758866	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 11 日
68	伟测科技	Raw data 坐标合并系统[简称: 坐标合并] V1.0	2025SR1631722	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 8 月 27 日
69	伟测科技	dlog TDO 数据-LVM 信息输出系统[简称: Dlog 输出] V1.0	2025SR1614491	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 8 月 25 日
70	伟测科技	伟测 Over Ink 坐标智能提取软件[简称: Over Ink 坐标智能提取软件] V1.0	2025SR1559134	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 8 月 18 日
71	伟测科技	自动化点废坐标系统[简称: INK 系统] V1.0	2025SR1533196	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 8 月 14 日
72	伟测科技	伟测测试数据 STDF 多格式转换软件[简称: STDF 批量转换软件] V1.0	2025SR1533112	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 8 月 14 日
73	伟测科技	SUA_Summ 分析工具软件[简称: Summ 分析] V1.0	2025SR1489081	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 8 月 8 日
74	伟测科技	半导体 STDF 文件测试 limit 筛除软件[简称: Limit 筛除] V1.0	2025SR0970996	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 6 月 10 日
75	伟测科技	伟测测试数据 STDF 报表自动生成软件[简称: STDF 报表自动生成软件] V1.0	2025SR0772704	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 5 月 13 日
76	伟测科技	STDF 文件信息清洗系统[简称: STDF 刷新] V1.0	2025SR0745431	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 5 月 8 日

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	开发完成日期
77	伟测科技	伟测晶圆数据文件智能重命名软件[简称：晶圆数据文件智能重命名软件] V1.0	2025SR0690746	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 4 月 27 日
78	伟测科技	伟测多片晶圆缺陷识别软件[简称：Map 叠图] V1.0	2024SR1140501	原始取得	全部权利	未发表	2024 年 8 月 7 日
79	伟测科技	伟测 Map 格式转换软件[简称：Map 格式转换] V1.0	2024SR1140483	原始取得	全部权利	未发表	2024 年 8 月 7 日
80	伟测科技	伟测晶圆图智能比对分析系统[简称：晶圆图智能比对分析系统]	2026SR0221449	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 2 月 3 日
81	伟测科技	伟测晶圆 Mapping Shift 检测软件[简称：晶圆 Mapping Shift 检测] V1.0	2026SR0621573	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 5 月 26 日
82	无锡伟测	伟测客户包装单号自动生成软件[简称：包装单号自动生成软件]V1.0	2024SR0461259	原始取得	全部权利	未发表	2024 年 2 月 6 日
83	无锡伟测	伟测自动卡控机台借料管理软件[简称：卡控机台借料管理系统]V1.0	2024SR0389735	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 11 月 10 日
84	无锡伟测	伟测可配置测报自动生成软件[简称：测报自动生成]V1.0	2024SR0111633	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 9 月 27 日
85	无锡伟测	伟测全流程自动化标签比对防呆软件[简称：全流程自动化标签比对防呆]V1.0	2023SR1480335	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 7 月 26 日
86	无锡伟测	伟测客户智能化帐料一致性管控软件[简称：帐料一致性管控]V1.0	2023SR1367678	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 7 月 26 日
87	无锡伟测	伟测实时自动化多维度数据展示软件[简称：数据展示]V1.0	2023SR1072652	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 6 月 20 日
88	无锡伟测	伟测客户工单自动更新投料软件[简称：更新客户工单]V1.0	2023SR0894296	原始取得	全部权利	2023 年 05 月 08 日	2023 年 4 月 26 日
89	无锡伟测	伟测客户测试数据信息自动获取生成发送的软件[简称：测试数据信息自动获取生成发送]V1.0	2023SR0669015	原始取得	全部权利	未发表	2022 年 6 月 26 日

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	开发完成日期
90	无锡伟测	伟测多维度自动判定生成不同类型晶圆图方法软件[简称：多维度自动判定生成不同类型晶圆图]V1.0	2023SR0604444	原始取得	全部权利	未发表	2022年2月10日
91	无锡伟测	伟测实时自动化多维度分析软件[简称：实时自动化多维度分析]V1.0	2023SR0604443	原始取得	全部权利	未发表	2022年6月20日
92	无锡伟测	伟测实时数据自动化分类客户传输软件[简称：自动实时文件上]V1.0	2023SR0398142	原始取得	全部权利	未发表	2022年2月10日
93	无锡伟测	伟测比对客户来料信息自动投帐测试软件[简称：比对客户来料信息]V1.0	2023SR0382126	原始取得	全部权利	未发表	2022年6月26日
94	无锡伟测	伟测多流程测试自动数据处理软件[简称：自动数据处理]V1.0	2023SR0382125	原始取得	全部权利	未发表	2022年6月20日
95	无锡伟测	伟测自动合并转换客户文件生成晶圆图方法软件[简称：客户文件转换合并软件]V1.0	2023SR0087686	原始取得	全部权利	未发表	2021年10月31日
96	无锡伟测	伟测测试机老化夹具管理系统的流程设计 and 应用实现软件[简称：老化夹具管理系统]V1.0	2022SR1478935	原始取得	全部权利	未发表	2022年2月10日
97	无锡伟测	伟测测试机文件自动实时检测规则的反向验证软件[简称：自动实时检测规则的反向验证]V1.0	2022SR0923843	原始取得	全部权利	未发表	2022年2月10日
98	无锡伟测	伟测检测测试机STDF基础参数级信息准确性的软件[简称：基础参数级信息准确性的方法]V1.0	2022SR0757749	原始取得	全部权利	未发表	2022年2月10日
99	无锡伟测	伟测测试机晶圆图空洞自动填补方法软件[简称：空洞自动填补软件]V1.0	2022SR0663671	原始取得	全部权利	未发表	2021年10月31日
100	无锡伟测	伟测计算不同条件下的机台OEE方法软件[简称：计算不同	2022SR0380205	原始取得	全部权利	未发表	2022年2月10日

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	开发完成日期
		条件下的机台 OEE 方法]V1.0					
101	无锡伟测	伟测预警平台的前台布局和数据展现的方法软件[简称：预警平台的前台布局和数据展现的方法]V1.0	2022SR0380206	原始取得	全部权利	未发表	2022 年 2 月 10 日
102	无锡伟测	伟测测试机 XML/TXT 文件探针台的 MAP 图转换软件[简称：XML/TXT 文件探针台的 MAP 图转换]V1.0	2022SR0294009	原始取得	全部权利	未发表	2022 年 1 月 10 日
103	无锡伟测	伟测测试机 CSV 文件到 TSK 探针台的晶圆图转换软件[简称：CSV 晶圆图转换]V1.0	2022SR0089491	原始取得	全部权利	未发表	2021 年 10 月 31 日
104	无锡伟测	伟测 TXT&Excel 与晶圆&Bin 坐标对比软件[简称：坐标对比软件]V1.0	2021SR1949672	原始取得	全部权利	未发表	2021 年 10 月 31 日
105	无锡伟测	伟测测试机 STDF 大文件压缩转换软件[简称：STDF 大文件压缩转换]V1.0	2021SR1949659	原始取得	全部权利	未发表	2021 年 10 月 31 日
106	无锡伟测	伟测 TEL 型号探针台的晶圆图转换软件[简称：TEL 晶圆图转换]V1.0	2021SR1867682	原始取得	全部权利	未发表	2021 年 10 月 31 日
107	无锡伟测	伟测自动测试报告系统[简称：自动测报系统]V1.0	2021SR1041353	受让取得	全部权利	2017 年 06 月 05 日	2017 年 6 月 1 日
108	无锡伟测	伟测参数级特殊点废测报自动生成软件[简称：参数级特殊点废]V1.0	2024SR0116106	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 9 月 20 日
109	无锡伟测	测试机信息自动化采集系统 V1.0	2026SR0219066	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 2 月 3 日
110	无锡伟测	伟测 PID 检查比对邮件发送系统软件[简称：PID 比对系统]V1.0	2026SR0064696	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 1 月 12 日
111	无锡伟测	芯片测试大范围精密治具自动影像存档系统 V1.0	2026SR0008310	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 1 月 4 日
112	无锡伟测	氮气柜监控系统 V1.0	2025SR2412406	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 12 月 12 日

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	开发完成日期
113	无锡伟测	伟测 Prober 数据与 Tester 数据坐标一致性确认软件[简称: Prober 数据与 Tester 数据坐标一致性确认软件] V1.0	2025SR2250028	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 11 月 21 日
114	无锡伟测	IQC Tray 盘及 IC Laser Mark 的识别和卡控软件 V1.0	2025SR2032908	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 10 月 21 日
115	无锡伟测	基于 B2B 传输方式某客户出货及确认软件[简称: B2B 传输方式某客户出货及确认软件] V1.0	2025SR1007078	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 6 月 13 日
116	无锡伟测	基于防止晶圆测试特征点偏移的软件系统 V1.0	2025SR0590964	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 4 月 9 日
117	无锡伟测	伟测 map Ink 自动化软件[简称: Map Ink] V1.0	2024SR2177452	原始取得	全部权利	未发表	2024 年 12 月 24 日
118	无锡伟测	伟测 t5830 平台文件自动化解析软件[简称: 数据解析] V1.0	2024SR2176788	原始取得	全部权利	未发表	2024 年 12 月 24 日
119	无锡伟测	伟测 Prober 数据智能转换 Map 图形软件[简称: prober 转 Map 系统] V1.0	2024SR2166602	原始取得	全部权利	未发表	2024 年 12 月 23 日
120	无锡伟测	伟测测试机新程序自动检测校准软件[简称: 新程序自动检测校准] V1.0	2024SR1057971	原始取得	全部权利	未发表	2024 年 7 月 25 日
121	南京伟测	伟测参数级晶圆分析测报自动生成软件[简称: 参数级晶圆分析测报自动生成]V1.0	2023SR1401423	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 5 月 20 日
122	南京伟测	伟测出货自动邮件发送软件[简称: 自动邮件]V1.0	2023SR1392929	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 7 月 2 日
123	南京伟测	伟测自动特殊管控分类上传软件[简称: 自动特殊管控分类上传]V1.0	2023SR1390606	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 6 月 10 日
124	南京伟测	伟测参数级自动失效判定过程统计管控软件 V1.0	2023SR1385288	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 5 月 20 日
125	南京伟测	伟测自动下载转换客户文件生成机台可识	2023SR0576701	原始取得	全部权利	未发表	2023 年 1 月 27 日

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	开发完成日期
		别晶圆图方法软件 V1.0					
126	南京伟测	伟测自动实时检测测试机芯片图异常软件[简称：实时检测测试机芯片图异常]V1.0	2023SR0070660	原始取得	全部权利	未发表	2022 年 2 月 10 日
127	南京伟测	伟测实时自动化处理复杂流程芯片图软件[简称：复杂流程芯片图处理]V1.0	2022SR1516797	原始取得	全部权利	未发表	2022 年 6 月 20 日
128	南京伟测	伟测外观检芯片图和测试机芯片图合并软件[简称：芯片图合并软件]V1.0	2022SR1516796	原始取得	全部权利	未发表	2022 年 6 月 20 日
129	南京伟测	无损晶圆更新 MAP 系统[简称：Map 刷新]V1.0	2024SR0811061	原始取得	全部权利	未发表	2024 年 6 月 14 日
130	南京伟测	射频及 5G 芯片专用测试程序开发平台 V1.0	2026SR0373338	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 3 月 4 日
131	南京伟测	系统级 SLT 测试流程控制软件 V1.0	2026SR0373315	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 3 月 4 日
132	南京伟测	MD5 码转换系统 V1.0	2025SR0469845	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 3 月 17 日
133	南京伟测	Down map 刷新 Raw data 系统[简称：Raw data 刷新] V1.0	2025SR0349757	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 2 月 28 日
134	南京伟测	伟测测试机的 Map 角度同步软件 V1.0	2025SR0195999	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 2 月 5 日
135	南京伟测	伟测 S200 平台测试机 UI 软件 V1.0	2025SR0195986	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 2 月 5 日
136	南京伟测	伟测 CHROMA 平台测试机文件上传软件 V1.0	2025SR0195974	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 2 月 5 日
137	南京伟测	Prober 数据自动化客户分类传输软件 V1.0	2024SR2231952	原始取得	全部权利	未发表	2024 年 12 月 30 日
138	南京伟测	OCR 标签识别比对软件 V1.0	2024SR2231269	原始取得	全部权利	未发表	2024 年 12 月 30 日
139	南京伟测	伟测跨平台 AOI 智能转换系统软件[简称：VTest 生成检验单工具]V1.0	2024SR2231051	原始取得	全部权利	未发表	2024 年 12 月 30 日
140	南京伟测	质量&程序检验单生成工具软件 V1.0	2024SR2230535	原始取得	全部权利	2024 年 09 月 12 日	2024 年 12 月 30 日
141	南京	Prober 数据上传智能	2024SR2229229	原始	全部	未发表	2024 年 12

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	开发完成日期
	伟测	分类并存储软件 V1.0		取得	权利		月 30 日
142	深圳伟测	伟测文档物料智能核验系统 V1.0	2026SR0511188	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 3 月 31 日
143	深圳伟测	伟测数据同步分析系统 V1.0	2026SR0511179	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 3 月 31 日
144	深圳伟测	伟测 Wafer 报表处理软件 V1.0	2026SR0177562	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 1 月 28 日
145	深圳伟测	伟测 AOI map 数据统计分析系统 V1.0	2026SR0666877	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 6 月 16 日
146	深圳伟测	伟测智能 Final Test MES 数据检查系统 V1.0	2026SR0659662	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 6 月 12 日
147	深圳伟测	伟测半导体 Wafer 数据处理系统 V1.0	2026SR0623450	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 5 月 27 日
148	深圳伟测	伟测 FTP 文件同步更新系统 V1.0	2026SR0615693	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 5 月 22 日
149	深圳伟测	伟测 Map 多维度分析系统[简称：文件对比] V1.0	2026SR0612391	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 5 月 21 日
150	深圳伟测	伟测智能 FTP 文件同步与管理系统 V1.0	2026SR0580604	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 4 月 27 日
151	天津伟测	ATE/芯片自动测试流程管理软件 V1.0	2026SR0491075	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 3 月 26 日
152	天津伟测	测试机平台间 PIB 公板兼容转换系统 V1.0	2026SR0286562	原始取得	全部权利	未发表	2026 年 2 月 12 日
153	天津伟测	芯片量产测试 pattern 动态编写管理系统 V1.0	2025SR2463767	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 12 月 23 日
154	天津伟测	PXle 架构 IC 多站点 ATE 测试程序系统 V1.0	2025SR2463124	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 12 月 23 日
155	天津伟测	芯片静电累积实时监测预警服务软件 V1.0	2025SR2398533	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 12 月 11 日
156	天津伟测	芯片多引脚并行测试通道扩展管理系统 V1.0	2025SR2398440	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 12 月 11 日
157	天津伟测	基于 MCU 的电压、频率并行修调测试系统 V1.0	2025SR2313581	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 12 月 1 日
158	天津伟测	高速芯片多重防烧针测试管控平台 V1.0	2025SR2313324	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 12 月 1 日
159	天津伟测	多 DIE 合封 DSP 芯片单工位测试程序系统 V1.0	2025SR2065951	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 10 月 24 日
160	天津	32bit 车规 MCU8 工	2025SR2065681	原始	全部	未发表	2025 年 10

序号	著作权人	名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期	开发完成日期
	伟测	位测试程序系统 V1.0		取得	权利		月 24 日
161	天津伟测	独立控温 24 工位老化测试程序系统 V1.0	2025SR1797425	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 17 日
162	天津伟测	车载 QM 产品老化测试程序系统 V1.0	2025SR1797422	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 9 月 17 日
163	天津伟测	精准控温机台温度传感器测试记录软件 V1.0	2025SR1566240	原始取得	全部权利	未发表	2025 年 8 月 19 日

注：上述第 107 项计算机软件著作权系无锡伟测从发行人处受让取得，转让过程合法、有效。

5、域名

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其子公司拥有 1 项域名并办理了 ICP 备案手续，具体情况如下：

序号	网站名称	网站首页网址	网站域名	审核通过时间	网站备案号
1	上海伟测半导体科技股份有限公司	www.v-test.com.cn	v-test.com.cn	2023-03-30	沪 ICP 备 16034671 号-1

十一、重大资产重组

公司于 2022 年 10 月在上海证券交易所科创板上市。截至本募集说明书出具日，公司自上市以来未发生重大资产重组。

十二、发行人境外经营情况

报告期内，公司未在中华人民共和国境外从事生产经营，未在境外投资。

十三、报告期内的分红情况

（一）公司利润分配政策

根据《公司章程》，公司股利分配政策主要内容如下：

1、利润分配的原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，其中，现金股利政策目标为剩余股利，公司分配的利润应重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、公众投资者的意见。

2、利润分配方式

公司采取现金、股票、现金股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采取现金分红进行利润分配。采用股票股利进行分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

3、公司现金分红条件

（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配的利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的百分之十五。

在以下条件满足其一的情况下，公司可以不进行利润分配：

（1）当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

（2）资产负债率超过 70%；

（3）当期经营活动产生的现金流量净额为负；

（4）其他法律、法规、规范性文件及本章程允许的不符合现金分配的其他情况的。

4、公司现金分红的比例与间隔

在符合利润分配、满足现金分红的条件前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，以现金方式分配的应不低于当年实现的可分配利润的百分之十，

且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。董事会可根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

5、利润分配的决策程序

公司进行利润分配时，应当由公司董事会结合公司盈利情况、资金需求、经营发展和股东回报规划先制定分配预案，再行提交公司股东会进行审议。对于公司当年未分配利润的，董事会在分配预案中应当说明使用计划安排或者原则。公司董事会在决策和形成利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例；经与独立董事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。

董事会审议通过利润分配政策相关议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过。

有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东会批准。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

6、利润分配政策调整的机制

公司根据生产经营需要、投资计划和长期发展需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要对利润政策进行调整或者变更的，董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策的议案。调整后的利润分配政策应以保护股东权益为出发点，且不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取社会公众股东的意见（包括但不限于通过互联网投票系统、电子邮箱、电话、传真、实地接待等方式）。

7、信息披露

公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。确有必要对公司章程确定的现金分红

政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。公司应严格按照有关规定披露利润分配方案。存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）公司最近三年股利分配情况

1、股票股利

公司最近三年不存在发放股票股利的情況。

2、现金分红

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	30,319.86	12,822.88	11,799.63
现金分红金额（含税）	9,244.86	3,881.43	3,627.97
现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	30.49%	30.27%	30.75%
最近三年累计现金分红金额	16,754.26		
最近三年实现的年均可分配利润	18,314.12		
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例	91.48%		

公司最近三年现金分红情况符合法律法规和《公司章程》的相关规定。为保持公司的可持续发展，公司历年滚存的未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，继续投入公司生产经营，以支持公司长期可持续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能力。

3、资本公积转增股本

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议，于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。上述事项已于 2023 年 7 月实施完毕。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，于 2025 年 5 月

20 日召开 2024 年度股东大会，会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。上述事项已于 2025 年 6 月实施完毕。

（三）现金分红的能力及影响因素

报告期内，公司营业收入分别为 73,652.48 万元、107,686.99 万元、157,464.24 万元及 **107,185.98 万元**，归属母公司股东的净利润分别为 11,799.63 万元、12,822.88 万元、30,319.86 万元和 **15,931.11 万元**。随着公司收入规模的扩大，利润水平的不断增加，公司具有较强的现金分红能力。

公司基于实际经营情况及未来发展需要，依据《公司法》及《公司章程》，制定利润分配方案，影响公司现金分红的因素主要包括公司的收入规模、业绩情况、现金流状况、发展所处阶段、资本性支出需求、未来发展规划、银行信贷及债权融资环境等。

（四）实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性

1、现金分红符合《公司章程》的规定

公司上市后实现的可分配利润为正值，且进行现金分红的金额达到《公司章程》要求的标准；公司现金分红相关事项由董事会拟定利润分配方案，独立董事均发表了同意意见，经股东会审议通过后实施，公司现金分红决策程序合规；公司上市后，董事会在年度报告中披露了现金分红政策，符合《公司章程》的规定。

2、现金分红与资本支出需求的匹配性

公司基于日常生产经营、建设项目支出等业务的实际需求，兼顾分红政策的连续性和相对稳定性的要求，本着回报股东、促进公司稳健发展的综合考虑，实施相关现金分红计划。现金分红与公司的资本支出需求相匹配。

综上，公司实际分红情况符合《公司章程》规定，与公司的资本支出需求较匹配。

十四、最近三年公开发行公司债券以及债券本息偿付情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158号）核准，公司向不特定对象公开发行可转换公司债券 1,175 万张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额 117,500.00 万元。公司此次发行的可转债于 2025 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“伟测转债”，债券代码“118055”。

“伟测转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日（2025 年 4 月 9 日），每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎回“伟测转债”的议案》决定行使“伟测转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“伟测转债”全部赎回，“伟测转债”已于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所摘牌。

最近三年，除上述事项外，公司无发行在外的其他债券。

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为 9,067.86 万元、10,781.12 万元及 22,659.71 万元，平均三年可分配利润为 14,169.56 万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券按募集资金 200,000 万元计算，参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付 A 股可转换公司债券一年的利息。

十五、最近一期末债券持有情况及本次发行完成后累计债券余额情况

最近一期末，**公司不存在持有债券的情况**。本次发行完成后，公司的累计债券余额预计为 200,000 万元，占最近一期末净资产的 **47.30%**。

第五节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据和相关的分析说明反映了公司报告期内经审计的财务状况、经营成果和现金流量情况。以下分析所涉及的数据及口径若无特别说明，均依据的是 2023 年、2024 年和 2025 年公司报告期内经审计的财务会计资料及公司披露的未经审计的 2026 年 1-6 月财务报告，按合并报表口径披露。

公司提示投资者关注本募集说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部财务资料。

一、最近三年及一期财务报表审计情况

（一）审计意见类型

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了编号为天健审〔2024〕6-18 号、天健审〔2025〕6-480 号及天健审〔2026〕6-346 号的标准无保留意见审计报告。公司 2026 年 1-6 月合并及母公司财务报表未经审计。

（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

本节披露的与财务会计信息相关重大事项标准为当期营业收入总额的 0.5%，或金额虽未达到当期营业收入总额 0.5%但公司认为较重要的相关事项。

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	46,023.46	28,282.80	41,401.94	25,195.48
交易性金融资产	6,054.62	13,022.25	-	11,017.27
应收票据	95.17	80.29	61.66	201.28
应收账款	57,955.91	52,748.12	35,333.86	30,834.29
应收款项融资	1,829.43	2,175.42	548.35	914.96
预付款项	511.87	332.48	210.33	96.65
其他应收款	1,319.49	1,276.02	853.49	1,793.43

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
存货	3, 220. 26	1,870.68	1,049.89	469.26
其他流动资产	72, 289. 88	49,109.98	24,597.19	14,971.05
流动资产合计	189, 300. 09	148,898.05	104,056.71	85,493.67
非流动资产：				
其他非流动金融资产	8, 365. 88	8,365.88	8,500.00	8,500.00
固定资产	556, 360. 29	412,883.37	288,739.09	196,406.21
在建工程	155, 231. 97	158,511.14	66,982.48	51,413.82
使用权资产	1, 597. 04	2,276.19	3,071.31	4,179.45
无形资产	8, 269. 28	8,342.31	3,975.29	4,093.75
长期待摊费用	5, 705. 98	5,605.66	6,841.42	7,127.59
递延所得税资产	3, 449. 91	2,952.66	2,302.57	1,488.46
其他非流动资产	15, 144. 88	24,812.87	7,432.82	2,107.56
非流动资产合计	754, 125. 24	623,750.08	387,844.98	275,316.83
资产总计	943, 425. 34	772,648.13	491,901.70	360,810.50
流动负债：				
短期借款	65, 938. 22	46,229.90	17,054.92	10,330.23
应付票据	4, 640. 00	-	1,779.40	3,200.00
应付账款	68, 160. 24	61,087.06	35,170.52	19,461.76
合同负债	721. 97	1,045.85	-	-
应付职工薪酬	5, 956. 43	6,644.72	4,003.70	3,090.92
应交税费	1, 133. 24	1,371.52	1,181.13	446.44
其他应付款	8, 889. 56	749.64	470.66	936.11
一年内到期的非流动负债	38, 519. 30	31,570.53	18,940.50	14,835.30
其他流动负债	5. 24	19.83	-	-
流动负债合计	193, 964. 21	148,719.04	78,600.81	52,300.76
非流动负债：				
长期借款	312, 908. 48	197,529.05	135,621.43	47,726.36
租赁负债	1, 158. 95	1,423.82	1,961.82	3,091.90
应付债券	-	116,272.92	-	-
长期应付款	-	-	-	700.00
递延收益	12, 602. 09	11,966.33	13,810.02	11,124.72
递延所得税负债	-	-	-	-
非流动负债合计	326, 669. 52	327,192.11	151,393.27	62,642.97

项目	2026年6月30日	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
负债合计	520,633.73	475,911.16	229,994.08	114,943.73
所有者权益：				
实收资本（或股本）	16,808.84	14,905.38	11,383.48	11,337.39
其他权益工具	-	1,907.04	-	-
资本公积	318,810.12	199,438.14	196,476.16	189,676.32
盈余公积	3,767.38	3,767.38	2,811.98	2,750.13
未分配利润	83,405.28	76,719.03	51,236.00	42,102.94
归属于母公司所有者权益合计	422,791.61	296,736.97	261,907.62	245,866.77
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	422,791.61	296,736.97	261,907.62	245,866.77
负债和所有者权益总计	943,425.34	772,648.13	491,901.70	360,810.50

(二) 合并利润表

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业收入	107,185.98	157,464.24	107,686.99	73,652.48
减：营业成本	71,181.99	95,473.94	67,723.39	44,955.06
税金及附加	410.32	586.81	317.05	161.47
销售费用	2,448.98	4,236.92	3,560.32	2,401.62
管理费用	4,918.53	8,657.29	7,169.40	5,246.41
研发费用	8,998.21	17,201.10	14,237.79	10,380.63
财务费用	3,850.34	6,250.64	3,570.89	3,728.75
加：其他收益	1,518.77	5,322.46	2,368.76	1,662.52
投资收益	127.43	625.75	291.74	1,401.53
公允价值变动损益	27.44	-111.87	14.94	17.27
信用减值损失	-327.82	-1,145.25	-291.75	-467.33
资产减值损失	-	-1,205.88	-	-
资产处置收益	17.00	3,379.04	85.76	184.93
二、营业利润	16,740.45	31,921.79	13,577.61	9,577.46
加：营业外收入	13.03	3.66	53.49	16.95
减：营业外支出	10.60	70.74	12.28	21.61
三、利润总额	16,742.87	31,854.71	13,618.83	9,572.80
减：所得税费用	811.76	1,534.85	795.95	-2,226.83

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
四、净利润	15,931.11	30,319.86	12,822.88	11,799.63
归属于母公司所有者的净利润	15,931.11	30,319.86	12,822.88	11,799.63
少数股东损益	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
其中：其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	15,931.11	30,319.86	12,822.88	11,799.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,931.11	30,319.86	12,822.88	11,799.63
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
七、每股收益				
（一）基本每股收益	1.01	2.04	0.87	0.80
（二）稀释每股收益	0.93	1.96	0.87	0.80

(三) 合并现金流量表

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	108,547.64	147,329.17	110,089.18	68,874.27
收到的税费返还	113.27	-	2,966.71	4,283.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,164.14	4,396.70	6,231.17	8,560.48
经营活动现金流入小计	112,825.05	151,725.87	119,287.07	81,718.32
购买商品、接受劳务支付的现金	20,067.48	32,337.82	20,671.91	8,501.97
支付给职工以及为职工支付的现金	32,718.44	41,538.66	31,020.97	23,597.31
支付的各项税费	2,036.63	3,104.62	1,230.84	502.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,253.66	4,136.75	4,182.79	2,861.99
经营活动现金流出小计	58,076.21	81,117.86	57,106.51	35,463.38
经营活动产生的现金流量净额	54,748.83	70,608.02	62,180.56	46,254.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	35,000.00	244,785.00	119,885.09	451,807.08

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
取得投资收益收到的现金	127.73	625.75	323.96	1,401.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19.21	11,530.23	472.04	214.54
收到其他与投资活动有关的现金	241.89	1,000.46	-	518.57
投资活动现金流入小计	35,388.83	257,941.45	120,681.09	453,941.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,512.29	294,598.10	148,277.24	122,156.14
投资支付的现金	28,000.00	252,785.10	113,890.22	400,307.08
支付其他与投资活动有关的现金	85.90	899.00	655.82	-
投资活动现金流出小计	201,598.19	548,282.21	262,823.29	522,463.21
投资活动产生的现金流量净额	-166,209.36	-290,340.76	-142,142.19	-68,521.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	711.82	2,395.07	1,373.38	-
取得借款收到的现金	183,561.19	171,068.77	133,606.03	26,767.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	116,600.00	-	-
筹资活动现金流入小计	184,273.01	290,063.84	134,979.41	26,767.00
偿还债务支付的现金	40,379.73	67,425.13	32,472.52	26,110.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,587.23	9,123.02	6,973.02	10,426.80
支付其他与筹资活动有关的现金	926.91	1,633.90	4,477.97	7,491.31
筹资活动现金流出小计	54,893.87	78,182.05	43,923.51	44,029.09
筹资活动产生的现金流量净额	129,379.14	211,881.79	91,055.90	-17,262.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149.34	-150.64	-33.97	-73.93
五、现金及现金等价物净增加额	17,769.28	-8,001.59	11,060.30	-39,602.58
加：期初现金及现金等价物余额	28,254.18	36,255.78	25,195.48	64,798.05
六、期末现金及现金等价物余额	46,023.46	28,254.18	36,255.78	25,195.48

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）披露有关财务信息。

（二）合并财务报表范围

1、合并范围的确定原则

公司以控制为基础，将公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

2、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

3、发行人的合并范围

截至 2026 年 6 月末，发行人纳入合并范围的公司如下：

序号	公司名称	主要经营地	持股比例	取得方式
1	无锡伟测半导体科技有限公司	江苏无锡	100%	设立
2	南京伟测半导体科技有限公司	江苏南京	100%	设立
3	上海威矽半导体科技有限公司	上海市	100%	设立
4	深圳伟测半导体科技有限公司	深圳市	100%	设立
5	天津伟测半导体科技有限公司	天津市	100%	设立
6	成都伟测半导体科技有限公司	成都市	100%	设立

（三）合并报表范围的变化情况

1、2023 年度合并报表范围变化情况

序号	子公司名称	变动方向	变动原因
1	深圳伟测半导体科技有限公司	增加	新设

2、2024 年度合并报表范围变化情况

序号	子公司名称	变动方向	变动原因
1	天津伟测半导体科技有限公司	增加	新设

3、2025 年度合并报表范围变化情况

2025 年度，公司合并报表范围未发生变动。

4、2026 年 1-6 月合并报表范围变化情况

序号	子公司名称	变动方向	变动原因
1	成都伟测半导体科技有限公司	增加	新设

四、会计政策、会计估计及重大会计差错更正**（一）重要会计政策变更****1、2023 年度变更情况说明**

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

单位：万元

受影响的报表项目	影响金额	备注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	23.59	
递延所得税负债	-14.89	
未分配利润	38.48	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	-29.92	递延所得税费用

2、2024 年度变更情况说明

1) 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。2) 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3) 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。4) 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、2025 年度变更情况说明

2025 年度不存在会计政策变更的情况。

4、2026 年 1-6 月变更情况说明

2026 年 1-6 月不存在会计政策变更的情况。

(二) 重要会计估计变更

报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

(三) 会计差错更正

报告期内，公司无会计差错更正事项。

五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

(一) 主要财务指标

主要财务指标	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动比率（倍）	0.98	1.00	1.32	1.63
速动比率（倍）	0.96	0.99	1.31	1.63
资产负债率（母公司）	16.63%	39.08%	14.02%	12.45%
资产负债率（合并）	55.19%	61.59%	46.76%	31.86%
归属于发行人股东的每股净资产（元/每股）	25.15	19.91	23.01	21.69
应收账款周转率（次）	3.68	3.40	3.09	2.59

主要财务指标	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
存货周转率（次）	55.93	65.38	89.16	91.08
息税折旧摊销前利润（万元）	53,995.33	86,639.39	51,635.67	36,390.86
归属于发行人股东的净利润（万元）	15,931.11	30,319.86	12,822.88	11,799.63
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	14,575.19	22,659.71	10,781.12	9,067.86
研发投入占营业收入的比例	8.39%	10.92%	13.22%	14.09%
每股经营活动产生的现金流量（元/每股）	3.26	4.74	5.46	4.08
每股净现金流量（元/每股）	1.06	-0.54	0.97	-3.49

注：上述财务指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货） / 流动负债
- 3、资产负债率=总负债 / 总资产
- 4、每股净资产=归属于发行人所有者权益/期末股本总额
- 5、应收账款周转率=营业收入 / 应收账款平均余额
- 6、存货周转率=营业成本 / 存货平均余额
- 7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用（含资本化利息）+折旧+摊销
- 8、研发投入占营业收入比例=研发费用/营业收入
- 9、每股经营活动产生的现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额
- 10、每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加（减少）额 / 期末股本总额
- 11、2026年1-6月应收账款周转率及存货周转率已年化处理

（二）净资产收益率与每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下表：

项目		2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
扣除非经常损益前	基本每股收益（元/股）	1.01	2.04	0.87	0.80
	稀释每股收益（元/股）	0.93	1.96	0.87	0.80
扣除非经常损益前加权平均净资产收益率		4.41%	10.85%	5.06%	4.89%
扣除非经常损益后	基本每股收益（元/股）	0.92	1.53	0.73	0.62
	稀释每股收益（元/股）	0.85	1.48	0.73	0.62
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率		4.04%	8.11%	4.25%	3.76%

注：上述财务指标的计算公式如下：

- 1、加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

4、报告期内，因公司实施了 2024 年度权益分派，完成了资本公积转增股本，故相应调整 2023 年和 2024 年的每股收益指标。

（三）非经常性损益明细表

报告期内，公司非经常性损益如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	17.00	3,379.04	85.76	184.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,391.82	5,024.83	1,907.91	1,361.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	154.87	513.89	306.69	1,418.80
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2.43	-67.08	41.22	-4.66

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
小计	1,566.12	8,850.68	2,341.58	2,960.56
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	210.20	1,190.52	299.82	228.79
少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,355.92	7,660.16	2,041.76	2,731.77

报告期内，公司非经常性损益金额分别为 2,731.77 万元、2,041.76 万元、7,660.16 万元及 1,355.92 万元，归属于母公司股东的非经常性损益净额占当期净利润的比例分别为 23.15%、15.92%、25.26%及 8.51%。报告期内，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助和非流动资产处置损益。

六、财务状况分析

（一）资产情况

报告期各期末，公司资产构成如下：

单位：万元，%

项目	2026. 6. 30		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	189,300.09	20.07	148,898.05	19.27	104,056.71	21.15	85,493.67	23.69
非流动资产	754,125.24	79.93	623,750.08	80.73	387,844.98	78.85	275,316.83	76.31
合计	943,425.34	100	772,648.13	100	491,901.70	100	360,810.50	100

报告期各期末，公司资产总额分别为 360,810.50 万元、491,901.70 万元、772,648.13 万元及 943,425.34 万元，资产规模呈现持续增长的趋势。

报告期各期末，公司非流动资产占总资产的比例分别为 76.31%、78.85%、80.73%和 79.93%，随着公司 IPO 及可转债募投项目、自筹资金投资项目的陆续建设和投产，2025 年末公司固定资产和在建工程的金额大幅提高，公司非流动资产占总资产的比重有所增加。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金结构如下：

单位：万元，%

项目	2026. 6. 30		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	0.79	-	0.14	-	0.15	-	0.02	-
银行存款	46,022.67	100	25,186.76	89.05	32,237.56	77.86	24,188.38	96.00
其他货币资金	-	-	3,095.91	10.95	9,164.24	22.13	1,007.08	4.00
合计	46,023.46	100	28,282.80	100	41,401.94	100	25,195.48	100

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 25,195.48 万元、41,401.94 万元、28,282.80 万元和 46,023.46 万元，占流动资产的比例为 29.47%、39.79%、18.99%和 24.31%。

报告期各期末，公司货币资金主要由银行存款构成。2024 年末，公司货币资金较上年增加 64.32%，主要系公司经营规模扩大以及理财赎回所致。2025 年末，公司货币资金较上年减少 31.69%，主要系当期公司支付设备购置款及购买理财未赎回所致。2026 年 6 月末，公司货币资金较期初增加 62.73%，主要系当期客户回款增加所致。

2023 年末，其他货币资金主要为存出投资款 1,007.08 万元，使用不受限；2024 年末，其他货币资金主要为质押的票据保证金 146.17 万元及协定存款产品 5,000.00 万元，使用受限；2025 年末，其他货币资金主要为期末购买理财的在途资金 3,095.91 万元，使用不受限。

2、交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产情况如下：

单位：万元，%

项目	2026. 6. 30		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,054.62	100	13,022.25	100	-	-	11,017.27	100
其中：理财产品	6,054.62	100	13,022.25	100	-	-	8,517.27	77.31
结构性存款	-	-	-	-	-	-	2,500.00	22.69

合计	6,054.62	100	13,022.25	100	-	-	11,017.27	100
----	----------	-----	-----------	-----	---	---	-----------	-----

报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 11,017.27 万元、0.00 万元、13,022.25 万元和 6,054.62 万元，主要为结构性存款及公司购入的银行理财产品。2024 年末，公司无交易性金融资产，主要系公司期末赎回理财产品所致。

3、应收票据

报告期各期末，公司应收票据余额情况如下：

单位：万元

项目	2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
银行承兑汇票	95.17	80.29	61.66	201.28
商业承兑汇票	-	-	-	-
合计	95.17	80.29	61.66	201.28

报告期各期末，公司应收票据余额为 201.28 万元、61.66 万元、80.29 万元和 95.17 万元，占流动资产的比重分别为 0.24%、0.06%、0.05%和 0.05%，占比较小。

4、应收账款

（1）应收账款基本情况

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2026年1-6月 /2026.6.30	2025年度 /2025.12.31	2024年度 /2024.12.31	2023年度 /2023.12.31
应收账款账面余额	61,010.41	55,527.99	37,205.29	32,479.79
应收账款坏账准备	3,054.50	2,779.88	1,871.42	1,645.50
应收账款账面价值	57,955.91	52,748.12	35,333.86	30,834.29
营业收入	107,185.98	157,464.24	107,686.99	73,652.48
应收账款账面余额占营业收入比例	28.46%（年化）	35.26%	34.55%	44.10%

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 30,834.29 万元、35,333.86 万元、52,748.12 万元和 57,955.91 万元。随着经营规模的增长，公司应收账款账面余额相应增加，应收账款账面余额占当期营业收入比重分别为 44.10%、34.55%、35.26%和 28.46%（年化），整体呈下降趋势，回款效率向好，资产流

动性持续优化。

(2) 应收账款账龄明细情况

公司的技术实力、服务品质、产能规模获得了行业的高度认可，积累了广泛的客户资源。截至目前，公司客户数量 **300** 余家，客户涵盖芯片设计、制造、封装、IDM 等类型的企业，其中不乏客户 A、客户 C、紫光展锐、中兴微电子、晶晨股份、兆易创新、复旦微电、比特大陆、安路科技、客户 B、甬矽电子、卓胜微、普冉股份、中芯国际、瑞芯微、纳芯微、集创北方、翱捷科技等知名厂商。公司根据与不同客户的合作时间及客户的经营规模、资本实力等情况，对不同客户制定与业务相匹配的信用政策。目前，公司主要客户信用期为对账开票后 30 天到 90 天不等，符合行业惯例。

报告期内，公司采用按单项计提坏账准备和按组合计提坏账准备相结合的坏账准备计提方法。

公司应收账款按单项计提坏账准备的明细如下：

名称	2026. 6. 30			2025.12.31			2024.12.31			2023.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.55	9.55	100
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.55	9.55	100

公司应收账款按账龄组合计提坏账准备的明细如下：

账龄	2026. 6. 30			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
1 年以内	60,930.84	99.87	3,046.54	57,884.29
1-2 年	79.58	0.13	7.96	71.62
2-3 年	-	-	-	-
合计	61,010.41	100	3,054.50	57,955.91
账龄	2025.12.31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值

1 年以内	55,458.46	99.87	2,772.92	52,685.54
1-2 年	69.53	0.13	6.95	62.58
2-3 年	-	-	-	-
合计	55,527.99	100	2,779.88	52,748.12
账龄	2024.12.31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
1 年以内	36,982.36	99.40	1,849.12	35,133.24
1-2 年	222.85	0.60	22.29	200.57
2-3 年	0.07	0.00	0.02	0.05
合计	37,205.29	100	1,871.42	35,333.86
账龄	2023.12.31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
1 年以内	32,221.74	99.23	1,611.09	30,610.65
1-2 年	248.42	0.77	24.84	223.58
2-3 年	0.07	0.00	0.02	0.05
合计	32,470.24	100	1,635.95	30,834.29

报告期各期末，公司应收账款账龄以 1 年以内为主，占比均在 95%以上，账龄较短，应收账款安全性高，不能收回的可能性较小。

（3）应收账款坏账准备计提政策同行业对比

A、3 家台资可比公司的坏账计提政策

京元电子		矽格		欣铨	
类别	计提比例	类别	计提比例	类别	计提比例
未逾期	0%	未逾期	0.001%	未披露	未披露
逾期 1-90 天	0%	逾期 30 天内	0.001%	未披露	未披露
逾期 91-180 天	1%	逾期 31-90 天内	30%	未披露	未披露
逾期 181-365 天	2%	逾期 91-180 天内	50%	未披露	未披露
逾期 366 天以上	5%	逾期 180 天以上	50%~100%	未披露	未披露

B、发行人与内资可比公司的坏账计提政策

类别	利扬芯片	华岭股份	朗迅科技	发行人
1 年以内	3%	3%	5%	5%
1-2 年	10%	5%	10%	10%

类别	利扬芯片	华岭股份	朗迅科技	发行人
2-3 年	30%	10%	30%	30%
3-4 年	100%	50%	50%	50%
4-5 年	100%	80%	80%	80%
5 年以上	100%	100%	100%	100%

根据上述的对比，3 家台资可比公司的坏账计提政策的方法与公司不一致，不具有可比性。公司各期末的应收账款基本分布在 1 年以内和 1-2 年，公司的坏账计提比例与朗迅科技一致，与利扬芯片、华岭股份相比，公司的坏账计提比例更加谨慎、保守。

(4) 应收账款前五大情况

截至报告期末，公司应收账款前五大情况如下：

单位：万元、%

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
客户 A	9,594.93	15.73	479.75
客户 C	4,344.90	7.12	217.24
矽品科技（苏州）有限公司	3,796.72	6.22	189.84
紫光展锐（上海）科技股份有限公司	3,690.38	6.05	185.41
合肥智芯半导体有限公司	3,655.35	5.99	182.78
合计	25,082.28	41.11	1,255.01

公司应收账款前五大客户基本都是行业内的知名客户，以上市公司或者行业巨头为主，客户的资信实力较强，公司与其建立了长期稳定的合作关系，应收账款质量较好，无法收回的风险较小。

5、应收款项融资

报告期各期末，公司应收款项融资情况如下：

单位：万元

项目	2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
银行承兑汇票	1,810.73	2,134.59	415.67	914.96
迪链凭证	18.70	40.83	132.69	-
合计	1,829.43	2,175.42	548.35	914.96

报告期各期末，公司应收款项融资占流动资产的比重分别为 1.07%、0.53%、

1.46%及 0.97%，占比较低，主要为信用等级较高的银行出具的银行承兑汇票。

6、预付款项

报告期各期末，预付款项账龄情况如下：

单位：万元，%

账龄	2026.6.30		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	511.87	100	314.40	94.56	204.59	97.27	94.63	97.91
1-2 年	-	-	17.91	5.39	5.74	2.73	2.02	2.09
2 年以上	-	-	0.17	0.05	-	-	-	-
合计	511.87	100	332.48	100	210.33	100	96.65	100

报告期各期末，公司预付款项分别为 96.65 万元、210.33 万元、332.48 万元和 511.87 万元，主要为账龄在一年以内的尚未与供应商办理结算的预付采购款。

7、其他应收款

报告期内，公司其他应收款具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
押金保证金	1,127.48	927.93	708.56	1,356.48
员工购房借款	817.20	817.20	487.20	387.20
设备处置款	-	-	-	343.09
其他	7.44	110.32	0.35	1.02
账面余额	1,952.12	1,855.45	1,196.11	2,087.78
坏账准备	632.63	579.43	342.63	294.35
账面价值	1,319.49	1,276.02	853.49	1,793.43

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 1,793.43 万元、853.49 万元、1,276.02 万元和 1,319.49 万元，占流动资产的比例为 2.10%、0.82%、0.86% 和 0.70%，占比较低。报告期各期末，公司其他应收款主要由押金保证金和员工购房借款等构成。

8、存货

报告期各期末，公司存货具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
周转材料	2, 674. 50	1,870.68	1,049.89	469.26
库存商品	545. 76	-	-	-
合计	3, 220. 26	1,870.68	1,049.89	469.26

报告期各期末，公司的存货余额分别为 469.26 万元、1,049.89 万元、1,870.68 万元和 **3, 220. 26** 万元，占流动资产的比例分别为 0.55%、1.01%、1.26% 和 **1. 70%**，占比较小，主要原因系公司的主营业务为集成电路测试服务，存货主要为开展测试服务所需的周转材料。2026 年 6 月末，存货余额较期初增长 **1, 349. 58** 万元，主要系公司扩产导致周转材料备货增加，以及公司客户专用硬件增加所致。

报告期各期末，由于公司存货不存在积压、销售不畅等情况，因此不存在跌价的情形。

9、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
待抵扣增值税	65, 205. 19	48,991.48	24,418.47	14,618.34
预缴所得税	536. 63	113.27	-	352.71
理财产品	28. 30	5.23	5.13	-
预付可转债中介服务费	-	-	173.58	-
待售测试硬件	6, 519. 75	-	-	-
合计	72, 289. 88	49,109.98	24,597.19	14,971.05

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 14,971.05 万元、24,597.19 万元、49,109.98 万元和 **72, 289. 88** 万元，主要是增值税待抵扣进项税，待抵扣进项税主要系公司购买测试设备等生产设备的增值税进项税额。2025 年末，由于公司大幅采购以算力芯片测试为代表的高端测试设备，待抵扣增值税余额大幅增加。2026 年 6 月末，公司其他流动资产较期初增加 47. 20%，主要原因如下：（1）公司大幅采购高端测试设备导致期末待抵扣增值税余额增加；（2）客户项目硬件需求增长，导致公司当期待售测试硬件增加。

10、其他非流动金融资产

报告期各期末，公司其他非流动金融资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
江苏泰治股权投资	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
芯知微股权投资	500.00	500.00	500.00	500.00
上海信邀股权投资	2,865.88	2,865.88	3,000.00	3,000.00
合计	8,365.88	8,365.88	8,500.00	8,500.00

截至报告期末，公司其他非流动金融资产余额为 8,365.88 万元，主要由对江苏泰治、芯知微和上海信邀的股权投资款构成。

11、固定资产

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2026. 6. 30		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例
房屋及建筑物	55,313.21	9.94	55,960.26	13.55	26,110.81	9.04	1,719.06	0.88
办公设备	200.52	0.04	227.80	0.06	222.73	0.08	222.08	0.11
专用设备	500,700.78	90.00	356,625.63	86.37	262,287.80	90.84	194,454.91	99.01
运输工具	145.78	0.03	69.69	0.02	117.74	0.04	10.16	0.01
合计	556,360.29	100	412,883.37	100	288,739.09	100	196,406.21	100

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 196,406.21 万元、288,739.09 万元、412,883.37 万元和 556,360.29 万元，占非流动资产的比例分别为 71.34%、74.45%、66.19%和 73.78%。报告期内公司固定资产主要为公司生产经营所必须的资产，包括各类测试机、探针台和分选机等设备，固定资产规模随公司 IPO 及可转债募投项目、自筹资金投资项目的逐步落地、产能整体呈上升趋势。

报告期各期末，公司固定资产原值、累计折旧和账面价值情况如下表所示：

单位：万元

2026. 6. 30				
类别	期末原值	累计折旧	减值准备	账面价值

房屋及建筑物	59,835.17	4,521.97	-	55,313.21
办公设备	491.04	290.52	-	200.52
专用设备	648,713.64	148,012.86	-	500,700.78
运输工具	246.25	100.47	-	145.78
合计	709,286.11	152,925.82	-	556,360.29
2025.12.31				
类别	期末原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	58,737.91	2,777.65	-	55,960.26
办公设备	482.54	254.75	-	227.80
专用设备	475,126.11	118,500.48	-	356,625.63
运输工具	144.16	74.47	-	69.69
合计	534,490.72	121,607.35	-	412,883.37
2024.12.31				
类别	期末原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	27,112.35	1,001.54	-	26,110.81
办公设备	472.53	249.80	-	222.73
专用设备	340,948.46	78,660.66	-	262,287.80
运输工具	144.16	26.42	-	117.74
合计	368,677.50	79,938.41	-	288,739.09
2023.12.31				
类别	期末原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	1,949.92	230.86	-	1,719.06
办公设备	404.80	182.72	-	222.08
专用设备	242,358.77	47,903.86	-	194,454.91
运输工具	10.76	0.60	-	10.16
合计	244,724.24	48,318.03	-	196,406.21

12、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产的构成情况如下：

单位：万元

2026. 6. 30				
类别	期末原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	6,819.84	5,222.80	-	1,597.04
合计	6,819.84	5,222.80	-	1,597.04

2025.12.31				
类别	期末原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	6,819.84	4,543.65	-	2,276.19
合计	6,819.84	4,543.65	-	2,276.19
2024.12.31				
类别	期末原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	6,751.79	3,680.48	-	3,071.31
合计	6,751.79	3,680.48	-	3,071.31
2023.12.31				
类别	期末原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	6,761.22	2,581.77	-	4,179.45
合计	6,761.22	2,581.77	-	4,179.45

报告期各期末，公司使用权资产的账面价值为 4,179.45 万元、3,071.31 万元、2,276.19 万元和 **1,597.04** 万元，均为厂房租赁。

13、在建工程

报告期各期末，公司在建工程的构成情况如下：

单位：万元

项目	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
测试设备	134,940.81	150,084.54	55,719.28	31,743.58
厂务工程	19,192.94	7,399.67	10,945.89	19,219.35
其他	1,098.22	1,026.93	317.31	450.89
合计	155,231.97	158,511.14	66,982.48	51,413.82

报告期各期末，公司在建工程分别为 51,413.82 万元、66,982.48 万元、158,511.14 万元和 **155,231.97** 万元，占非流动资产的比例分别为 18.67%、17.27%、25.41%和 **20.58%**。报告期各期末，公司的在建工程主要由测试设备及厂务工程构成。其中，测试设备主要是公司已收到但未达到预定可使用状态的设备；厂务工程主要是厂房配套设施。

2024 年末，在建工程较期初增加 30.28%，主要原因系当期新建无锡和南京厂房及测试设备未转固所致。2025 年末，在建工程较期初增加 136.65%，主要系当期新建总部大楼和测试设备未转固所致。2026 年 6 月末，在建工程较期初下降 **2.07%**，主要系部分测试设备转固所致。

14、无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
土地使用权	7,812.01	7,986.45	3,654.96	3,756.43
软件使用权	457.28	355.86	320.33	337.32
合计	8,269.28	8,342.31	3,975.29	4,093.75

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 4,093.75 万元、3,975.29 万元、8,342.31 万元和 8,269.28 万元，占各期末非流动资产比例分别为 1.49%、1.02%、1.34%和 1.10%。报告期各期末，公司无形资产主要由土地使用权和软件使用权构成，公司无形资产使用情况良好，不存在减值情况。公司不存在开发支出资本化形成的无形资产。

报告期各期末，公司土地使用权主要为无锡伟测和南京伟测为新建厂房所购置的土地以及为建设上海总部大楼所购置的土地。2025 年末，公司土地使用权增加 4,331.49 万元，主要系当期购买上海总部大楼土地使用权所致。

报告期各期末，公司软件使用权主要为 M7000 测试系统软件、进销存管理系统软件、AMC Mapping 分析软件等生产、研发和办公支持软件。

15、长期待摊费用

报告期内，公司长期待摊费用情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2026. 6. 30		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
厂房配套工程	5,213.81	91.37	5,102.83	91.03	6,293.82	92.00	6,631.39	93.04
消防工程	108.64	1.90	234.04	4.18	263.85	3.86	303.42	4.26
电力设施费用	383.53	6.72	258.17	4.61	241.33	3.53	118.53	1.66
专利使用费	-	-	10.61	0.19	42.43	0.62	74.25	1.04
合计	5,705.98	100	5,605.66	100	6,841.42	100	7,127.59	100

报告期各期末，公司长期待摊费用的余额为 7,127.59 万元、6,841.42 万元、5,605.66 万元和 5,705.98 万元，占非流动资产的比例分别为 2.59%、1.76%、

0.90%和 0.76%。报告期各期末，公司长期待摊费用主要由厂房配套工程构成，包括上海及无锡厂房的总装工程、办公室装修、电力工程及后续升级改造等。报告期各期末，公司长期待摊费用**总体呈下降趋势**，主要系前期相关资产陆续摊销完毕所致。

16、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产构成情况如下表所述：

单位：万元

项目	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
预付设备工程款	14, 515. 83	24,223.64	7,249.39	1,889.10
预付软件购置款	629. 05	589.22	183.42	218.46
合计	15, 144. 88	24,812.87	7,432.82	2,107.56

报告期各期末，公司其他非流动资产的余额分别为 2,107.56 万元、7,432.82 万元、24,812.87 万元和 **15, 144. 88** 万元，主要由预付设备工程款构成。报告期各期末，公司其他非流动资产整体呈显著增长态势，主要系公司持续加大产能建设投入，测试设备采购规模逐年扩大所致。

（二）负债情况

报告期各期末，公司负债具体构成如下：

单位：万元，%

项目	2026. 6. 30		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	193, 964. 21	37. 26	148,719.04	31.25	78,600.81	34.18	52,300.76	45.50
非流动负债	326, 669. 52	62. 74	327,192.11	68.75	151,393.27	65.82	62,642.97	54.50
合计	520, 633. 73	100. 00	475,911.16	100	229,994.08	100	114,943.73	100

1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款具体构成如下：

单位：万元，%

项目	2026. 6. 30		2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

信用借款	65,914.00	99.96	46,220.00	99.98	17,050.00	99.97	8,950.00	86.64
保证借款	-	-	-	-	-	-	1,372.00	13.28
借款利息	24.22	0.04	9.90	0.02	4.92	0.03	8.23	0.08
合计	65,938.22	100	46,229.90	100	17,054.92	100	10,330.23	100

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 10,330.23 万元、17,054.92 万元、46,229.90 万元和 65,938.22 万元。报告期内，公司积极扩张集成电路测试产能，银行借款是公司重要的融资方式之一，公司资信情况良好，与多家商业银行保持良好的长期合作关系。

2、应付票据

报告期各期末，公司应付票据具体构成如下：

单位：万元

项目	2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
银行承兑汇票	4,640.00	-	1,779.40	1,200.00
信用证	-	-	-	2,000.00
合计	4,640.00	-	1,779.40	3,200.00

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 3,200 万元、1,779.40 万元、0.00 万元和 4,640.00 万元，主要为银行承兑汇票。2026 年 6 月末，应付票据余额较期初增加 4,640.00 万元，主要系公司业务规模增长，考虑运营资金管理等因素，采用银行承兑汇票结算所致。

3、应付账款

报告期各期末，公司应付账款具体构成如下：

单位：万元

项目	2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
设备采购款	53,716.72	52,059.68	27,238.76	11,756.18
材料采购款	9,184.77	6,657.63	3,570.12	2,026.12
安装工程款	4,799.44	1,908.11	4,186.15	5,342.56
设备租赁款	317.03	384.98	120.05	106.42
其他	142.29	76.67	55.44	230.47
合计	68,160.24	61,087.06	35,170.52	19,461.76

报告期各期末，公司应付账款期末余额为 19,461.76 万元、35,170.52 万元、61,087.06 万元和 **68,160.24** 万元，主要为购置生产设备的应付设备采购款、安装工程款及应付供应商的材料款。报告期各期末，公司应付账款的规模呈扩张趋势，主要因公司持续购买设备扩大产能和南京、无锡测试基地厂房建设陆续投入所致。

4、应付职工薪酬

报告期各期，应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
短期薪酬	5,830.97	6,523.17	3,891.02	2,982.54
离职后福利-设定提存计划	125.46	121.55	112.68	108.38
合计	5,956.43	6,644.72	4,003.70	3,090.92

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 3,090.92 万元、4,003.70 万元、6,644.72 万元和 **5,956.43** 万元，主要包括员工工资、奖金、社会保险费、住房公积金、津贴和补贴等。报告期各期末，公司应付职工薪酬**总体呈现持续增长**，主要系员工人数随着业务规模扩大不断增加所致。

5、应交税费

报告期各期末，公司应交税费明细情况如下：

单位：万元

项目	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
企业所得税	766.83	1,014.87	989.49	354.28
房产税	132.19	132.19	60.30	5.49
代扣代缴个人所得税	166.34	130.04	79.48	51.32
印花税	56.65	83.18	40.32	26.32
城镇土地使用税	11.23	11.23	8.35	9.03
环境保护税	-	-	3.18	-
合计	1,133.24	1,371.52	1,181.13	446.44

报告期各期末，公司应交税费分别为 446.44 万元、1,181.13 万元、1,371.52 万元和 **1,133.24** 万元，主要由应交企业所得税构成。2024 年末和 2025 年末，公司应交税费大幅上涨，主要系无锡伟测和南京伟测进入集成电路企业所得税

“两免三减半”对应的减半征收期，计提的企业所得税增加所致。

报告期内，由于公司采购设备的增值税进项金额一直大于开展测试业务的增值税销项金额，因此报告期内未缴纳增值税。

6、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款的主要构成如下：

单位：万元

项目	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
费用款	1,041.88	593.99	390.44	226.11
重点人才专项奖励	-	60.00	61.04	-
押金保证金	285.24	95.64	19.18	710.00
代付测试硬件应付款	7,562.43	-	-	-
合计	8,889.56	749.64	470.66	936.11

报告期各期末，公司其他应付款分别为 936.11 万元、470.66 万元、749.64 万元和 8,889.56 万元。报告期各期末，公司其他应付款主要由押金保证金和应付员工报销款等构成。2026 年 6 月末，公司其他应付款较期初增加 8,139.92 万元，主要系公司测试硬件应付款增加所致。

7、一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债明细情况如下：

单位：万元

项目	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
一年内到期的长期借款	37,913.73	30,413.38	17,619.70	10,890.19
一年内到期的租赁负债	605.58	1,157.14	1,320.80	1,145.12
一年内到期的长期应付款	-	-	-	2,800.00
合计	38,519.30	31,570.53	18,940.50	14,835.30

报告期各期末，公司的一年内到期的非流动负债分别为 14,835.30 万元、18,940.50 万元、31,570.53 万元和 38,519.30 万元，占流动负债的比例分别为 28.37%、24.10%、21.23%和 19.86%。公司一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款。

8、长期借款

报告期内，公司长期借款的构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
保证及抵押借款	124,414.70	113,275.52	126,726.05	42,644.25
信用借款	1,980.00	1,990.00	4,940.00	-
保证借款	186,264.21	82,090.85	3,822.75	5,034.87
借款利息	249.57	172.69	132.63	47.24
合计	312,908.48	197,529.05	135,621.43	47,726.36

报告期各期末，公司长期借款分别为 47,726.36 万元、135,621.43 万元、197,529.05 万元和 312,908.48 万元，主要为保证及抵押借款。报告期各期末，公司增加的长期借款主要用于前次可转债募投项目、上海总部大楼建设和购买测试设备。

9、租赁负债

单位：万元

项目	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
尚未支付的租赁付款额	1,238.73	1,530.99	2,109.52	3,336.82
减：未确认融资费用	79.78	107.17	147.70	244.92
合计	1,158.95	1,423.82	1,961.82	3,091.90

报告期各期末，公司租赁负债分别为 3,091.90 万元、1,961.82 万元、1,423.82 万元和 1,158.95 万元，主要为厂房租赁。

10、长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款期末余额分别为 700.00 万元、0.00 万元、0.00 万元和 0.00 万元。2023 年末，公司长期应付款主要系售后租回形成的长期应付款。

11、递延收益

报告期内，公司递延收益明细如下所示：

单位：万元

项目	2026. 6. 30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
----	-------------	------------	------------	------------

政府补助	12,602.09	11,966.33	13,810.02	11,124.72
合计	12,602.09	11,966.33	13,810.02	11,124.72

报告期内，公司递延收益分别为 11,124.72 万元、13,810.02 万元、11,966.33 万元和 12,602.09 万元，主要为收到与资产相关的政府补助。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2026.6.30/ 2026年1-6月	2025.12.31/ 2025年度	2024.12.31/ 2024年度	2023.12.31/ 2023年度
流动比率（倍）	0.98	1.00	1.32	1.63
速动比率（倍）	0.96	0.99	1.31	1.63
资产负债率（合并）	55.19%	61.59%	46.76%	31.86%
息税折旧摊销前利润 （万元）	53,995.33	86,639.39	51,635.67	36,390.86
利息保障倍数（倍）	4.82	5.96	4.60	3.89

1、短期偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.63 倍、1.32 倍、1.00 倍和 0.98 倍，速动比率分别为 1.63 倍、1.31 倍、0.99 倍和 0.96 倍。

报告期各期末，公司流动比率、速动比率和可比公司对比如下：

公司名称	流动比率（倍）			
	2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
利扬芯片	1.02	1.15	1.71	0.87
华岭股份	3.77	3.21	5.10	2.25
朗迅科技	未披露	1.22	0.92	0.87
京元电子	1.47	1.82	2.60	2.84
矽格	1.83	2.14	2.63	2.10
欣铨	0.88	1.28	1.60	1.74
平均值	1.79	1.80	2.43	1.78
本公司	0.98	1.00	1.32	1.63
公司名称	速动比率（倍）			
	2026.6.30	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
利扬芯片	0.99	1.12	1.65	0.82

华岭股份	3.60	3.10	4.98	2.20
朗迅科技	未披露	1.19	0.90	0.85
京元电子	1.35	1.74	2.55	2.71
矽格	1.76	2.08	2.58	2.05
欣铨	未披露	未披露	未披露	未披露
平均值	1.92	1.85	2.53	1.73
本公司	0.96	0.99	1.31	1.63

注：1、可比上市公司指标是根据其公开披露的定期报告数据计算，计算公式为：流动比率=流动资产/流动负债；速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

2、欣铨未披露存货相关信息。

报告期内，公司流动比率和速动比率均低于可比公司平均水平，主要是由于公司业务发展快，报告期内使用较多银行借款的方式来满足资金需求，且期末应付设备采购款金额较大，进而导致短期借款、应付账款及一年内到期的非流动负债等流动负债金额较大，流动比率和速动比率较低。

2、长期偿债能力分析

报告期各期末，公司资产负债率分别为 31.86%、46.76%、61.59% 和 55.19%。2023 年至 2025 年，公司的资产负债率整体呈现逐年上涨的变动趋势。主要原因系报告期内公司紧抓行业发展机遇，持续推进半导体测试产能扩建、高端测试设备购置及厂房建设等大额资本开支项目，仅依靠自身经营积累的内源资金无法覆盖大规模扩产需求，因此公司持续加大外部融资力度，逐年新增银行长短期借款、发行可转债等债务融资，使得公司负债总额规模快速增长，在资产规模同步扩张的背景下，负债增幅显著高于总资产增幅。2026 年 6 月末，随着公司发行的可转债实现转股，公司资产负债率回落到 55.19%，资产负债结构较为合理。

公司偿债能力指标随业务发展而变化，总体处于合理水平，债务风险较低。

公司最近三年一期未发生无法偿还到期债务的情况。截至报告期末，公司不存在对生产经营活动有重大影响的或有负债。

（四）资产周转能力分析

1、公司资产周转能力指标

报告期各期，公司资产周转能力相关财务指标如下表所示：

财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
总资产周转率（次）	0.25	0.25	0.25	0.21
应收账款周转率（次）	3.68	3.40	3.09	2.59
存货周转率（次）	55.93	65.38	89.16	91.08

注：1、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额；

2、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

3、存货周转率=营业成本/存货平均余额；

4、上表 2026 年 1-6 月数据已进行年化处理。

2、资产周转能力与可比公司的对比

报告期各期，公司与可比公司总资产周转率、应收账款周转率和存货周转率的比较情况如下：

（1）总资产周转率

公司名称	总资产周转率（次）			
	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利扬芯片	0.27	0.24	0.21	0.27
华岭股份	0.25	0.24	0.21	0.26
朗迅科技	未披露	0.29	0.25	0.21
京元电子	0.19	0.37	0.33	0.32
矽格	0.25	0.47	0.47	0.41
欣铨	0.24	0.41	0.39	0.44
平均值	0.24	0.34	0.31	0.32
本公司	0.25	0.25	0.25	0.21

注：可比上市公司指标是根据其公开披露的定期报告数据计算，计算公式为：总资产周转率=营业收入/总资产平均余额，2026 年 1-6 月财务指标已经年化处理。

从上表可见，发行人总资产周转率**总体**低于同行业可比公司平均水平。与台资企业相比，报告期内公司总资产周转率较低，主要是由于报告期内公司为满足产能需求，不断扩大生产设备规模，但是收入增长尚处于爬坡期，导致总资产周转率较低。3 家台资可比公司的经营时间较长、收入规模及资产规模相对稳定，因此总资产周转率相对较高。

报告期内，公司总资产周转率与内资可比公司相比较为一致。

（2）应收账款周转率

公司名称	应收账款周转率（次）			
	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利扬芯片	3.19	3.33	3.03	3.17
华岭股份	3.16	3.36	3.35	4.47
朗迅科技	未披露	3.06	2.89	2.87
京元电子	3.41	5.27	3.97	3.28
矽格	2.33	4.22	4.42	4.08
欣铨	2.47	4.62	4.52	4.61
平均值	2.91	3.98	3.70	3.75
本公司	3.68	3.40	3.09	2.59

注：可比上市公司指标是根据其公开披露的定期报告数据计算，计算公式为：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额，2026 年 1-6 月财务指标已经年化处理。

2023 年度至 2025 年度，公司的应收账款周转率低于同行业可比公司平均水平，主要系公司在报告期内营业收入保持了高于可比公司的高速增长态势，导致各年度的第四季度的收入占全年比重较高，而第四季度的收入的应收账款在资产负债表日还处于信用期，从而导致用于计算应收账款周转率的应收账款期末余额指标偏高，拉低了应收账款周转率。2026 年 1-6 月，公司应收账款周转率高于同行业可比公司，主要系三家台资企业 2026 年 1-6 月营收规模扩大，导致期末应收账款余额大幅提升，进而导致其上半年度应收账款周转率相对较低；剔除台资企业影响后，公司应收账款周转率总体与内资可比公司相近。

公司目前处于业务大规模扩张阶段，将持续开展应收账款管理和催收工作，加强应收账款管理。

（3）存货周转率

公司名称	存货周转率（次）			
	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利扬芯片	29.08	20.66	16.51	15.29
华岭股份	20.69	26.51	24.73	26.58
朗迅科技	未披露	19.77	17.57	10.31
京元电子	7.21	22.34	18.23	13.16

公司名称	存货周转率（次）			
	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
矽格	11.58	27.64	32.01	30.60
欣铨	未披露	未披露	未披露	未披露
平均值	17.14	23.38	21.81	19.19
本公司	55.93	65.38	89.16	91.08

注：1、可比上市公司指标是根据其公开披露的定期报告数据计算，计算公式为：存货周转率=营业成本/存货平均余额，2026 年 1-6 月财务指标已经年化处理；

2、欣铨未披露存货相关信息。

报告期内，公司存货周转率与可比公司相比处于较高水平。与利扬芯片和朗迅科技相比，公司存货周转率较高，主要是由于根据利扬芯片和朗迅科技的收入确认原则，其已测试完成尚未验收部分需要纳入存货科目核算，利扬芯片的存货由未交付劳务、周转材料、库存商品和原材料构成，朗迅科技的存货由合同履约成本、原材料、发出商品、库存商品和在产品构成，而本公司的存货主要为周转材料，因此存货周转率较高。与华岭股份相比，公司存货周转率较高，主要原因是华岭股份自 2023 年起将归类为流动资产的合同履约成本列示于存货，导致其存货周转率大幅度下降。

（五）财务性投资情况

截至报告期末，公司其他非流动金融资产余额为 8,365.88 万元，主要由对江苏泰治、芯知微和上海信邀的股权投资款构成。其中，公司投资江苏泰治科技股份有限公司 5,000.00 万元，为对产业链上游供应商的投资，不属于财务性投资；公司投资蚌埠芯知微电子科技有限公司 500.00 万元，为对产业链下游客户的投资，不属于财务性投资；公司投资上海信邀创业投资中心（有限合伙）2,865.88 万元，属于财务性投资，占期末合并报表归属于母公司净资产 422,791.61 万元的比例为 0.68%，比例较低。

除上述财务性投资之外，公司最近一期末不存在其他财务性投资的情形。公司符合《注册管理办法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的规定。

七、经营成果分析

报告期各期，公司经营成果概况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	107,185.98	157,464.24	107,686.99	73,652.48
营业成本	71,181.99	95,473.94	67,723.39	44,955.06
营业利润	16,740.45	31,921.79	13,577.61	9,577.46
利润总额	16,742.87	31,854.71	13,618.83	9,572.80
净利润	15,931.11	30,319.86	12,822.88	11,799.63
归属于母公司股东的净利润	15,931.11	30,319.86	12,822.88	11,799.63

报告期各期，公司的净利润分别为 11,799.63 万元、12,822.88 万元、30,319.86 万元及 **15,931.11** 万元，发行人投资收益及非经常性损益对公司经营成果无重大影响，不存在累计未弥补亏损情况。

2024 年，公司所处半导体行业处于上游库存逐步去化和下游需求逐步复苏阶段。大量国产高端芯片和车规级芯片进入量产阶段，市场对高端芯片和高可靠性芯片测试需求明显增加，受益于行业复苏、新客户导入、高强度研发投入、测试产品结构优化、产能利用率不断提高等原因，2024 年全年实现营收 107,686.99 万元，较上年同期增长 46.21%。

2025 年，受益于 AI、智驾等新兴领域的快速发展，半导体行业增长强劲。公司受益于高端测试需求爆发，产品结构优化、产能利用率快速爬升、国产替代加速推进等因素，2025 年公司实现营业收入 157,464.24 万元，较上年同期增长 46.22%。

2026 年 1-6 月，公司实现营业收入 **107,185.98** 万元，同比保持较快增长，整体经营保持稳健增长态势。2026 年上半年公司营业收入的高速增长主要源于 AI 推理需求爆发、智能驾驶渗透、大容量存储需求扩张推动公司高端测试需求增长和产能提升；同时，新客户产品量产带动公司测试规模进一步扩大。

（一）营业收入分析

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务	101,328.44	94.54	149,456.19	94.91	98,145.90	91.14	68,692.59	93.27

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
收入								
其他业务收入	5,857.54	5.46	8,008.05	5.09	9,541.08	8.86	4,959.89	6.73
合计	107,185.98	100	157,464.24	100	107,686.99	100	73,652.48	100

2023 年-2026 年 1-6 月，公司营业收入分别为 73,652.48 万元、107,686.99 万元、157,464.24 万元及 **107,185.98** 万元，分别同比增长 0.48%、46.21%、46.22%及 **69.00%**。

报告期内，公司营业收入的具体情况如下：

1、按产品类别分析

公司的主营业务收入包含晶圆测试服务收入和芯片成品测试服务收入。报告期内，各业务类型收入的具体情况如下：

单位：万元，%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
晶圆测试	49,516.02	48.87	86,128.42	57.63	61,467.28	62.63	44,250.82	64.42
芯片成品测试	51,812.42	51.13	63,327.77	42.37	36,678.62	37.37	24,441.77	35.58
主营业务收入	101,328.44	100	149,456.19	100	98,145.90	100	68,692.59	100

报告期各期，公司晶圆测试收入金额分别为 44,250.82 万元、61,467.28 万元、86,128.42 万元和 **49,516.02** 万元，占主营业务收入的比重分别为 64.42%、62.63%、57.63%和 **48.87%**；公司芯片成品测试收入金额分别为 24,441.77 万元、36,678.62 万元、63,327.77 万元和 **51,812.42** 万元，占主营业务收入的比重分别为 35.58%、37.37%、42.37%和 **51.13%**。

2、按区域结构分析

报告期内，公司主营业务收入的客户所在区域分布情况如下：

单位：万元，%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
华东	45,203.44	44.61	70,625.91	47.26	50,160.85	51.11	44,880.46	65.34
华南	36,649.25	36.17	54,409.30	36.40	35,258.78	35.92	13,451.11	19.58
华北	13,711.88	13.53	14,997.70	10.03	6,350.98	6.47	4,800.74	6.99
西南	3,038.88	3.00	6,050.39	4.05	3,385.61	3.45	2,083.05	3.03
境外	2,725.00	2.69	3,372.89	2.26	2,989.68	3.05	3,477.23	5.06
合计	101,328.44	100	149,456.19	100	98,145.90	100	68,692.59	100

报告期内，公司主营业务收入主要来自华东和华南地区，来自华东和华南地区客户的收入占当期主营业务收入的比重分别为 84.92%、87.03%、83.66%和 **80.78%**。以上海为代表的长三角地区、以北京为代表的环渤海区域和以深圳为代表的珠三角区域是中国集成电路产业的三大主要区域，公司营业收入的区域分布与产业集群的分布相匹配。

3、按季度构成分析

报告期内，公司主营业务收入按照季度构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	45,830.24	45.23	27,520.74	18.41	17,338.66	17.67	13,494.54	19.64
第二季度	55,498.20	54.77	33,045.50	22.11	21,014.61	21.41	15,995.92	23.29
第三季度			42,354.51	28.34	27,932.31	28.46	18,862.71	27.46
第四季度			46,535.44	31.14	31,860.31	32.46	20,339.42	29.61
合计	101,328.44	100	149,456.19	100	98,145.90	100	68,692.59	100

报告期内公司主营业务收入呈现显著的逐季递增的态势，2023-2025 年各年度均保持第一季度收入占比最低、第四季度收入占比最高的规律，季度收入规模从第一季度至第四季度持续抬升，收入结构保持稳定，下半年收入贡献显著高于上半年，整体分布符合半导体测试行业的季节性特征。

4、其他业务收入构成

报告期内，公司其他业务收入构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
硬件销售	3,995.26	68.21	4,886.23	61.02	6,735.19	70.59	2,745.30	55.35
设备租金及其他	1,862.28	31.79	3,121.83	38.98	2,805.90	29.41	2,214.59	44.65
合计	5,857.54	100	8,008.05	100	9,541.08	100	4,959.89	100

公司其他业务收入主要为硬件销售（探针卡、KIT、Socket 等）收入和设备租赁收入。报告期内，公司其他业务收入分别为 4,959.89 万元、9,541.08 万元、8,008.05 万元和 **5,857.54** 万元，占营业收入比重分别为 6.73%、8.86%、5.09%和 **5.46%**，其他业务收入占比较小。

（二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本具体构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	68,017.78	95.55	91,146.66	95.47	61,356.84	90.60	42,366.60	94.24
其他业务成本	3,164.20	4.45	4,327.28	4.53	6,366.54	9.40	2,588.46	5.76
合计	71,181.99	100	95,473.94	100	67,723.39	100	44,955.06	100

报告期各期，公司主营业务成本占营业成本的比重分别为 94.24%、90.60%、95.47%及 **95.55%**，与主营业务收入占比相匹配。其他业务成本主要是公司硬件销售和设备租赁的成本。

1、按产品构成分析

报告期内，公司主营业务成本中各类测试服务具体构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
晶圆测试	29,529.18	43.41	46,526.33	51.05	35,372.47	57.65	25,291.65	59.70

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
芯片成品测试	38,488.60	56.59	44,620.33	48.95	25,984.37	42.35	17,074.95	40.30
主营业务成本	68,017.78	100	91,146.66	100	61,356.84	100	42,366.60	100

报告期内，公司主营业务成本与主营业务收入结构基本一致，由晶圆测试成本和芯片成品测试成本构成。

2、按要素构成分析

报告期内，公司主营业务成本具体构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
设备折旧及租赁费用	29,628.98	43.56	42,081.66	46.17	28,936.41	47.16	19,488.79	46.00
人工成本	20,996.79	30.87	26,980.14	29.60	18,438.28	30.05	13,476.59	31.81
制造费用	11,163.03	16.41	12,042.24	13.21	7,927.68	12.92	5,196.22	12.26
能源费用	6,228.99	9.16	10,042.62	11.02	6,054.47	9.87	4,205.01	9.93
主营业务成本	68,017.78	100	91,146.66	100	61,356.84	100	42,366.60	100

公司主营业务为晶圆测试和芯片成品测试服务，主要生产要素是测试机、探针台、分选机等设备，主营业务成本主要由设备折旧和租赁费用、人工成本、能源费用和制造费用构成。制造费用主要是厂房租金及折旧、机物料成本、厂务费用等。从成本要素构成来看，公司主营业务成本结构保持高度稳定，主要成本为设备折旧及租赁费用及人工成本，两项合计占主营业务成本的比例持续保持在 74%以上，与半导体测试行业重资产、技术密集型的行业特征相契合。

报告期内，制造费用占当期主营业务成本的比重分别为 12.26%、12.92%、13.21%和 16.41%。2026 年上半年，公司设备折旧及租赁费用占比有所下降，而制造费用占比有所上升，主要系报告期内公司业务增长较快，部分自有设备产能阶段性紧张，公司相应增加部分外部协作服务采购，外协服务支出增加推高制造费用占比；设备折旧及租赁费用绝对金额未发生下降，受主营业务成本结构变动影响，其成本占比被动稀释。

报告期内，能源费用占当期主营业务成本的比重分别为 9.93%、9.87%、

11.02%和 **9.16%**，2025 年占比上升明显，主要是因为公司自 2025 年开始，FT 测试收入占比提升明显。FT 测试本身耗能高于 CP 测试，叠加高端 FT 测试一般需要配套老化测试，老化炉耗能较高，导致公司 2025 年能源费用占主营业务成本比重上升显著。2026 年一季度受春节因素影响，系业务淡季，**叠加 2026 年上半年公司大规模扩产，主营业务成本规模增长显著，导致公司 2026 年上半年能源费用占比有所回落。**

（三）毛利及毛利率变动分析

1、毛利分析

（1）综合毛利分析

报告期内，公司毛利的具体情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	33,310.66	92.52	58,309.53	94.06	36,789.06	92.06	26,325.99	91.74
其他业务毛利	2,693.34	7.48	3,680.77	5.94	3,174.54	7.94	2,371.43	8.26
合计	36,003.99	100	61,990.30	100	39,963.60	100	28,697.42	100

报告期内，公司毛利总额分别为 28,697.42 万元、39,963.60 万元、61,990.30 万元及 **36,003.99** 万元，总体呈逐年上涨趋势，公司毛利总额变化趋势与营业收入的变化趋势基本保持一致。公司主营业务毛利占毛利总额的比例分别为 91.74%、92.06%、94.06%及 **92.52%**，是公司毛利的主要来源。

（2）主营业务毛利分析

报告期内，公司主营业务毛利的具体情况如下表所示：

单位：万元，%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
晶圆测试	19,986.84	60.00	39,602.09	67.92	26,094.81	70.93	18,959.17	72.02
芯片成品测试	13,323.82	40.00	18,707.44	32.08	10,694.25	29.07	7,366.82	27.98
主营业务毛利	33,310.66	100	58,309.53	100	36,789.06	100	26,325.99	100

公司主营业务毛利主要来源于晶圆测试和芯片成品测试服务，其中晶圆测试毛利占主营业务毛利的比重分别为 72.02%、70.93%、67.92%和 **60.00%**，晶圆测试服务对公司毛利贡献较大。

2、毛利率分析

（1）综合毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率情况如下：

财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
主营业务毛利率	32.87%	39.01%	37.48%	38.32%
其他业务毛利率	45.98%	45.96%	33.27%	47.81%
综合毛利率	33.59%	39.37%	37.11%	38.96%

从综合毛利率来看，公司综合毛利率走势与核心主营业务毛利率高度契合，2023 年度、2024 年度、2025 年度分别为 38.96%、37.11%、39.37%，始终维持在 37%以上的较高水平，2025 年度综合毛利率较 2024 年度提升 2.26 个百分点，整体盈利能力持续增强。**2026 年 1-6 月**，公司综合毛利率为 **33.59%**，受上半年主营业务毛利率波动影响有所回落，但仍保持在 **33%**以上的合理区间，公司整体盈利基础依然稳固。

（2）主营业务毛利率变动分析

报告期内，公司主营业务的毛利率情况如下：

财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
晶圆测试	40.36%	45.98%	42.45%	42.84%
芯片成品测试	25.72%	29.54%	29.16%	30.14%
主营业务毛利率	32.87%	39.01%	37.48%	38.32%

报告期内，公司的主营业务毛利率分别为 38.32%、37.48%、39.01%和 **32.87%**。

3、公司毛利率与同行业可比公司比较分析

根据公开披露的信息，报告期各期，公司毛利率与同行业可比公司的对比情况如下：

公司简称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利扬芯片	28.45%	27.86%	20.90%	30.33%
华岭股份	14.08%	16.19%	22.01%	51.12%
朗迅科技	未披露	45.64%	37.47%	41.89%
3 家内资可比公司平均值	21.27%	29.90%	26.79%	41.11%
京元电子	39.61%	35.85%	34.79%	33.74%
矽格	31.44%	29.22%	26.11%	23.12%
欣铨	39.32%	36.29%	28.05%	34.68%
3 家台资可比公司平均值	36.79%	33.79%	29.65%	30.51%
本公司	33.59%	39.37%	37.11%	38.96%

注：可比上市公司指标是根据其公开披露的定期报告数据计算,公式为（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入*100%。

2023 年，公司的毛利率略低于 3 家内资可比公司的平均值，主要因为 2023 年华岭股份受益于特种芯片的高度景气，盈利水平处于历史高位，拉高了可比公司的平均毛利率。

2024 年至 2026 年上半年，公司的毛利率远高于 3 家内资可比公司的平均值，朗迅科技毛利率的变动趋势与公司较为相近，而利扬芯片和华岭股份的毛利率一直处于低位，各方差异较大，主要原因如下：①公司是一家平台型的测试企业，业务较为均衡，AI 算力芯片、高端芯片测试、车规级芯片测试的收入占比较高，2024 年以来受益于这些领域陆续进入景气周期，公司毛利率实现明显恢复。②利扬芯片的业务以消费电子类芯片和中端测试平台业务为主，整体毛利率低于公司，且过去几年消费电子行业的复苏情况一般，因此其毛利率的复苏情况也低于公司。③华岭股份的业务集中于特种芯片（军工类产品）测试，业务结构与行业内的其他企业差异较大，2024 年以来特种芯片行业处于行业低谷，且 2025 年及以后华岭股份 IPO 募投项目转固后产生较大的折旧压力，进一步影响其毛利率水平。④朗迅科技 2025 年毛利率明显高于公司，主要原因是其芯片成品测试产能利用率进一步提升，有效覆盖了产能扩张所带来的影响，叠加当年手机 SoC 芯片，以及手机 UFS 芯片等测试规模快速增长，相关芯片测试难度和测试单价较高，从而导致其毛利率显著上升。

2023 年至 2025 年，公司的毛利率均高于 3 家台资巨头，主要原因如下：①中国台湾地区半导体产业发展高度成熟，集成电路产业规模处于世界前列，

各巨头激烈的产业竞争影响其利润率水平。②集成电路测试属于人才密集型行业，需要大量半导体、微电子和 IT 人才，人工成本是该行业主要营业成本之一，与中国大陆的“工程师红利”相比，中国台湾地区的工程师和一线工人的人工成本较高，导致其毛利率较低。

2026 年上半年，公司毛利率低于 3 家台资可比公司的平均水平，主要因为公司客户以国内客户为主，一季度受春节因素影响，属于业务的淡季，而 3 家台资可比公司主要服务于国际客户，基本不受春节因素影响；同时，公司扩产幅度较大，导致折旧、摊销、能源费用等刚性固定成本较去年同期相比增长较大。

从毛利率变动趋势看，2023 年至 2025 年公司毛利率变动趋势与 3 家台资可比公司基本一致，2026 年上半年受春节淡季及大规模扩产因素影响，公司毛利率变动趋势与 3 家台资可比公司存在差异。

（四）期间费用分析

报告期各期，公司期间费用构成情况如下：

单位：万元，%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占收入比重	金额	占收入比重	金额	占收入比重	金额	占收入比重
销售费用	2,448.98	2.28	4,236.92	2.69	3,560.32	3.31	2,401.62	3.26
管理费用	4,918.53	4.59	8,657.29	5.50	7,169.40	6.66	5,246.41	7.12
研发费用	8,998.21	8.39	17,201.10	10.92	14,237.79	13.22	10,380.63	14.09
财务费用	3,850.34	3.59	6,250.64	3.97	3,570.89	3.32	3,728.75	5.06
合计	20,216.06	18.86	36,345.95	23.08	28,538.40	26.50	21,757.42	29.54

报告期内，公司期间费用总额分别为 21,757.42 万元、28,538.40 万元、36,345.95 万元和 20,216.06 万元，占当期营业收入比重分别为 29.54%、26.50%、23.08%及 18.86%。期间费用由销售费用、管理费用、研发费用和财务费用构成，报告期内，随着公司业务的快速发展和生产经营规模的不断扩大，期间费用率呈现逐年下降的趋势。

1、销售费用分析

报告期各期，公司销售费用构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
职工薪酬	1,401.70	2,422.70	1,763.40	1,341.84
销售运费	700.78	992.37	912.43	541.21
股份支付	134.00	300.22	511.79	214.55
业务招待费	153.49	293.90	259.16	207.20
业务开拓费	6.44	172.99	63.43	32.07
差旅交通费	32.63	49.29	46.83	61.10
其他	19.95	5.46	3.29	3.66
合计	2,448.98	4,236.92	3,560.32	2,401.62

报告期各期，公司销售费用为 2,401.62 万元、3,560.32 万元、4,236.92 万元及 **2,448.98** 万元，主要为销售人员职工薪酬和销售运费。报告期内，随着公司业务规模不断扩大，销售人员平均人数逐年上升，销售人员总薪酬逐年上升，公司销售费用也呈现逐年上涨的趋势。

2、管理费用分析

报告期内，公司管理费用具体构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
职工薪酬	3,014.83	4,389.14	3,091.67	2,615.78
股份支付	294.75	990.18	1,628.48	1,063.99
折旧摊销	904.37	1,949.86	1,302.73	546.09
中介服务费	268.55	292.86	269.55	201.04
办公费	90.57	218.29	194.60	152.68
业务招待费	67.58	217.95	172.06	142.24
差旅交通费	123.92	196.98	147.51	116.91
房租水电费	93.02	163.15	107.48	258.57
维修费	16.75	23.19	7.81	9.78
其他	44.19	215.69	247.51	139.34
合计	4,918.53	8,657.29	7,169.40	5,246.41

报告期各期，公司管理费用分别为 5,246.41 万元、7,169.40 万元、8,657.29 万元及 **4,918.53** 万元，主要包括职工薪酬、股份支付费用、折旧摊销和中介服务费，上述费用占当期管理费用的比重分别为 84.38%、87.77%、88.04%和

91.13%。随着公司业务规模扩大，管理人员工资、奖金上涨及员工数量增加，导致报告期内管理人员总薪酬呈现逐年上升的趋势。

3、研发费用分析

报告期内，公司各期研发费用构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
职工薪酬	6,753.22	12,152.89	8,680.91	6,388.95
股份支付	814.43	1,736.45	2,440.57	1,513.75
折旧与摊销	967.89	2,224.92	2,115.05	1,574.37
能源费	168.65	513.24	563.21	344.75
机物料消耗费	277.87	540.89	403.46	447.33
专利使用权	12.54	31.82	31.82	31.82
技术服务费	-	-	-	76.96
其他	3.61	0.89	2.77	2.71
合计	8,998.21	17,201.10	14,237.79	10,380.63

报告期各期，公司研发费用分别 10,380.63 万元、14,237.79 万元、17,201.10 万元及 **8,998.21** 万元，研发费用主要由职工薪酬、股份支付费用、折旧与摊销和机物料消耗费等构成。报告期各期，公司研发费用保持了快速增长，主要因为集成电路测试行业具有技术密集型的特点，为了增强公司的技术竞争力以及贯彻公司的“高端化战略”，公司研发中心在测试工艺难点的突破和测试方案的开发、各类基础性的测试技术的研发、测试硬件的升级和改进、自动化生产和智能化生产 IT 系统的研发等方面投入了大量的人力物力。

4、财务费用分析

报告期内，公司各期财务费用构成如下表所述：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	4,385.06	6,426.50	3,786.71	3,306.93
汇兑损益	-478.27	-1.79	-28.37	863.19
手续费	18.11	61.86	28.38	16.02
减：利息收入	74.56	235.94	215.82	457.39

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合计	3,850.34	6,250.64	3,570.89	3,728.75

公司各期财务费用金额分别为 3,728.75 万元、3,570.89 万元、6,250.64 万元及 **3,850.34** 万元，主要是银行借款利息支出和可转债存续期内计提的利息费用。报告期内，公司大力扩张产能，银行借款是公司债务融资的重要手段。公司资信情况良好，与多家商业银行保持着良好的长期合作关系，随着生产设备采购规模的不断扩大，公司充分利用财务杠杆，增加债务融资，财务费用相应上升。2025 年 4 月，公司成功发行可转债，开始按照实际利率计提可转债利息支出，成为 2025 年度和 **2026 年 1-6 月** 财务费用大幅增长的重要原因之一。

（五）利润表其他科目分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益主要为收到的政府补助，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
与资产相关的政府补助	964.24	3,197.69	1,505.70	929.71
与收益相关的政府补助	205.36	1,039.57	850.13	705.40
增值税加计抵减	341.41	1,075.04	-	25.18
代扣个人所得税手续费返还	7.77	10.16	12.94	2.23
合计	1,518.77	5,322.46	2,368.76	1,662.52

2、投资收益

报告期内，公司投资收益主要为交易性金融资产在持有期间的投资收益，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
交易性金融资产在持有期间的投资收益	127.43	625.75	291.74	1,401.53

3、信用减值损失

信用减值损失包括应收账款、应收票据和其他应收款坏账损失。报告期内，公司信用减值损失构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
坏账损失	-327.82	-1,145.25	-291.75	-467.33

报告期内，公司信用减值损失分别为-467.33 万元、-291.75 万元、-1,145.25 万元和-327.82 万元，主要由公司各期应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失构成。

4、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
长期待摊费用减值损失	-	-1,205.88	-	-

2025 年度，公司计提长期待摊费用减值损失 1,205.88 万元，主要系南京伟测自有厂房已完全投入使用，以前年度租赁的厂房将不再继续使用，相应终止原租赁合同并对退租经营租赁资产对应的装修费用计提减值损失。

八、现金流量状况分析

（一）经营活动产生的现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	108,547.64	147,329.17	110,089.18	68,874.27
收到的税费返还	113.27	-	2,966.71	4,283.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,164.14	4,396.70	6,231.17	8,560.48
经营活动现金流入小计	112,825.05	151,725.87	119,287.07	81,718.32
购买商品、接受劳务支付的现金	20,067.48	32,337.82	20,671.91	8,501.97
支付给职工以及为职工支付的现金	32,718.44	41,538.66	31,020.97	23,597.31
支付的各项税费	2,036.63	3,104.62	1,230.84	502.12
支付其他与经营活动有关的现金	3,253.66	4,136.75	4,182.79	2,861.99
经营活动现金流出小计	58,076.21	81,117.86	57,106.51	35,463.38
经营活动产生的现金流量净额	54,748.83	70,608.02	62,180.56	46,254.94

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 46,254.94 万元、62,180.56 万元、70,608.02 万元和 **54,748.83** 万元。报告期内，公司经营活动现金流量净额持续为正且稳步抬升，经营性现金流可有效覆盖日常运营支出。

（二）投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	35,000.00	244,785.00	119,885.09	451,807.08
取得投资收益收到的现金	127.73	625.75	323.96	1,401.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19.21	11,530.23	472.04	214.54
收到其他与投资活动有关的现金	241.89	1,000.46	-	518.57
投资活动现金流入小计	35,388.83	257,941.45	120,681.09	453,941.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,512.29	294,598.10	148,277.24	122,156.14
投资支付的现金	28,000.00	252,785.10	113,890.22	400,307.08
支付其他与投资活动有关的现金	85.90	899.00	655.82	-
投资活动现金流出小计	201,598.19	548,282.21	262,823.29	522,463.21
投资活动产生的现金流量净额	-166,209.36	-290,340.76	-142,142.19	-68,521.50

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-68,521.50 万元、-142,142.19 万元、-290,340.76 万元和**-166,209.36** 万元，主要是购建固定资产等长期资产支出和购买理财产品的支出。

（三）筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	711.82	2,395.07	1,373.38	-
取得借款收到的现金	183,561.19	171,068.77	133,606.03	26,767.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	116,600.00	-	-
筹资活动现金流入小计	184,273.01	290,063.84	134,979.41	26,767.00
偿还债务支付的现金	40,379.73	67,425.13	32,472.52	26,110.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,587.23	9,123.02	6,973.02	10,426.80
支付其他与筹资活动有关的现金	926.91	1,633.90	4,477.97	7,491.31
筹资活动现金流出小计	54,893.87	78,182.05	43,923.51	44,029.09
筹资活动产生的现金流量净额	129,379.14	211,881.79	91,055.90	-17,262.09

报告期内，公司为适应行业的快速发展，通过股东增加投入、银行借款等方式补充营运资金、扩大生产经营规模。公司筹资活动现金流入主要为前次向不特定对象发行可转债募集资金和取得银行借款收到的现金；筹资活动现金流出主要为偿还债务支付的现金。

九、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司重大资本性支出主要是 IPO 募投项目集成电路测试产能建设项目、研发中心项目、前次可转债募集资金投向的无锡和南京测试基地项目以及本次可转债募集资金拟投向的伟测科技上海总部基地项目。报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 122,156.14 万元、148,277.24 万元、294,598.10 万元及 173,512.29 万元，主要是用于支付上述项目的工程建设及设备购置款项。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司未来可预见的资本性支出主要为实施本次募集资金投资项目支出，项目建设完成后将进一步提升公司测试设备的产能和研发实力。公司本次募集资金投资项目参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”。

除本次募集资金计划投资的项目外，未来可预见的其他重大资本性支出如下：

项目	未来预计新增投资金额
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目（二期）	130,000.00 万元

（三）重大资本性支出与科技创新之间的关系

公司扩充产能的相关资本性支出的主要建设目的为提高公司晶圆测试、芯片成品测试等主要服务的能力，相关投入属于科技创新领域。

公司在研发中心等建设项目上的资本性支出旨在进一步培养集成电路测试领域的优秀研发人才，购置先进的研发及实验设备，对公司现有核心技术、主要产品以及战略规划中未来拟研发的新技术、新产品及新兴应用领域进行长期深入的研究和开发，相关投入属于科技创新领域。

报告期内，公司的资本性支出围绕主营业务进行，通过持续的资本性支出，公司的产能得以增加、研发和技术水平持续提升，为公司经营业绩的增长奠定坚实基础。本次募集资金投资项目系公司现有业务的延伸和扩展，服务于科技创新领域，符合国家战略方向和行业发展趋势。

十、技术创新分析

公司主要从事集成电路测试及解决方案服务，通过多年的技术积累和市场开拓，已在晶圆测试、芯片成品测试及集成电路测试方案开发等方面积累了丰富的核心技术和经验，拥有较强的自主开发测试方案的能力和高效可靠的集成电路测试服务能力，并赢得了众多的长期客户。

（一）公司的技术先进性及具体表现

公司成立以来专注于测试工艺的改进和不同类型芯片测试方案的开发，公司主要核心技术来源于自主研发，相关技术在生产应用过程中不断升级和积累，并运用于公司的主要产品中。公司的技术先进性主要体现在测试方案开发能力强、测试技术水平领先和生产自动化程度高三个方面。

在测试方案开发方面，公司建立起了从软件开发到硬件设计的完整研发体系，拥有基于爱德万 V93000、泰瑞达 J750、泰瑞达 UltraFlex 和 Chroma 等中高端平台的复杂 SoC 测试解决方案开发能力，可开发的芯片类型包括 CPU、GPU、AI、IOT、云计算芯片、高速数字通信芯片、高速数字接口芯片、射频收发芯片、射频前端芯片、数模转换芯片、图像传感器芯片、汽车动力和安全控制芯片、车规毫米波雷达芯片、闪存存储芯片、区块链芯片、MEMS、图像识别、FPGA、DSP、MCU、数据加密、高精度电源管理芯片等，在行业内持续保持方案开发的领先优势。

在测试技术水平方面，公司测试技术水平主要体现在晶圆测试的尺寸覆盖度、温度范围、最高 Pin 数、最大同测数、最小 Pad 间距以及芯片成品测试的

封装尺寸大小、测试频率等技术指标，公司在上述测试技术指标保持国内领先地位，达到或者接近国际一流厂商水平。

在生产自动化方面，公司自主开发的测试生产管理系统在晶圆测试预警与反馈、测试良率分析、远程测试控制、生产回溯与质量优化、无纸化作业等方面实现了全流程自动化，同时能够满足测试数据安全、管理及共享等需求，不仅提高了测试效率、降低了测试成本，而且大幅度减少了测试中的呆错现象，保证了测试服务的品质。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其子公司已取得 112 项专利，其中发明专利 28 项，实用新型专利 83 项，外观设计专利 1 项。公司拥有的核心技术如测试方案开发技术、测试工艺难点突破与精益测试提效技术、设备改造升级技术、测试治具设计技术、自动化测试及数据分析技术均已应用在公司日常的量产测试中。凭借着稳定的测试量产品品质和较高的测试量产效率，公司获得了以客户 A、紫光展锐、比特大陆、晶晨股份、中兴微电子等行业高端客户的认可。

（二）正在从事的研发项目及进展情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司主要在研项目 18 项，具体情况如下：

序号	项目名称	研发形式	项目进度
1	基于硅通孔（TSV）工艺高性能 AI 产品整体测试方案	自主研发	进行中
2	测试研发自动化系统（一期）	自主研发	进行中
3	3D 高性能人工智能芯片测试方案	自主研发	进行中
4	3D 堆叠封装芯片成品软硬件测试方案开发	自主研发	进行中
5	半导体测试全场景 AI 图像识别系统开发	自主研发	进行中
6	基于 GPIB 协议的 Handler/Prober 测试设备统一控制系统研发	自主研发	进行中
7	基于 2.5D 封装工艺高性能光计算芯片晶圆测试方案	自主研发	进行中
8	半导体测试设备异常行为预警系统	自主研发	进行中
9	高性能 ADAS 芯片测试方案	自主研发	已结项
10	基于 Camtek ADC 的半导体测试图像精度优化与智能分析系统	自主研发	进行中
11	系统级测试自动化控制系统	自主研发	已结项
12	半导体测试车间 ESD 监控系统升级	自主研发	进行中
13	基于 chroma 平台的车规低成本测试方案的研发（一期）	自主研发	进行中

序号	项目名称	研发形式	项目进度
14	高性能 AI 芯片国产老化测试方案	自主研发	进行中
15	2.5D 封装超高并行度高性能服务器高速数据交换芯片测试方案	自主研发	进行中
16	AI 算力芯片成品测试方案	自主研发	进行中
17	探针过驱量确定方法及半导体设备的改造	自主研发	进行中
18	Wifi 7 无线基带芯片测试方案	自主研发	已结项

（三）保持持续技术创新的机制和安排

公司保持持续技术创新的机制和安排参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施”。

十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

（一）重大担保事项

截至报告期末，公司不存在为合并报表范围以外的主体提供担保的事项。

（二）重大仲裁、诉讼及其他或有事项

截至报告期末，公司不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。公司不存在其他或有事项。

（三）重大期后事项

1、董事变动事项

2026 年 7 月 15 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举骈文胜、闻国涛、宋海燕、金敬长、陈红燕为公司第三届董事会成员，其中宋海燕、金敬长、陈红燕为独立董事。同日，公司职工代表大会选举王沛为公司第三届董事会职工代表董事。截至本募集说明书出具日，公司现任董事简历参见“第四节 发行人基本情况”之“六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（二）董事、高级管理人员及核心技术人员简历”。

2、高级管理人员变动事项

2026 年 7 月 15 日，发行人第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘

任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》，聘任骈文胜为公司总经理，聘任闻国涛、路峰、王沛为公司副总经理，聘任王沛为公司财务总监、董事会秘书。截至本募集说明书出具日，公司现任高级管理人员简历参见“第四节 发行人基本情况”之“六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员”之“（二）董事、高级管理人员及核心技术人员简历”。

上述高级管理人员变动事项不会对公司财务状况、盈利能力及持续经营能力产生重大影响。

3、核心技术人员变动事项

2026年7月16日，公司披露《关于核心技术人员变动的公告》，公司副总经理、核心技术人员刘琨先生因换届离任，不再担任公司副总经理且不再直接参与公司具体研发工作，但仍在公司其他岗位任职。基于其工作职责发生变化，公司不再认定刘琨先生为核心技术人员。

刘琨先生已完成工作交接，公司各项研发项目正常进行。公司自成立以来高度重视研发工作，通过长期的技术积累和发展，已建立了较为完善的研发体系，研发人员理论基础扎实、实践经验丰富、知识结构合理，能够有力支撑公司的研发创新。目前，公司基础研发团队结构完整，后备研发人员充足，现有核心技术人员、基础研发团队及行业技术团队能够支持公司未来核心技术及测试方案的持续研发工作。公司将持续通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，搭建研发人才梯队，不断提升公司的技术创新能力。

综上，公司现有研发团队、核心技术人员总体稳定，上述核心技术人员变动不会对公司的技术研发及核心竞争力产生重大不利影响，亦不会对公司的持续经营能力产生实质性影响。

（四）其他重要事项

截至报告期末，公司无其他需披露的重要事项。

十二、本次发行对公司的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目是建立在公司现有业务基础上的产能扩充，有利于公司在集成电路测试领域的进一步拓展并巩固公司的市场地位，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目是建立在公司现有业务基础上的产能扩充，有利于公司紧跟国家政策并进一步扩大公司在集成电路测试领域的产能布局，有利于公司保持并进一步提升自身的研发实力和科技创新能力。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

第六节 合规经营与独立性

一、发行人报告期内重大违法行为及行政处罚的情况

（一）南京伟测海关行政处罚

2024 年 11 月，中华人民共和国金陵海关作出行政处罚决定书（宁金关违字〔2024〕11 号），因南京伟测申报出口货物货值不准确，依照《中华人民共和国海关法》第二十四条第一款、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第二项、《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准（一）》第十八条之规定，决定对南京伟测处以罚款人民币 2 万元。南京伟测已缴纳相关罚款。

中华人民共和国金陵海关对南京伟测处以 2 万元罚款，适用了一般处罚的规定，南京伟测本次罚款金额较小，相关处罚依据亦未认定该行为属于情节严重的情形，因此，上述处罚不属于重大行政处罚，所涉及的行为不构成重大违法违规行为。

（二）无锡伟测海关行政处罚

2025 年 10 月 28 日，中华人民共和国无锡海关作出行政处罚决定书（锡关缉违字〔2025〕8 号），因无锡伟测作为加工贸易业务的经营单位、加工单位，向海关报核手册时未如实申报剩余料件，构成不按规定向海关办理核销手续违规，依照《中华人民共和国海关法》第八十六条第（十三）项、《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十八条第一款第（四）项、《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准（一）》第十二条第（二）项之规定，对无锡伟测处以罚款人民币 15 万元。无锡伟测已缴纳相关罚款。

无锡海关对无锡伟测处以 15 万元罚款，适用了从轻处罚的规定，无锡伟测本次罚款金额较小，相关处罚依据亦未认定该行为属于情节严重的情形，因此，上述处罚不属于重大行政处罚，所涉及的行为不构成重大违法违规行为。

除上述行政处罚外，报告期内，公司不存在重大违法违规行为，不存在其他因违反法律法规受到行政处罚的情形。

二、发行人及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况、被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况

报告期内，公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况以及公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在占用公司资金的情况，且公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

四、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的同业竞争情况

发行人主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。

发行人控股股东为蕊测半导体，实际控制人为骈文胜。截至本募集说明书出具日，发行人实际控制人直接或间接控制的除发行人及其子公司之外的其他企业的情况如下：

序号	企业名称	经营范围	实际经营业务
1	蕊测半导体	一般项目：从事半导体科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理咨询，信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	除持有发行人股权外不存在其他业务

蕊测半导体除持有发行人股权外未经营其他业务。

发行人实际控制人骈文胜的配偶秦君梅女士全资或控股的企业情况如下：

序号	企业名称	经营范围	实际经营业务
1	上海承括电子科技有限公司	从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子产品、电子元器件、模具、机械设备及配件的销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。	科技推广和应用服务业

注：上海承括电子科技有限公司已于 2024 年 9 月 25 日注销。

综上，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、实际控制人近亲属全资或控股的企业不存在与发行人从事相同、相似业务的情况，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。本次发行不会导致发行人控股股东及实际控制人发生变化，本次发行和本次募投项目实施后不会新增同业竞争。

（二）避免同业竞争的措施

公司控股股东上海蕊测半导体科技有限公司及实际控制人骈文胜出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。

2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接地从事与发行人及子公司业务相同或相似的业务。

3、承诺人及其控制的其他企业如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人及其所控制的企业经营的业务构成或可能构成竞争，则承诺人将立即通知发行人，并承诺将该等商业机会优先让渡于发行人。

4、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。

5、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、

股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。

6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。

7、承诺函自出具之日起具有法律效力，在承诺人作为发行人控股股东期间持续有效，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人承诺将承担相应的法律责任。

若违反上述承诺，本人将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给发行人及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。”

自上市以来，公司控股股东、实际控制人严格遵守作出的相关承诺，未发生新增同业竞争情况，不存在违反避免同业竞争承诺的情况。

五、关联交易情况

（一）关联方

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关规定，截至 2026 年 6 月 30 日，公司的主要关联方及关联关系如下：

序号	关联方	关联关系
1、发行人的控股股东、实际控制人		
1	蕊测半导体	公司控股股东，持有公司 27.18% 的股份
2	骈文胜	公司实际控制人，直接持有及通过上海蕊测半导体科技有限公司及员工持股平台宁波芯伟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司合计 14.56% 的股份，并担任发行人董事长、总经理
2、直接或间接持有发行人 5%以上股份的其他股东及其直接或间接控制的法人或其他组织		
1	闻国涛	直接及间接持有公司合计 7.24% 股份
上述直接或间接持有发行人 5%以上股份的其他股东不存在直接或间接控制的法人或其他组织		
3、控股股东、实际控制人及其亲属控制或实施重大影响的，或者担任董事、高级管理人员的其他企业		
无		
4、发行人的子公司		
1	无锡伟测	发行人持股 100.00%全资子公司
2	南京伟测	发行人持股 100.00%全资子公司

序号	关联方	关联关系
3	上海威矽	发行人持股 100.00%全资子公司
4	深圳伟测	发行人持股 100.00%全资子公司
5	天津伟测	发行人持股 100.00%全资子公司
6	成都伟测	发行人持股 100.00%全资子公司
5、报告期内，发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员		
截至报告期末，发行人时任董事、高级管理人员为骈文胜、闻国涛、路峰、陈凯、林秀强、王怀芳、宋海燕、王沛、刘琨。报告期内，徐伟曾担任公司独立董事，祁耀亮、于波曾担任公司董事，乔从缓、高晓、周歆瑶曾担任公司监事。上述董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员均为公司的关联方。 公司第二届董事会第三十次会议于 2026 年 6 月 29 日审议通过，拟提名骈文胜、闻国涛为公司第三届董事会董事，拟提名宋海燕、陈红燕、金敬长为公司第三届董事会独立董事。议案已于 2026 年 7 月 15 日经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。		
6、发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的企业		
1	宁波芯伟投资合伙企业（有限合伙）	员工持股平台
2	苏民嘉禾（无锡）私募基金管理有限公司（曾用名：苏民嘉禾无锡投资管理有限公司）	董事于波担任董事长、总经理的公司
3	无锡曦和投资管理合伙企业（有限合伙）	董事于波持有 70%份额且担任执行事务合伙人的企业
4	无锡聚源鑫信息科技有限公司	董事于波的弟弟持股 51%的公司
5	普冉半导体（上海）股份有限公司	董事陈凯担任董事的公司
6	赣州芯威企业管理中心	董事陈凯控制的企业
7	赣州恒芯远毅企业管理中心（有限合伙）	董事陈凯控制的企业
8	睿晶半导体（宁波）有限公司	董事祁耀亮担任执行董事、总经理的公司
9	睿晶微（上海）半导体有限公司	董事祁耀亮担任执行董事、总经理的公司
10	睿晶半导体有限公司	董事祁耀亮担任执行董事、总经理的公司
11	宁波耀晶企业管理咨询有限公司	董事祁耀亮担任执行董事、总经理的公司
12	宁波贤睿达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	董事祁耀亮全资的宁波耀晶企业管理咨询有限公司持股 99%且担任执行事务合伙人的企业
13	宁波募贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	董事祁耀亮直接和间接持股 79.96%的企业
14	江苏奥德盛海洋装备服务有限公司	监事高晓配偶的父亲持股 75%，配偶的母亲持股 25%，且配偶父亲担任总经理、执行公司事务的董事的公司
15	无棣海忠软管制造有限公司	监事高晓配偶的父亲担任董事长的公司

序号	关联方	关联关系
16	江阴市冠德新材料有限公司	监事高晓配偶的父亲担任总经理的公司
17	江阴市尚时工程装备有限公司	监事高晓配偶的父亲持股 70%，配偶的母亲持股 30%，且配偶父亲担任总经理、执行公司事务的董事的公司
18	深圳市西柚子投资有限公司	监事高晓配偶的弟弟控制（持股 100%）并担任总经理，执行董事的公司
19	天津天天船舶工程服务有限公司	监事高晓配偶的弟弟控制（持股 90%）并担任总经理，执行董事的公司
20	环球海洋工程（天津）有限公司	监事高晓配偶的弟弟控制（持股 79%）并担任董事长的公司
21	德盛环球租赁（天津）有限公司	监事高晓配偶的弟弟控制（持股 79%）并担任董事长的公司
22	江苏奥德胜船务工程有限公司	监事高晓配偶的弟弟持股 50%并担任总经理，执行董事的公司
23	德晟海洋工程装备租赁（天津）有限公司	监事高晓配偶的弟弟持股 51%的公司
24	天津环球水下系统作业装备有限公司	监事高晓配偶的弟弟担任执行董事的公司
25	环球海事服务（天津）有限公司	监事高晓配偶的弟弟控制的公司
26	中石化石油工程有限公司地球物理华北分公司	独立董事王怀芳哥哥担任副总政工师的公司
27	中睦控股有限公司	独立董事林秀强持股比例 57%并任执行董事的公司
28	深圳市智汇科创科技有限公司	发行人控股股东总经理沈爽恒持股 19%且担任总经理、执行董事的公司
29	新余电腾投资中心（有限合伙）	拟任独立董事陈红燕持有 30%份额并担任执行事务合伙人的企业
30	上海宏蒙教育科技有限公司	拟任独立董事陈红燕配偶持股 80%并担任执行董事的公司
31	无锡晟电科技有限公司	拟任独立董事陈红燕配偶持股 80%并担任执行董事、经理的公司
32	嘉兴海佳电气科技有限公司	拟任独立董事陈红燕配偶持股 45%并担任执行董事、经理的公司
7、直接或间接控制发行人的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人		
直接或间接控制发行人的法人或其他组织为上海蕊测半导体科技有限公司，蕊测半导体的总经理为沈爽恒，执行董事为骈文胜，监事为闻国涛。		
8、其他关联方		
1	深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	报告期内曾经持有发行人 5%以上股份的股东
2	江苏昶泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	报告期内曾经持有发行人 5%以上股份的股东
3	苏民无锡智能制造产业投资发展合伙企业（有限合伙）	报告期内曾经持有发行人 5%以上股份的股东
4	苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权	报告期内曾经持有发行人 5%以上股份的股东

序号	关联方	关联关系
	投资合伙企业（有限合伙）	
5	上海市浦东新区唐镇国澜餐饮店	董事、副总经理闻国涛弟弟曾经营的个体工商户，报告期期初前 12 个月内已注销
6	江阴市尚时环境工程有限公司	监事高晓配偶的父亲持股 70%，配偶的母亲持股 30%，且配偶父亲担任总经理、执行董事的公司，报告期期初前 12 个月内已注销
7	江阴市工业设备安装有限公司	监事高晓配偶的父亲持股 70%，配偶的母亲持股 30%，且配偶父亲担任总经理、执行董事的公司，报告期期初前 12 个月内已注销
8	无锡鸿泰智科技有限公司	董事于波弟弟曾持股 60%的公司
9	无锡浩淼科技有限公司	董事于波曾担任董事的公司
10	杭州艾芯智能科技有限公司	董事于波曾担任董事的公司
11	上海易立德信息技术股份有限公司	董事于波曾担任董事的公司
12	苏民创业投资有限公司	董事于波曾担任董事、总经理的公司
13	江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司	董事于波曾担任董事的公司
14	深圳市锐骏半导体股份有限公司	董事陈凯曾担任董事的公司
15	核芯互联科技（青岛）有限公司	董事陈凯曾担任董事的公司
16	中微半导体（深圳）股份有限公司	董事陈凯曾担任董事的公司
17	美芯晟科技（北京）股份有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
18	成都启英泰伦科技有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
19	同源微（北京）半导体技术有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
20	西安吉利电子新材料股份有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
21	浙江亚笙半导体设备有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
22	管芯微技术（上海）有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
23	苏州长瑞光电有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
24	苏州汉朗光电有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
25	重庆晶朗光电有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
26	上海季丰电子股份有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
27	强一半导体（苏州）股份有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司

序号	关联方	关联关系
28	京微齐力（北京）科技有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
29	昇显微电子（苏州）有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
30	上海铭荃商务咨询中心	董事祁耀亮曾持股 100%的企业，报告期内已注销
31	昆腾微电子股份有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
32	捷螺智能设备（苏州）有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
33	泓沚（苏州）半导体科技有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
34	重庆汉朗精工科技有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
35	宁波创润新材料有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
36	圆周率半导体（南通）有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
37	世瞳（上海）电子科技有限公司	董事祁耀亮曾担任董事的公司
38	天津环球海洋工程装备有限公司	监事高晓配偶的弟弟曾控制（持股 55%）并担任执行董事的公司
39	天津市海王星海上工程技术股份有限公司	监事高晓配偶的母亲曾担任董事的公司
40	南京正策盛建设工程有限公司	监事高晓配偶的父亲曾担任董事长的公司
41	上海楼邻信息科技有限公司	独立董事徐伟的儿子持股比例 99%且担任执行董事的公司
42	上海晗哲杰餐饮管理有限公司	独立董事徐伟的儿子担任执行董事的公司
43	上海遐米商务信息咨询中心	独立董事徐伟持股比例 100%的企业
44	上海承括电子科技有限公司	公司实际控制人的配偶曾持股 70%，并担任执行董事的企业，于报告期内注销

（二）关联交易

1、重大关联交易的判断标准及依据

发行人上市以来未发生影响发行人独立性的关联交易，不存在违反关联交易相关承诺的情况。公司参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海伟测半导体科技股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，将公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易总额占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上且超过 300 万元的关联交易认定为重大关联交易。

2、经常性关联交易

(1) 重大经常性关联交易

报告期内，发行人重大经常性关联交易为向关联方提供检测服务及治具，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	交易价格的确定方法	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
普冉半导体（上海）股份有限公司	检测服务及治具	市场价	3,011.44	3,986.88	4,481.24	2,928.52
合计	-	-	3,011.44	3,986.88	4,481.24	2,928.52
占营业收入的比例	-	-	2.81%	2.53%	4.16%	3.98%

(2) 一般经常性关联交易

报告期内，公司一般经常性关联交易主要为向关联方采购商品、向关联方销售商品或提供服务，以及向董事、（前）监事、高级管理人员支付薪酬，具体情况如下：

单位：万元

交易类型	关联方名称	关联交易内容	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关联采购	强一半导体（苏州）股份有限公司	探针卡及维修	-	3.00	517.43	269.81
	圆周率半导体（南通）有限公司	测试备件及服务	-	30.76	11.91	14.05
	上海季丰电子股份有限公司	测试备件及服务	-	-	0.06	0.32
关联销售	中微半导体（深圳）股份有限公司	检测服务及治具销售	202.88	363.44	204.68	147.93
	核芯互联科技（青岛）有限公司	检测服务	94.60	265.59	128.42	78.63
关键管理人员薪酬	董事、（前）监事、高级管理人员等	薪酬	373.05	818.94	766.06	699.72

注：陈凯自 2023 年 4 月开始担任核芯互联科技（青岛）有限公司董事，报告期内，公司与核芯互联科技（青岛）有限公司的关联交易统计区间为 2023 年 4 月至 2026 年 6 月；祁耀亮于 2024 年 3 月起卸任公司董事并不再担任公司任何职务，报告期内，公司与强一半导体（苏州）股份有限公司、圆周率半导体（南通）有限公司、上海季丰电子股份有限公司等

相关关联方的关联交易统计区间为 2023 年 1 月至 2025 年 3 月。

3、偶发性关联交易

(1) 关联担保

报告期内，公司不存在为全资子公司以外的其他关联方提供担保的情形。
截至报告期末，公司不存在作为被担保方的尚未履行完毕的关联担保。

(2) 关联方资金拆借

报告期内，公司不存在关联方资金拆借。

4、关联方应收应付款项

报告期各期末，公司与关联方之间交易相关往来款项余额汇总情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	关联方	账面余额			
		2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	普冉半导体（上海）股份有限公司	1,399.39	1,168.85	693.65	932.86
	中微半导体（深圳）股份有限公司	208.40	188.64	86.28	104.34
	核芯互联科技（青岛）有限公司	15.93	42.52	29.78	0.12
应收票据	普冉半导体（上海）股份有限公司	-	-	-	201.28
应收款项融资	普冉半导体（上海）股份有限公司	-	-	-	494.61
应付账款	强一半导体（苏州）股份有限公司	-	-	-	215.64
	上海季丰电子股份有限公司	-	-	-	0.34
	圆周率半导体（南通）有限公司	-	-	-	15.88
其他应付款	骈文胜	-	11.00	16.04	-
	闻国涛	-	9.00	8.00	-
	路峰	-	7.00	8.00	-
	王沛	-	5.00	5.00	-
	刘琨	-	3.00	2.00	-
	乔从缓	-	-	1.00	-

5、关联交易的公允性、必要性及对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司各期发生的关联采购和关联销售交易金额分别占当期营业成本、营业收入的比例较低，对公司财务状况和经营成果影响较小。相关交易基于发行人日常生产经营需要而发生，系正常的市场行为，符合发行人的实际经营和发展需要，具有必要性。相关交易定价按照市场价格协商确定，遵循平等互利原则，具有公允性。

6、报告期内关联交易履行的程序情况及独立董事关于关联交易的意见

公司已根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海伟测半导体科技股份有限公司关联交易管理办法》对报告期内的关联交易事项履行了相应的董事会、股东（大）会程序。

公司独立董事根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理办法》等规定对发行人报告期内关联交易发表独立意见，认为关联交易符合公司业务发展的需要，关联交易价格依据市场价格公平、合理确定，符合商业惯例，遵循了公允、公平公正的原则符合公司和全体股东的利益。

第七节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投资项目的的基本情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 200,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	名称	投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	伟测科技上海总部基地项目	98,740.00	70,000.00
2	伟测科技西南总部及研发测试基地项目	100,000.00	80,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		248,740.00	200,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，经公司股东会授权，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

二、本次募集资金投资项目的经营前景

本次募集资金拟投资项目包括“伟测科技上海总部基地项目”及“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”，主要用于扩大公司集成电路测试产能，尤其是 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能。

在 AI 算力芯片领域，随着 AI 从模型训练走向实际应用，推理需求呈几何级数增长，驱动产业进入“超级周期”。国产算力芯片已跨越“可用”拐点，正通过系统级创新从替代者转变为全球格局中不可忽视的参与者。

在存储芯片领域，AI 大模型爆发使其升级为战略物资，引发全球供需失衡。我国产业正处于 AI 驱动与国产替代交汇的机遇期，有望在未来 5-10 年开创“中国存储时代”。

在高端 CIS 芯片领域，该技术长期被国外垄断，主要应用于旗舰级消费电

子产品的主摄像头，国内领先企业实现突破后销量大幅增长，配套的测试需求十分旺盛。

综上，AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片未来需求旺盛，本次募集资金投资项目的经营前景广阔。

三、与现有业务或发展战略的关系

（一）本次募投项目与现有业务或发展战略的关系，既有业务的发展概况

公司的发展战略是“致力于成为国内领先、世界一流的集成电路测试服务及解决方案提供商”。本次募投项目主要用于公司现有主营业务集成电路测试业务的产能扩充，重点扩充 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能，提高公司集成电路测试服务的效率和交付能力，有利于优化公司收入结构，增强公司在芯片测试领域的市场竞争力，提高公司市场份额。公司本次拟使用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金，有助于缓解公司未来的资金压力，提高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。本次募投项目的实施紧紧围绕公司主营业务、迎合市场需求、顺应公司发展战略。项目的实施是公司把握市场机遇、快速提升集成电路测试服务的品质和综合竞争力的重要举措，不仅有助于提升公司测试规模和市场竞争力，满足终端客户需求，而且能够提高规模化成本竞争优势，获取更大的增值空间，符合公司发展战略需要。

公司是国内领先的独立第三方集成电路测试企业，先后被评为国家高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业、浦东新区企业研发机构。自 2016 年 5 月成立以来，公司经营业绩实现了高速增长，成为第三方集成电路测试行业成长性较为突出的企业之一。截至目前，公司已经发展成为第三方集成电路测试行业中规模排名前列的内资企业之一。

（二）扩大业务规模的必要性，新增产能规模的合理性

1、扩大业务规模的必要性

（1）继续加大 AI 算力芯片测试产能的建设，将其打造成为公司业绩增长的重要引擎，并为我国人工智能行业高端测试能力的自主可控提供有力保障

过去两年，面对人工智能产业爆发式增长带来的 AI ASIC 芯片、GPU、CPU 等 AI 算力芯片测试需求，公司坚持前瞻性扩产策略，通过引进国际先进测试设备、组建专业测试团队、建设高标准测试产线等举措，全面加码产能布局。截至 2025 年末，AI 算力芯片测试收入在公司营业收入中的占比已经初具规模。公司预计未来几年，AI 算力芯片测试需求仍将保持爆发式增长的态势。本次募投项目将继续加大 AI 算力芯片测试产能的建设，一方面能够将其打造成为公司业绩增长的重要引擎，另一方面能够填补我国在该领域的产能缺口，有助于构建自主可控的测试技术体系，为我国人工智能产业筑牢质量根基，助力国产 AI 算力芯片在全球竞争中掌握核心话语权。

（2）响应现有客户的需求，扩大存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能，增强客户粘性，并增强公司的差异化竞争优势，打造新的业绩增长点

本次募投项目在重点强化 AI 算力芯片测试业务的同时，亦将部分资源倾斜至存储芯片、高端 CIS 芯片测试产能的建设。虽然这两类业务当前并非公司收入的主要来源，但凭借其卓越的成长潜力与有利的竞争态势，加之现有客户旺盛的测试需求，公司已将其视为关键的业务延伸方向。通过本次产能扩充，公司不仅能高效满足现有客户的增量需求，进一步巩固客户基础，更能借此优化业务组合，构建独特的差异化优势，为公司业绩的可持续增长打造新的业绩增长点。

（3）为公司业绩的持续增长提供产能保障，进一步巩固公司在行业中的领先地位

自 2016 年成立以来，公司的业绩保持了高速增长的态势，截至目前，公司已经发展成为中国大陆第三方集成电路测试领域中的领军企业。随着业务量不断上升，公司需要继续扩充测试产能才能保障业绩的持续增长。此外，集成电路行业具有“大者恒大”的规律，本次募投项目达产之后，预计能够大幅度增

加公司的测试服务能力、营业收入和净利润规模，进一步巩固公司在行业中的领先地位。

2、产能规划的合理性

（1）公司扩产规模相比市场规模较小，预计产能消化不存在障碍

我国集成电路测试行业市场空间广阔且增长迅速。据灼识咨询统计，未来中国大陆集成电路测试行业仍将保持两位数的增长速度，2030 年中国大陆集成电路测试市场规模将达到 1,171 亿元。公司两个募投项目达到预定可使用状态后预计每年给公司带来 6 亿元收入增长，而 2030 年国内测试市场容量则已超过 1,100 亿元水平。公司扩产规模相比市场规模较小，产能规划合理。

（2）集成电路行业增长态势强劲，公司营业收入在 2024 年以来重回高速增长轨道，为募投项目产能消化奠定了坚实基础

公司是第三方集成电路测试行业成长性较为突出的企业之一。2023 年-2026 年 1-6 月公司营业收入同比增长率分别为 0.48%、46.21%、46.22%和 69.00%。2023 年受行业周期下行的影响，公司营业收入仅增长 0.48%，但是受益于 AI 芯片、存储芯片等高端测试需求旺盛，2024 年以来公司营业收入重回高速增长轨道，从而为募投项目产能消化奠定了坚实基础。

（3）公司未来发展空间和潜力较大，为募投项目产能消化提供了充足空间

虽然公司已经成为第三方集成电路测试领域规模排名前列的内资企业之一，但是 2025 年公司销售收入仅有 15.75 亿元，仅为中国大陆集成电路测试市场规模的 2%左右，仅相当于全球巨头京元电子销售规模的 20%左右，全年产能仅能满足两家百亿收入规模级别的头部芯片设计公司一年的全部测试需求。因此，从市场占有率、与国际巨头的差距、公司销售占下游客户采购总额的比重等角度来看，公司仍然具有较大的发展空间。

综上，公司本次产能规划具有合理性。

四、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）伟测科技上海总部基地项目

1、项目概况

“伟测科技上海总部基地项目”的实施主体为上海伟测半导体科技股份有限公司，总投资额为 98,740 万元，拟使用本次募集资金金额为 70,000 万元。本项目拟在上海购买土地、新建厂房并配置相关测试设备，重点购置 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试机台，提升公司在上述方向的服务能力。

2、建设内容及投资概算

本次募投项目之“伟测科技上海总部基地项目”的投资总额为 98,740.00 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	使用本次募集资金金额	是否属于资本性支出
一	建设投资	97,740.00	70,000.00	是
1	土地及基础设施建设费用	44,370.95	25,800.00	是
2	设备购置费	52,394.62	44,200.00	是
3	预备费	974.43	-	否
二	铺底流动资金	1,000.00	-	否
	合计	98,740.00	70,000.00	

（1）土地及基础设施建设费用

土地及基础设施建设包括相关土地使用权的出让金、厂房土建和土方工程等，具体金额根据预计项目建设工程量及项目地工程造价水平估计。根据公司签订的土地出让合同，本次土地出让金为 4,431.00 万元；根据公司已签订的相关合同，本次厂房土建金额为 20,200.00 万元，机电工程金额 16,320.00 万元，装修费用 1,799.95 万元，35kv 变电站 1,620.00 万元，合计本次建筑工程费约为 44,370.95 万元。

（2）设备购置费

本项目设备测算主要参考公司历史设备采购价格，预计设备购置费 52,394.62 万元，具体设备购置费情况如下：

设备类型	数量（台）	金额（万元）
测试机	70	41,458.97
探针台	35	4,039.20
分选机	35	6,896.45
合计	140.00	52,394.62

（3）预备费

预备费是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用。根据项目的实际情况，预估本项目预备费为 974.43 万元，占项目总投资的比重约为 0.99%。

（4）铺底流动资金

预计本项目投入铺底流动资金 1,000 万元，占项目总投资的比重约为 1%。

3、项目实施进度

本次募投项目计划建设期 5 年，将根据项目实施过程的具体情况合理安排建设的进度，具体实施进度如下表所示：

项目	T+1 年				T+2 年				T+3 年				T+4 年				T+5 年			
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
土地购买																				
厂房土建和装修																				
设备采购及安装调试																				
人员招聘及培训																				
产品技术及开发																				
生产																				

注：T 为项目开工建设时点，Q 代表季度

（二）伟测科技西南总部及研发测试基地项目

1、项目概况

“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”的实施主体为成都伟测半导体科技有限公司，总投资额为 100,000 万元，拟使用本次募集资金金额为 80,000 万元。本项目拟在成都购买土地、新建厂房并配置相关测试设备，重点购置 AI

算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试机台，提升公司在上述方向的服务能力。

2、建设内容及投资概算

本次募投项目之“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”的投资总额为 100,000.00 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资金额	使用本次募集资金金额	是否属于资本性支出
一	建设投资	99,000.00	80,000.00	是
1	土地及基础设施建设费用	36,139.69	28,000.00	是
2	设备购置费	61,338.55	52,000.00	是
3	预备费	1,521.76	-	否
二	铺底流动资金	1,000.00	-	否
合计		100,000.00	80,000.00	-

(1) 土地及基础设施建设费用

本项目建筑内容包括相关土地使用权的出让金、土建工程、土方工程、桩基工程及装修费用等，具体金额根据预计项目建设工程量及项目地工程造价水平估计。根据公司合理估计，本次土地出让金为 1,080 万元；根据公司合理估计，本次厂房土建金额为 14,008.76 万元，机电工程金额 17,623.92 万元，装修费用 1,427 万元，变电站 2,000 万元，合计本次建筑工程费约为 36,139.69 万元。

(2) 设备购置费

本项目设备测算主要参考公司历史设备采购价格，预计设备购置费 61,338.55 万元，具体设备购置费情况如下：

设备类型	数量（台）	金额（万元）
测试机	90	47,191.39
探针台	45	5,227.39
分选机	45	8,919.77
合计	180	61,338.55

(3) 预备费

预备费是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的

费用。根据项目的实际情况，本项目预备费为 1,521.76 万元，占项目总投资的比重约为 1.52%。

（4）铺底流动资金

预计本项目投入铺底流动资金 1,000 万元，占项目总投资的比重约为 1%。

3、项目实施进度

本次募投项目计划建设期 5 年，将根据项目实施过程的具体情况合理安排建设的进度，具体实施进度如下表所示：

项目	T+1 年				T+2 年				T+3 年				T+4 年				T+5 年			
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
土地购买																				
厂房土建和装修																				
设备采购及安装调试																				
人员招聘及培训																				
产品技术及开发																				
生产																				

注：T 为项目开工建设时点，Q 代表季度

（三）偿还银行贷款及补充流动资金

1、项目概况

公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点以及业务发展规划等情况，拟将本次募集资金中的 50,000 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金，占预计募集资金总额的 25%。

2、项目必要性及规模的合理性

（1）项目实施的必要性

截至 2026 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 65,938.22 万元，长期借款余额为 312,908.48 万元，一年内到期的非流动负债余额为 38,519.30 万元，有息负债总额超过 37 亿元，偿债压力较大。此外，最近三年一期，公司营业收入分别为 73,652.48 万元、107,686.99 万元、157,464.24 万元及 107,185.98 万元，

最近三年年均复合增长率 46.22%。随着公司经营规模的稳步扩张，所需营运资金规模将不断增加。因此，本次偿还银行贷款及补充流动资金能有效缓解公司偿债压力，优化公司资本结构，解决公司发展过程中的资金需求问题，优化资本结构、减轻财务负担，进一步提高公司抗风险能力和公司综合竞争力，为提升持续盈利能力提供保障。

（2）项目实施的可行性

①公司内控完善，募集资金管理相关制度规范

公司建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。公司制定了《上海伟测半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专项储存、使用作出了明确的制度安排，以在制度上保证募集资金的规范使用。

②本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金符合法律法规的规定

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金符合相关法律法规的规定，具备可行性。本次发行可转换公司债券偿还银行贷款及补充流动资金的总金额为 50,000 万元。上述金额占募集资金总额的比例为 25%，未超过 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。

五、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

（一）实施能力

公司主要从事晶圆测试和芯片成品测试，形成了具有自主知识产权的核心技术体系，具备较强的核心技术优势、研发能力优势、人才优势、客户优势等，实施本次募投项目在人员、技术、市场等方面均具有扎实的基础。

1、本次投资项目的下游市场前景广阔，为项目的实施提供了市场保障

本次募投项目主要投资于 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片三个下游方向。在 AI 算力芯片领域，随着 AI 从模型训练走向实际应用，推理需求呈几

何级数增长，驱动产业进入“超级周期”。国产算力芯片已跨越“可用”拐点，正通过系统级创新从替代者转变为全球格局中不可忽视的参与者。在存储芯片领域，AI 大模型爆发使其升级为战略物资，引发全球供需失衡。我国产业正处于 AI 驱动与国产替代交汇的机遇期，有望在未来 5-10 年开创“中国存储时代”。在高端 CIS 芯片领域，该技术长期被国外垄断，主要应用于旗舰级消费电子产品的主摄像头，国内领先企业实现突破后销量大幅增长，配套的测试需求十分旺盛。综上，本次投资项目的下游市场前景广阔，为项目的实施提供了市场保障。

2、公司拥有经验丰富、专业能力过硬的经营和技术团队，为项目的实施提供了人才保障

公司的核心团队深耕集成电路行业二十余年，是国内最早从事集成电路测试的一批资深人士。团队主要成员曾先后在摩托罗拉、日月光、长电科技等全球知名半导体企业或封测龙头企业从事测试业务技术研发和管理工作，拥有深厚的专业背景，对各类芯片测试拥有丰富的实践经验和技術积累，并且在市场研判、行业理解等方面具备领先于同行业的洞察力，为本项目的实施提供了人才保障。

3、本次募投项目的产能主要服务于公司现有客户，项目的实施已经具备良好的客户基础

在 AI 算力芯片领域，经过 2 年多的开拓和积累，公司已经与国内主要的 AI 算力芯片厂商建立了业务合作关系，具体包括 AI ASIC 芯片龙头企业、GPU 新锐厂商、自研 AI 芯片的云计算厂商、智能驾驶 AI 芯片厂商四大类客户。此外，公司也与多家 AI 服务器 CPU 厂商建立了稳定的业务合作关系。在存储芯片领域，公司已经服务于兆易创新、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等国内知名存储芯片客户。在高端 CIS 芯片领域，本次新增产能将主要服务于公司的第一大客户。

综上，本次募投项目的产能主要服务于公司现有客户，项目的实施已经具备良好的客户基础。

（二）资金缺口的解决方式

本次募集资金投资项目总投资额为 198,740.00 万元（不含偿还银行贷款及补充流动资金金额），拟使用本次募集资金 150,000.00 万元，剩余资金拟通过自有资金或自筹资金解决。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金拟投资项目实际进度情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

六、募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程

（一）伟测科技上海总部项目

1、主要假设条件

假设宏观经济环境和半导体行业市场情况及公司经营情况不会发生重大不利变化，本次募投项目的主要假设条件如下：

（1）本项目的计算期为 10 年；

（2）公司设备分三批采购，每年采购总设备数量的三分之一。第一批采购的测试设备于 T+2 年开始投产，第二批采购的测试设备于 T+3 年开始投产，第三批采购的测试设备于 T+4 年开始投产。考虑设备逐步释放产能及设备可能出现的维修调整等情况，每批设备第一年的年销售产能以该批设备满产产能的 80%，第二年的年销售产能以该批设备满产产能的 85%，第三年的年销售产能以该批设备满产产能的 90%，第四年及之后的年销售产能以该批设备满产产能的 95%进行估算。

2、主要计算过程

（1）营业收入预计

营业收入的测算系根据各测试平台测试时长和测试单价测算，即营业收入=测试时长×测试单价。其中测试时长为 24 小时*360 天*90%，考虑到测试平台在运转过程中存在检修、维护等因素，故测试时长以全年时长的 90%计算。考虑设备可能出现维修等意外情况，完全达产年度后的销售产能以满产产能的 95%作为审慎估计值。测试单价系参考公司近期同类型测试平台平均销售单价及市场情况进行的预估。项目建成后，达产年的销售收入为 28,551.53 万元，具体情

况如下：

产品类型	稳定运营期销售收入（万元）
高端测试平台	26,704.73
中端测试平台	1,846.80
合计	28,551.53

（2）总成本费用测算

本次募投项目的总成本费用包括营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等。参考发行人历史水平并结合项目公司实际经营情况予以确定。

其中，营业成本包括设备折旧及摊销、直接人工、制造费用和能源费用等，具体情况如下：

①折旧及摊销：折旧摊销包含生产厂房与机器设备折旧及土地使用权摊销。本建设项目使用年限平均法，房屋建筑物按 20 年折旧，残值率 0%；生产设备按 10 年折旧，残值率 0%；土地使用权按 20 年摊销，无残值，摊销年限与土地出让合同中的使用年限一致。

②直接人工：参考公司实际情况预估生产制造中的员工数量和平均薪酬。

③制造费用及能源费用：依据公司历史水平进行测算。

④销售费用、管理费用、研发费用、财务费用：根据公司历史水平并结合公司实际经营情况进行测算。

（3）税金及附加

增值税测算销项税率为 6%，进项税率为 13%，城市建设费和教育附加（含地方教育附加）分别为 7%和 5%。

（4）所得税测算

企业所得税税率按照 15%测算。

（5）项目效益总体情况

根据方案测算，本项目具有较强的盈利能力。本项目完全达产后年平均销售收入 28,551.53 万元，项目财务内部收益率 16.03%，静态投资回收期为 8.01 年。

（二）伟测科技西南总部及研发测试基地项目

1、主要假设条件

假设宏观经济环境和半导体行业市场情况及公司经营情况不会发生重大不利变化，本次募投项目的主要假设条件如下：

（1）本项目的计算期为 10 年；

（2）公司设备分三批采购，每年采购总设备数量的三分之一。第一批采购的测试设备于 T+3 年开始投产，第二批采购的测试设备于 T+4 年开始投产，第三批采购的测试设备于 T+5 年开始投产。考虑设备逐步释放产能及设备可能出现的维修调整等情况，每批设备第一年的年销售产能以该批设备满产产能的 80%，第二年的年销售产能以该批设备满产产能的 85%，第三年的年销售产能以该批设备满产产能的 90%，第四年及之后的年销售产能以该批设备满产产能的 95%进行估算。

2、主要计算过程

（1）营业收入预计

营业收入的测算系根据各测试平台测试时长和测试单价测算，即营业收入=测试时长×测试单价。其中测试时长为 24 小时*360 天*90%，考虑到测试平台在运转过程中存在检修、维护等因素，故测试时长以全年时长的 90%计算。考虑设备可能出现维修等意外情况，完全达产年度后的销售产能以满产产能的 95%作为审慎估计值。测试单价系参考公司近期同类型测试平台平均销售单价及市场情况进行的预估。项目建成后，达产年的销售收入为 31,543.34 万元，具体情况如下：

产品类型	稳定运营期销售收入（万元）
高端测试平台	28,883.95
中端测试平台	2,659.39
合计	31,543.34

（2）总成本费用测算

本次募投项目的总成本费用包括营业成本、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等。参考发行人历史水平并结合项目公司实际经营情况予以确定。

其中，营业成本包括设备折旧及摊销、直接人工、制造费用和能源费用等，具体情况如下：

①折旧及摊销：折旧摊销包含生产厂房与机器设备折旧及土地使用权摊销。本建设项目使用年限平均法。房屋建筑物按 20 年折旧，残值率 0%；生产设备按 10 年折旧，残值率 0%；土地使用权按 20 年摊销，无残值，摊销年限与土地出让合同中的使用年限一致。

②直接人工：参考公司实际情况预估生产制造中的员工数量和平均薪酬。

③制造费用及能源费用：依据公司历史水平进行测算。

④销售费用、管理费用、研发费用、财务费用：根据公司历史水平并结合公司实际经营情况进行测算。

（3）税金及附加

增值税测算销项税率为 6%，进项税率为 13%，城市建设费和教育附加（含地方教育附加）分别为 7%和 5%。

（4）所得税测算

企业所得税率前两年免除，后三年减半为 12.5%，之后为 15%。

（5）项目效益总体情况

根据方案测算，本项目具有较强的盈利能力。本项目完全达产后年平均销售收入 31,543.34 万元，项目财务内部收益率 16.17%，静态投资回收期为 8.83 年。

（三）偿还银行贷款及补充流动资金

1、项目概况

公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点以及业务发展规划等情况，拟将本次募集资金中的 50,000.00 万元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

2、项目必要性及规模的合理性

截至 2026 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 65,938.22 万元，长期借款余额为 312,908.48 万元，一年内到期的非流动负债余额为 38,519.30 万元，有

息负债总额超过 **37 亿元**，偿债压力较大。此外，随着公司经营规模的稳步扩张，所需营运资金规模将不断增加。因此，本次偿还银行贷款及补充流动资金能有效缓解公司偿债压力，优化公司资本结构，解决公司发展过程中的资金需求问题，优化资本结构、减轻财务负担，进一步提高公司抗风险能力和公司综合竞争力，为提升持续盈利能力提供保障。

七、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

（一）本次募集资金投资于科技创新领域的说明

本次募集资金均用于公司主营业务集成电路测试领域。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属的行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类下的“C3973 集成电路制造”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，本次募投项目所属领域为“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造”，属于国家战略及政策重点支持发展的科技创新领域。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，本次募投项目所属领域属于第五条规定的“新一代信息技术领域”，符合科创板的行业范围。

因此，本次募集资金投向属于科技创新领域。

（二）募集资金投资项目实施促进公司科技创新水平的方式

通过本次募投项目的实施，公司将进一步实现集成电路测试尤其是 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能的扩张，进一步提升公司测试方案的开发能力，提高公司核心技术水平和产品竞争力，促进主营业务发展，并促进公司科技创新水平的持续提升。

未来公司将持续加大研发投入，重点针对 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试等方向，着重突破各类芯片的测试难点，为公司持续发展注入新动能。

八、本次募集资金投资项目涉及的立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进程、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性

本次募投项目涉及有关审批、批准或备案事项具体情况如下：

项目名称	立项	土地	环保审批
伟测科技上海总部项目	已取得上海市浦东新区发展和改革委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》（2501-310115-04-01-983781）	已取得《不动产权证书》（沪（2025）浦字不动产权第087369号）	已取得上海市浦东新区生态环境局出具的《上海市浦东新区生态环境局关于伟测科技上海总部基地项目环境影响报告表的审批意见》（批复号沪浦环保许评[2025]218号）
伟测科技西南总部及研发测试基地项目	已取得成都市高新区发展改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2608-510109-04-01-934867】FGQB-0525号）	公司尚未取得募投项目涉及土地的使用权	已取得成都高新技术产业开发区生态环境和城市管理当局出具的《成都高新区生态环境和城市管理当局关于成都伟测半导体科技有限公司伟测科技西南总部及研发测试基地项目环境影响报告表的批复》（批复号成高环字[2026]2号）
偿还银行贷款及补充流动资金	不适用	不适用	不适用

截至本募集说明书出具日，发行人尚未取得募投项目“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”的土地使用权，相关土地尚未进行土地招拍挂程序，目前尚处于土地整备及完善土地出让前期手续阶段，相关流程正在推进中。

根据发行人与成都高新技术产业开发区管理委员会于 2026 年 8 月 5 日签订的《投资合作协议》、相关补充协议及成都高新区电子信息产业局出具的说明，“意向用地规划为工业用地，目前正在完善项目意向用地出让的前期手续阶段。伟测科技、成都伟测计划在意向土地上投资建设“伟测科技西南总部及研发测试基地项目”，符合国家及地方土地管理、城市规划等相关法律法规及政策，目前的用地计划、取得土地的具体安排符合国家、地方相关法律法规及城市规划，意向用地取得不存在实质性障碍或重大不确定性，用地落实不存在风险。若届时未取得该项目意向用地，相关政府部门将积极协调其他可用地块以供该项目使用，且用地及相关政策不变，确保对项目实施不会产生重大不利影响。”

据此，如发行人无法取得上述募投项目用地，相关政府部门将积极协调其他地块作为替代，以满足发行人募投项目的用地需求，确保项目的顺利实施。

因此，目前未取得募投项目用地不会对发行人募投项目的实施构成重大不利影响。

第八节 历次募集资金运用

一、历次募集资金使用情况

（一）最近五年内募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

1、2022 年首次公开发行股票

（1）募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价为每股人民币 61.49 元，共计募集资金 134,064.80 万元，坐扣承销和保荐费用 7,816.23 万元后的募集资金为 126,248.57 万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,530.62 万元后，公司本次募集资金净额为 123,717.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-69 号）。

（2）募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司 2022 年首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行上海张江支行	310066865013006192536	-	已销户
兴业银行上海杨浦支行	216190100100229975	-	已销户
浦发硅谷银行有限公司	10000000000001570	-	已销户
平安银行上海分行营业部	15068886888808	-	已销户
光大银行无锡分行营业部	39920180800378858	-	已销户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行南京鼓楼支行	320006600013002774567	-	已销户
合计		-	

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

（1）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158号），同意公司向不特定对象公开发行可转换公司债券 1,175 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 117,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 900.00 万元后的募集资金为 116,600.00 万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2025 年 4 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、验资费、律师费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 301.67 万元后，公司本次募集资金净额为 116,298.33 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕6-4 号）。

（2）前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行上海大柏树支行	216380100100420264	-	已销户
中信银行上海分行	8110201011501885643	-	已销户
交通银行上海张江支行	310066865013009418191	-	已销户
招商银行无锡分行	511903003310018	-	已销户
交通银行南京鼓楼支行	320006600013004712605	-	已销户
合计		-	

二、最近五年内募集资金实际使用情况

（一）最近五年内募集资金使用情况对照表

1、2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2022 年首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额：123,717.95						已累计使用募集资金总额：124,909.39				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						累积至 2022 年：35,430.68；2023 年：88,884.21；2024 年：594.50				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 （或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	48,828.82	48,828.82	48,797.15	48,828.82	48,828.82	48,797.15	-31.67	2023 年 7 月
2	集成电路测试研发中心建设项目	集成电路测试研发中心建设项目	7,366.92	7,366.92	7,408.42	7,366.92	7,366.92	7,408.42	41.50[注 1]	2023 年 8 月
3	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,019.70	5,000.00	5,000.00	5,019.70	19.70[注 1]	不适用
4	超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	15,000.00	25,000.00[注 2]	25,218.69	15,000.00	25,000.00[注 2]	25,218.69	218.69[注 1]	2025 年 9 月
5	超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	15,000.00	38,347.49[注 3]	38,465.43	15,000.00	38,347.49[注 3]	38,465.43	117.94[注 1]	2024 年 12 月

[注 1]集成电路测试研发中心建设项目、补充流动资金项目、超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目、超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级

及成品测试基地项目募集资金实际投资金额大于募集后承诺金额系使用了募集资金的利息收入。

[注 2]本公司于 2023 年 6 月 30 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元向全资子公司无锡伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。上述借款事项经公司股东大会审议通过，公司累计使用部分超募资金 25,000.00 万元实施该项目。

[注 3]本公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万元向全资子公司南京伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。本公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用剩余超募资金 13,347.49 万元及孳息向全资子公司南京伟测提供借款以继续实施募投项目，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。上述借款事项经公司股东大会审议通过，公司累计使用部分超募资金 38,347.49 万元实施该项目。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额：116,298.33						已累计使用募集资金总额：116,361.71				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2025 年：116,361.71				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	70,000.00	70,000.00	70,018.42	70,000.00	70,000.00	70,018.42	18.42[注 1]	2025 年 9 月

2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	20,000.00	20,000.00	20,000.10	20,000.00	20,000.00	20,000.10	0.10[注 1]	2024 年 12 月
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	偿还银行贷款及补充流动资金项目	27,500.00	27,500.00	26,343.18	27,500.00	27,500.00	26,343.18	-1,156.82[注 2]	不适用

[注 1]项目累计投入进度大于 100%系使用了部分募集资金的利息收入及投资收益所致。

[注 2]本次发行可转换债券的募集资金总额为人民币 117,500.00 万元，扣除不含税的发行费用 1,201.67 万元，实际募集资金净额为 116,298.33 万元。因本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于项目募集资金拟投入总额，“偿还银行贷款及补充流动资金项目”不足部分由公司自筹解决。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况说明

（1）2022 年首次公开发行股票

本公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 32,201.46 万元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并由其于 2022 年 11 月 11 日出具《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕6-499 号）。独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意的意见。

（2）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,426.03 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 180.07 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计人民币 77,606.10 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕6-486 号），公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

的公告》（公告编号：2025-030）。

（四）前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（1）2022 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表

截至 **2026 年 6 月 30 日**，公司 2022 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表如下。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

单位：万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2023 年度	2024 年度	2025 年度		
1	无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目	项目达产后，可实现年平均销售收入 20,135.32 万元	14,030.35[注 1]	16,427.31[注 2]	20,227.74	61, 299. 52	是
2	集成电路测试研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	超募资金-伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	项目达产后，可实现年平均销售收入 33,242.40 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]
5	超募资金-伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	项目达产后，可实现年平均销售收入 31,282.85 万元	不适用	不适用	25,528.27[注 4]	40, 201. 50	是

[注 1]无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目于 2023 年 7 月达到预定可使用状态，该项目 2023 年实现销售收入 14,030.35 万元。

[注 2]无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目 2024 年实现的销售收入为 16,427.31 万元。项目未达到预计收益的原因主要系 2023 年全球终端市场需求疲软，集成电路行业处于下行周期，2024 年尚处于复苏阶段，产能利用率水平未达到预期所致。

[注 3]伟测半导体无锡集成电路测试基地项目于 2025 年 9 月达到预定可使用状态，但截至 2026 年 6 月 30 日不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

[注 4]伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，该项目 2025 年实现销售收入 25,528.27 万元，原预计该项目建设完毕后产能分三年爬坡实现满产，各年度收入分别为 20,855.23 万元、28,965.60 万元和 31,282.85 万元。2025 年为该项目建设完毕后第一年，2025 年收入已达到预计效益。

(2) 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表如下。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

单位：万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2023 年度	2024 年度	2025 年度		
1	伟测半导体无锡集成电路测试基地项目	项目达产后，可实现年平均销售收入 33,242.40 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 1]
2	伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目	项目达产后，可实现年平均销售收入 31,282.85 万元	不适用	不适用	25,528.27[注 2]	40,201.50	是
3	偿还银行贷款及补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]伟测半导体无锡集成电路测试基地项目 2025 年 9 月达到预定可使用状态，但截至 2026 年 6 月 30 日不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

[注 2]伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，该项目 2025 年实现销售收入 25,528.27 万元，原预计该项目建设完毕后产能分三年爬坡实现满产，各年度收入分别为 20,855.23 万元、28,965.60 万元和 31,282.85 万元。2025 年为该项目建设完毕后第一年，2025 年收入已达到预计效益。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）2022 年首次公开发行股票

①集成电路测试研发中心建设项目无法单独核算效益，公司通过该项目进一步购置先进的研发及实验设备，对公司现有核心技术、主要产品以及战略规划中未来拟研发的新技术、新产品及新兴应用领域进行长期深入的研究和开发。通过该项目改善研发环境，提升对人才的吸引力，增强公司核心技术优势和产品竞争力。

②补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

（2）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

①伟测半导体无锡集成电路测试基地项目 2025 年 9 月达到预定可使用状态，但截至 2026 年 6 月 30 日不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

②偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

（五）前次募集资金用于认购股份的资产运行情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

（六）闲置募集资金的使用情况

1、2022 年首次公开发行股票

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品情况详见下表：

募集资金现金管理审核情况表

金额单位：人民币万元

发行名称		2022 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2022 年 10 月 21 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
100,000.00	安全性高、流动性好的投资产品	2022 年 11 月 11 日	2023 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 11 日
20,000.00		2023 年 10 月 26 日	2024 年 10 月 25 日	2023 年 10 月 26 日

募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

受托方	产品性质	购买金额	实际获得收益	是否赎回	期末余额
浦发硅谷银行有限公司	结构性存款	1,000.00	3.38	是	0.00
浦发硅谷银行有限公司	结构性存款	2,000.00	8.44	是	0.00
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	30.48	是	0.00

受托方	产品性质	购买金额	实际获得收益	是否赎回	期末余额
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	34.49	是	0.00
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	10.40	是	0.00
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	20.47	是	0.00
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	证券收益凭证	5,000.00	16.44	是	0.00
招商银行股份有限公司上海张杨支行	结构性存款	3,000.00	20.94	是	0.00
招商银行股份有限公司上海张杨支行	结构性存款	2,000.00	13.71	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	44.50	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	66.58	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	46.72	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	48.47	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	7.29	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	2,000.00	3.41	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	23.44	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	5.17	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	2,000.00	2.32	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	23.10	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	4.27	是	0.00

受托方	产品性质	购买金额	实际获得 收益	是否赎回	期末余额
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	2,000.00	14.22	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	6.62	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000.00	15.12	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	3,000.00	6.55	是	0.00
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	5,000.00	18.09	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	6,000.00	2.89	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	1,000.00	1.38	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	5,000.00	11.51	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	1,000.00	0.84	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	6,000.00	2.89	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	6,000.00	2.89	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	3,500.00	1.69	是	0.00
交通银行上海张江支行	结构性存款	3,000.00	1.45	是	0.00
中国工商银行股份有限公司南京珠江支行	结构性存款	2,000.00	5.59	是	0.00
交通银行南京鼓楼支行	结构性存款	5,000.00	42.49	是	0.00
交通银行南京鼓楼支行	结构性存款	5,000.00	13.16	是	0.00
中信银行南京中山东路支行	结构性存款	1,000.00	6.90	是	0.00
交通银行南京鼓楼支行	结构性存款	5,000.00	14.14	是	0.00
光大银行无锡分行营业部	结构性存款	4,500.00	10.50	是	0.00
招商银行无锡分行新区支行	结构性存款	8,000.00	19.96	是	0.00

受托方	产品性质	购买金额	实际获得 收益	是否赎回	期末余额
中信银行无锡新区支行	结构性存款	2,500.00	10.89	是	0.00
招商银行无锡分行 新区支行	结构性存款	5,000.00	14.75	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	5,000.00	13.75	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	4,000.00	16.50	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	5,000.00	27.50	是	0.00
招商银行无锡分行 新区支行	结构性存款	8,000.00	10.70	是	0.00
招商银行无锡分行 新区支行	结构性存款	5,000.00	11.51	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	5,000.00	12.08	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	4,000.00	9.33	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	5,000.00	11.46	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	5,000.00	17.19	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	3,000.00	6.88	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	3,500.00	7.88	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	2,500.00	5.63	是	0.00
中国工商银行股份 有限公司工博园支 行	结构性存款	2,000.00	5.02	是	0.00
中国工商银行股份 有限公司工博园支 行	结构性存款	1,500.00	3.30	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	3,000.00	6.38	是	0.00
招商银行无锡分行 新区支行	结构性存款	6,000.00	13.83	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	2,000.00	1.42	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	3,000.00	2.03	是	0.00
光大银行无锡分行 营业部	结构性存款	3,600.00	7.35	是	0.00

受托方	产品性质	购买金额	实际获得收益	是否赎回	期末余额
中国工商银行股份有限公司工博园支行	结构性存款	3,000.00	7.73	是	0.00
招商银行无锡分行新区支行	结构性存款	2,000.00	4.04	是	0.00
合 计		279,600.00	860.05		0.00

截至 2026 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金进行现金管理取得的收益共计 860.05 万元，余额为 0.00 元。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

金额单位：人民币万元

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2025 年 4 月 15 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000.00	安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品	2025 年 4 月 27 日	2026 年 4 月 26 日	2025 年 4 月 27 日

募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

委托方	受托银行	产品类型	购买金额	投资期限	收益
上海伟测半导体科技股份有限公司	交通银行上海张江支行	7 天通知	16,600.00	2025/4/30-2025/5/12	0.53
		结构性存款	10,000.00	2025/5/6-2025/5/27	9.49
		结构性存款	10,000.00	2025/6/3-2025/8/5	24.16
		结构性存款	3,000.00	2025/8/7-2025/8/21	1.38
		结构性存款	7,000.00	2025/8/7-2025/9/4	7.25
		结构性存款	2,000.00	2025/9/8-2025/9/16	0.53
无锡伟测半导体科技有限公司	招商银行无锡分行新区支行	7 天通知	8,000.00	2025/4/29-2025/5/6	1.56
		7 天通知	4,000.00	2025/5/7-2025/5/19	1.33
		结构性存款	3,000.00	2025/5/12-2025/5/26	2.08
		7 天通知	4,000.00	2025/5/23-2025/6/2	0.83
		7 天通知	5,000.00	2025/5/29-2025/6/9	1.15
		7 天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/17	0.44
		7 天通知	3,000.00	2025/6/10-2025/6/25	0.94
		结构性存款	5,000.00	2025/7/8-2025/7/30	4.78
		结构性存款	2,500.00	2025/8/19-2025/9/19	3.74
		结构性存款	1,500.00	2025/9/24-2025/10/10	0.86
合计			87,600.00[注]		61.05

[注]与计划进行现金管理的金额 40,000.00 万元差异系循环购买理财产品所致

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益为 61.05 万元，余额为 0.00 元。

（七）前次募集资金使用的其他情况

1、2022 年首次公开发行股票

（1）公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施新建项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币30,000.00万元分别向全资

子公司无锡伟测增资15,000.00万元及向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司增资15,000.00万元，分别用于投资建设新项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2022年11月28日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

（2）公司于2023年4月19日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币10,000.00万元向全资子公司南京伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。

（3）公司于2023年6月30日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币10,000.00万元向全资子公司无锡伟测提供借款，用于继续实施募投项目“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”，独立董事、监事会及保荐机构对本事项发表了同意的意见。2023年7月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2、2025 年向不特定对象发行可转换公司债券

不适用。

三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用

公司前次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，按照公司未来发展的战略规划，对公司现有业务的深化和拓展。募投项目完成后，进一步提升了公司的研发能力和科技创新水平，推进产品迭代和技术创新，升级和完善产品体系，促进主营业务发展，巩固并提升公司核心竞争力和市场占有率。

其中 2022 年首次公开发行股票募集资金投资包括无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目、集成电路测试研发中心建设项目和补充流动资金。“无锡伟测半导体科技有限公司集成电路测试产能建设项目”的交付进一步提高了公司晶圆测试、芯片成品测试等主要服务的能力，增强了主营业务

竞争能力和市场影响力；集成电路测试研发中心建设项目使公司技术研发和产品开发的融合更加紧密，公司的研发效率得到了更进一步提升；补充流动资金增强了公司的资金实力，提升了公司的抗风险能力。

其中 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资包括伟测半导体无锡集成电路测试基地项目、伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目和偿还银行贷款及补充流动资金项目。“伟测半导体无锡集成电路测试基地项目”及“伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目”的交付进一步提高了公司晶圆测试、芯片成品测试等主要服务的能力，增强了主营业务竞争能力和市场影响力；偿还银行贷款及补充流动资金项目增强了公司的资金实力，提升了公司的抗风险能力。

四、注册会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司前次募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕6-487 号），其结论意见如下：“我们认为，伟测科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了伟测科技公司截至 2026 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况”。

五、结论

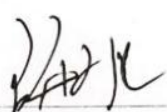
经核查，公司前次募集资金已到位并经会计师事务所验资确认。公司按照有关要求建立了《募集资金管理制度》，募集资金存放于三方监管专户。募集资金按照公司股东大会决议以及首次公开发行及前次可转换公司债券承诺的用途进行投入，募集资金用途未发生变更。公司募集资金实际使用情况与公司相关信息披露的内容保持一致。

第九节 声 明

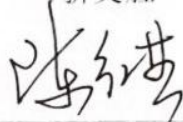
一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：



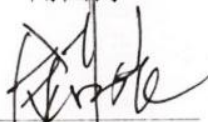
骈文胜



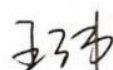
陈红燕



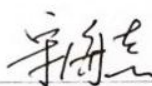
闻国涛



金敬长

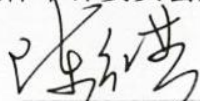


王 沛

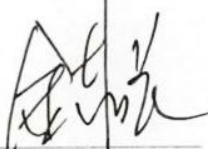


宋海燕

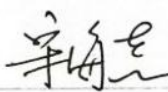
全体审计委员会成员：



陈红燕

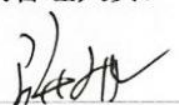


金敬长



宋海燕

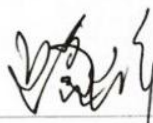
全体高级管理人员：



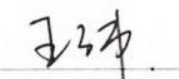
骈文胜



闻国涛



路 峰



王 沛

上海伟测半导体科技股份有限公司

2026 年 9 月 9 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人或本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东法定代表人签字：


骞文胜

控股股东签章：

上海蕊测半导体科技有限公司



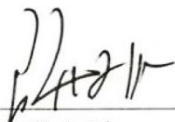
上海伟测半导体科技股份有限公司



二、发行人控股股东、实际控制人声明

本人或本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人签字：


骞文胜

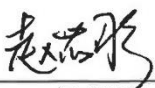
上海伟测半导体科技股份有限公司



三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：


赵蕊彤

保荐代表人：


吉丽娜


牟 军

法定代表人：


何之江



四、保荐人董事长、总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容,确认本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

总经理:



李 谦

董事长、法定代表人:



何之江





天健会计师事务所

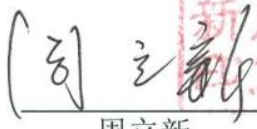
Pan-China Certified Public Accountants

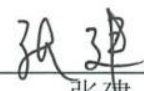
地址：杭州市钱江路1366号
邮编：310020
电话：(0571) 8821 6888
传真：(0571) 8821 6999

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称募集说明书），确认募集说明书内容与本所出具的《审计报告》（天健审〔2024〕6-18号、天健审〔2025〕6-480号、天健审〔2026〕6-346号）、《内部控制审计报告》（天健审〔2024〕6-19号、天健审〔2025〕6-481号、天健审〔2026〕6-347号）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕6-487号）不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对上海伟测半导体科技股份有限公司在募集说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：


周立新


张建

曹俊炜
(已离职)


汪婷

天健会计师事务所负责人：


翁伟

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年九月九日



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

地址：杭州市钱江路1366号

邮编：310020

电话：(0571) 8821 6888

传真：(0571) 8821 6999

关于签字注册会计师离职的说明

上海证券交易所：

本所作为上海伟测半导体科技股份有限公司申请在科创板向不特定对象发行可转换公司债券事项的审计机构，出具了《审计报告》（天健审〔2024〕6-18号、天健审〔2025〕6-480号）、《内部控制审计报告》（天健审〔2024〕6-19号、天健审〔2025〕6-481号），签字注册会计师为曹俊炜和汪婷。

曹俊炜已于2025年5月从本所离职，故无法在《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》之“审计机构声明”中签字。

专此说明，请予察核。



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：

翁伟



二〇二六年九月九日

六、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），确认募集说明书内容与本所出具的律师工作报告和法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的律师工作报告和法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



沈国权

经办律师签名：



乔文湘



夏瑜杰



吴迪



2026 年 9 月 9 日

七、资信评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字评级人员：

蒋晗

蒋晗

刘惠琼

刘惠琼

评级机构负责人：

张剑文

张剑文

中证鹏元资信评估股份有限公司



八、发行人董事会声明

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺，详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施和相关主体承诺的公告》。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会



第十节 备查文件

- 一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
- 二、保荐人出具的发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- 三、法律意见书和律师工作报告；
- 四、董事会编制、股东会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；
- 五、资信评级报告；
- 六、其他与本次发行有关的重要文件。